



SF32LB58x

芯片技术规格书

V1.8.6

文档编号: DS5801-SF32LB58x-CN

思澈科技（南京）有限公司
<http://www.sifli.com>
版权 ©2026

更新历史

文档状态说明

文档状态	版本范围	说明
草稿	0.0.0 ~0.9.9	初稿, 非正式发布, 信息为初步数据, 反映量产前产品的规格与性能, 不能保证准确性, 随时可能更改, 思澈科技将不会主动通知
发布版	1.0.0 ~1.9.9	正式发布, 信息有可能还会小范围修正, 以便更准确地反映量产产品的规格与性能; 如有更改, 思澈科技将不会主动通知

本文档更新历史

日期	版本	发布说明
2026-06-08	1.8.6	更新了结构框图 0-1
2026-05-12	1.8.5	更新 CAN 模块的描述
2025-08-21	1.8.4	更新了表 4-10
2025-04-24	1.8.3	更新了产品特性中封装的描述以及订购信息
2025-04-01	1.8.2	增加了 I/O 特性的表格
2025-03-10	1.8.1	修正了 SPI 所能支持的数据位宽的描述
2024-11-06	1.8	更新 I2S 外设的描述
2024-06-25	1.7	更新 VDDIOSA/SB/SC 的最大电压和最小电压
2024-05-15	1.6	更新 GPADC 特性; 添加订购信息
2024-03-06	1.5	增加 IO 驱动能力相关信息
2024-02-23	1.4	调整表格格式
2024-01-26	1.3	更新 Tstorage 温度范围
2023-12-29	1.2	更新可靠性数据
2023-06-05	1.1	更正电源规格数据
2023-03-13	1.0	修正少量文字
2023-03-03	0.9	更新 BLE Connection 数据
2023-02-28	0.8	添加功耗计算公式
2023-02-27	0.7	更新处理器功耗数据
2023-02-24	0.6	更新功耗数据和音频性能数据
2023-02-16	0.5	更新蓝牙数据
2023-02-15	0.4	更新射频数据
2023-01-04	0.3	更新功耗数据
2022-11-18	0.2	添加 PSA Certified Level 1 认证
2022-05-16	0.1	初稿

产品概述

SF32LB58x 是一系列用于超低功耗人工智能物联网 (AIoT) 场景下的高集成度、高性能的系统级 (SoC) MCU 芯片。芯片采用了基于 Arm Cortex-M33 STAR-MC1 处理器的大小核架构, 同时集成了业界最高性能 2D/2.5D 图形引擎, 人工智能神经网络加速器, 双模蓝牙 5.3, 以及音频 Codec, 可广泛用于腕带类可穿戴电子设备、智能移动终端、智能家居等各种应用场景。

芯片中的双大核性能处理器最高工作频率 240MHz, 单核 CoreMark 跑分高达 984, 功耗效率 8.29uA/CoreMark, 用于提供丰富应用和流畅人机交互所需的图形和音频算力。小核低功耗处理器最高工作频率 96MHz, CoreMark 跑分达到 394, 功耗效率 3.88uA/CoreMark, 在作为低功耗传感器控制中心 (Sensor Hub) 的同时兼顾运行蓝牙协议栈。本架构可以很好地兼顾流畅人机交互所需的高计算性能与长待

机时间所需的超低功耗运行之间的平衡关系。

芯片内集成双 2D/2.5D GPU, 主频最高达到 240MHz, 支持矢量图形、矢量字体、四图层叠加、alpha 混叠、硬件加速的实时旋转和缩放, 以及各种常用图形格式转换。eZip™2.0 无损格式解压缩引擎支持原生动画, 可大幅提高带宽利用率, 降低功耗和存储成本。芯片内置双 LCD 控制器, 支持 8080/QSPI/MIPI-DSI/JDI 等多种接口, 可不依赖于 CPU 自主实现最高 60fps 的全屏刷新帧率和低功耗息屏常显。

集成世界水平的双模蓝牙 5.3 收发机, 经典蓝牙 EDR2 模式最高发射功率 13dBm, 低功耗蓝牙模式最高发射功率 19dBm, 接收峰值功耗低至 2.2mA@3.3V, 低功耗蓝牙接收灵敏度达到-100dBm (1Mbps), 经典蓝牙灵敏度-96.3dBm (BR) 和-95.5dBm (EDR2)。

功能框图

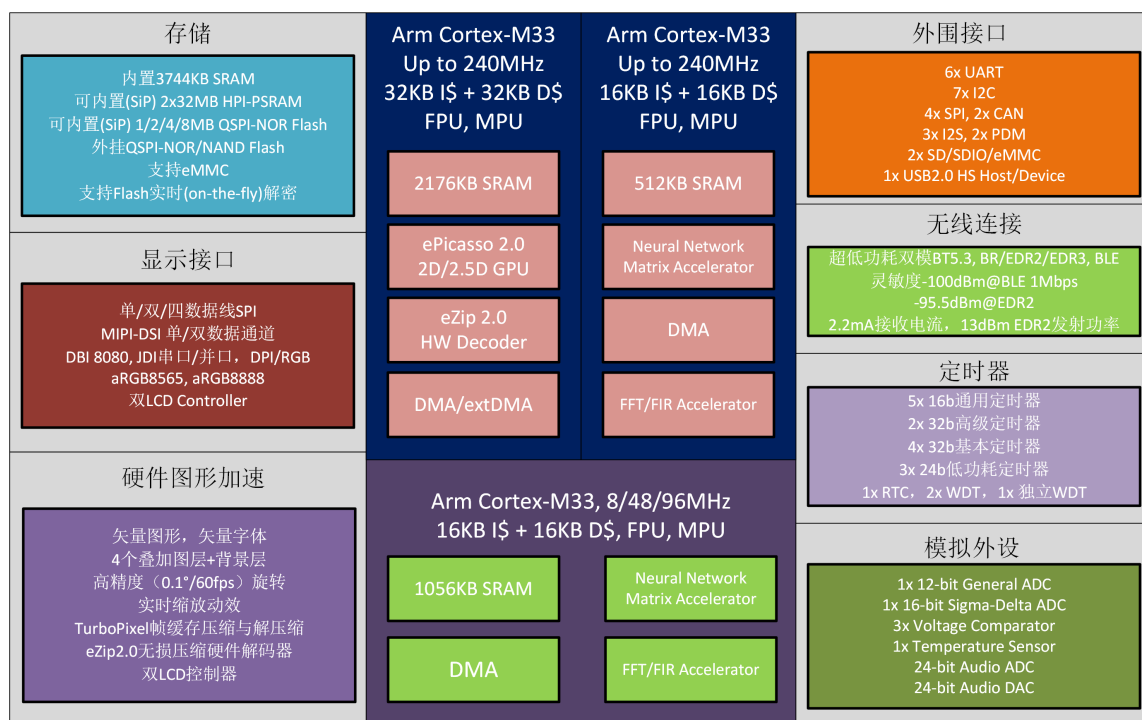


图 0-1: 功能框图

产品特性

CPU 与内存

- 性能处理器/大核 (HCPU/ACPU)
 - 处理器: Arm Cortex-M33 STAR-MC1
 - 主频: 最高 240MHz, 可调节
 - 每核最高 370DMIPS, 984 EEMBC CoreMark
 - I-Cache + D-Cache
 - HCPU: 32KB(2-way)+32KB(4-way)
 - ACPU: 16KB(2-way)+16KB(4-way)
 - SRAM: 2176KB(HCPU)+512KB(ACPU)
 - CoreMark 功耗效率 (均为 3.3V 下):
 - 34uA/MHz
 - 8.29uA/CoreMark
 - 121CoreMark/mA
 - 单精度浮点运算单元 (FPU)
 - 内存保护单元 (MPU)
- 超低功耗处理器/小核 (LCPU)
 - 处理器: Arm Cortex-M33 STAR-MC1
 - 主频: 最高 96MHz, 可调节
 - 最高 148DMIPS, 394 EEMBC CoreMark
 - I/D-Cache: 16KB(2-way)+16KB(4-way)
 - SRAM: 1056KB (全部为 Retention SRAM)
 - CoreMark 功耗效率 (均为运行 48MHz, 3.3V 下):
 - 15.9uA/MHz
 - 3.88uA/CoreMark
 - 258CoreMark/mA
 - 单精度浮点运算单元 (FPU)
 - 内存保护单元 (MPU)

无线连接

- 全功能双模蓝牙 5.3, 支持 BLE Audio
- 灵敏度
 - BLE/1Mbps 模式: -100dBm
 - BLE/2Mbps 模式: -97dBm
 - BLE/LR 125kbps 模式: -107.5dBm
 - BLE/LR 500bps 模式: -104.5dBm
 - BT/BR 1Mbps 模式: -96.3dBm
 - BT/EDR 2Mbps 模式: -95.5dBm
 - BT/EDR 3Mbps 模式: -88.5dBm

- 最大发射功率: 13dBm(EDR2/3), 19dBm(BR/BLE)
- 接收机峰值功耗 (BR/EDR2/EDR3): 2.2mA@3.3V
- 平均功耗 (3.3V, 500ms 间隔, 0dBm 发射功率)
 - BT Sniff 状态: 20.0uA
 - BLE 连接状态: 15.0uA

图形显示

- 双 2D/2.5D 图形引擎
 - 1×2D/2.5D 图形引擎—ePicasso™2.0
 - 1×2D/2.5D 图形引擎—Vivante GCNanoUltraV
 - 支持矢量图形, 矢量字体
 - 支持硬件加速的旋转、缩放和镜像
 - 最大解析度 1024×1024
 - 支持 aRGB8565、aRGB8888、L8、A8、A4 等多种图像格式, 支持 alpha 混叠
- 无损解压缩加速器—eZip™2.0
 - 硬件无损图形解压缩, 支持原生无损动画
 - 支持与 ePicasso™2.0 联动, 无须中间缓存
- JPEG 编解码加速器
 - 支持硬件 JPEG 图像的编码和解码
 - 支持硬件加速 JPEG 图像的裁剪、缩放
 - 支持 MJPEG 视频播放
- LCD 控制器
 - 支持 8080, SPI, Dual-SPI, Quad-SPI, MIPI-DSI, JDI 并口和串口
 - 支持两图层 alpha 混叠, 外加纯色背景图层
 - TurboPixel™ 帧缓存压缩与解压缩
 - 双 LCD 控制器, 支持超低功耗息屏常显模式

音频处理

- 2× 高保真 24-bit 音频 DAC
 - 采样率: 8k /16k /11.025k /22.05k /24k /32k /44.1k /48kHz
 - SNR(with 10kOhm load and A-Weighted): 109dB
 - THD+N: -101dB, Dynamic Range: 109dB
 - Noise Floor: 3.3 μ Vrms
- 2× 高保真 24-bit 音频 Sigma-Delta ADC
 - 采样率: 8k /11.025k /12k /16k /22.05k /24k /32k /44.1k /48kHz
 - SNR(A-Weighted): 99dB

- THD+N: -90dB, Dynamic Range: 99dB

- 3× I²S, 2× PDM
- 音频采样率转换加速器
- 音频 EQ 均衡加速器

神经网络矩阵加速器

- 面向 TinyML 场景, 高效率完成矩阵卷积运算
- 最高处理能力达到 1.92GOPS
- 功耗效率高于 10TOPS/W

数字信号处理加速器

- 大小核各一个 FFT 加速器
- 大小核各一个 FIR 滤波器加速器
- 每个处理器各配备一个 CORDIC 三角函数协处理器

存储接口

- 5×MPI (Memory Peripheral Interface)
 - MPI1/2 为内置合封 (SiP) 专用接口, 支持 OPI/HPI-PSRAM, DDR, 接口最高频率 144MHz, 最高吞吐率 576MB/s
 - MPI3/4 为外挂接口, 支持 QSPI-NOR、QSPI-NAND、QPI-PSRAM, 接口最高频率 96MHz, 最高吞吐率 96MB/s
 - MPI5 为内置合封 (SiP) 专用接口, 支持 QSPI-NOR, DTR, 接口最高频率 48MHz
 - MPI1/2/3/5 支持片外代码实时解密执行
- 2×SD/SDIO/eMMC, 4 线、8 线各一套, 支持 SD3.0, SDIO3.0, 以及 eMMC4.51, 接口最高频率 96MHz, 支持 DDR

系统时钟

- 振荡器
 - 48MHz 晶体振荡器
 - 低功耗 RC 振荡器: 1MHz, 48MHz
 - 超低功耗 RC 振荡器: 10KHz
 - 超低功耗 32.768KHz 晶体振荡器, 可选配
- PLL
 - 专用音频 PLL
 - 3×PLL, 最高频率 384MHz, 以 24MHz 为单位

安全

- AES、HASH 和 CRC 加速器
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 支持安全启动 (Secure Boot)
- 内置 1024-bit eFuse, 可存储信任根 (Root of Trust) 和唯一 ID (UID)
- PSA Certified Level 1 认证

其它

- DMA
 - 通用 DMA: 用于与外设间高效率数据搬运
 - extDMA: 用于与外部存储间高效率数据搬运
- 定时器
 - 5×16b GPTIM, 2×32b ATIM, 4×32b BTIM, 3×24b LPTIM
 - 1×RTC
 - 2×看门狗 24b WDT, 1×独立看门狗 IWDG
- 模拟
 - 1×12-bit 通用 SAR ADC, 共 8 通道
 - 1×16-bit Sigma-Delta ADC, 共 5 通道
 - 1×片上温度传感器
 - 3×低功耗电压比较器
- 连接外设
 - 6×UART, 7×I²C, 4×SPI
 - 3×I²S, 2×PDM
 - 1×USB2.0 HS Host/Device
 - SIM 卡控制器
 - 外设任务控制器 (PTC)
- 电源管理
 - 输入电压: 1.7-3.6V, -40 到 85°C
 - 内置两路高效率 Buck 及低功耗 LDO
 - RTC 工作下的休眠功耗: 700nA
 - 管脚唤醒配置时的休眠功耗: 300nA

封装

- BGA256, 160 (HP GPIO 94 + LP GPIO 60 + AON GPO 6) 个 GPIO, 8.5×6.5×0.94mm

应用场景

智能穿戴

- 高端智能手表
- 智能手环
- 可穿戴医疗器材
- 健身器材

工业

- 高性价比显示方案
- 图形化人机交互设备
- 工业传感器控制中心
- 工业设备监测
- 工业仪器仪表

车载

- 电动车中控设备
- 汽车钥匙
- 穿戴式汽车遥控设备

家庭自动化

- 中小型智能家电
- 智能门锁

通用

- 低功耗传感器中心
- 蓝牙 mesh

目录

更新历史	i	2.3 JPEG 编解码加速器	20
产品概述	ii	2.3.1 JPEG 编码器	20
功能框图	ii	2.3.2 JPEG 解码器	20
产品特性	iii	2.4 LCD 控制器	20
应用场景	v	2.4.1 TurboPixel™ 帧缓存压缩	20
1 芯片总览	1	2.4.2 显示接口	20
1.1 系统架构	1	2.4.2.1 MIPI-DBI	21
1.2 Cortex-M33 STAR-MC1 “星辰” 处理器	1	2.4.2.2 MIPI-DPI	21
1.3 性能处理器（大核）系统（HPSYS）	2	2.4.2.3 MIPI-DSI	21
1.3.1 总线架构	2	2.4.2.4 JDI 反射屏	21
1.3.2 时钟架构	3	2.5 eZip™ 无损压缩解码器	21
1.3.3 存储器类型	4	2.6 神经网络加速器	22
1.3.3.1 Cache	4	2.6.1 神经网络矩阵卷积加速器（NNACC）	22
1.3.3.2 TCM	4	2.6.2 神经网络协处理器（NN Co-Processor）	22
1.3.3.3 SRAM	4	2.7 数字信号处理加速器	22
1.3.3.4 片外 RAM	4	2.7.1 FFT 加速器	22
1.3.3.5 片外 Flash	4	2.7.2 Cordic 协处理器	22
1.3.4 地址映射	5	3 外设	23
1.3.5 中断列表	7	3.1 双模蓝牙 5.3	23
1.4 低功耗处理器（小核）系统（LPSYS）	12	3.1.1 射频和基带	23
1.4.1 总线架构	12	3.1.2 BT MAC	23
1.4.2 时钟架构	13	3.2 模拟外设	24
1.4.3 存储器类型	14	3.2.1 12 比特模/数转换器	24
1.4.3.1 Cache	14	3.2.2 16 比特模/数转换器	25
1.4.3.2 TCM	14	3.2.3 温度传感器	25
1.4.3.3 SRAM	14	3.2.4 电压比较器	25
1.4.3.4 片外 Flash	14	3.2.5 音频 DAC	26
1.4.4 地址映射	15	3.2.6 音频 PLL	26
1.4.5 中断列表	17	3.2.7 音频 ADC	26
1.5 电源管理	18	3.3 DMA	26
2 高性能专用计算	19	3.3.1 ExtDMA	26
2.1 ePicasso™ 高性能 2.5D 图形引擎	19	3.3.2 DMAC	26
2.1.1 图层叠加	19	3.4 音频处理模块 AUDPRC	27
2.1.2 图形缩放	19	3.4.1 DAC 通路	27
2.1.3 图形旋转	19	3.4.2 ADC 通路	27
2.2 Vivante GCN NanoUltraV 高性能矢量绘图 GPU	19	3.5 连接外设	27
2.2.1 坐标系统变换	19	3.5.1 通用输入/输出接口（GPIO）	27
2.2.2 图层叠加	19	3.5.2 通用异步收发器（UART）	28
2.2.3 填充	19	3.5.3 I2C	29
2.2.4 绘图	20	3.5.4 PDM	29
2.2.5 图层压缩	20	3.5.5 I2S	29
		3.5.6 串行外设接口（SPI）	30
		3.5.7 外设任务控制器（PTC）	32
		3.5.8 USB2.0 HS	32

3.5.9	SIM 卡控制器	33	5.6	分级回流焊	77
3.6	定时器	33	5.7	订购信息	78
3.6.1	通用定时器	33	相关资源	79	
3.6.2	高级定时器	34			
3.6.3	基本定时器	35			
3.6.4	低功耗定时器	35			
3.6.5	看门狗	36			
3.7	加密校验	36			
3.7.1	AES 引擎	36			
3.7.2	HASH 引擎	37			
3.7.3	CRC	37			
3.7.4	真随机数发生器 (TRNG)	37			
3.8	存储接口	37			
3.8.1	MPI 接口	37			
3.8.2	SD/SDIO/eMMC	39			
3.9	CAN	39			
3.10	各种外设接口速率汇总	40			
4	电气特性	41			
4.1	基本电气特性	41			
4.2	可靠性	43			
4.3	功耗特性	44			
4.3.1	关机功耗	44			
4.3.2	处理器功耗	44			
4.3.3	BLE 功耗	44			
4.3.4	BLE、经典蓝牙各种状态下的平均功耗	45			
4.4	蓝牙射频	46			
4.4.1	BLE 射频	46			
4.4.1.1	BLE 发射机性能	46			
4.4.1.2	BLE 接收机性能	47			
4.4.2	经典蓝牙	49			
4.4.2.1	发射机性能	49			
4.4.2.2	接收机性能	50			
4.5	音频性能	51			
4.6	IO 驱动能力	51			
5	封装与硬件	52			
5.1	管脚布局	52			
5.2	管脚描述	53			
5.2.1	大核域 GPIO (PA) 列表	54			
5.2.2	小核域 GPIO (PB) 列表	65			
5.2.3	专用管脚 (电源、射频、模拟、数字) 列表	72			
5.3	封装尺寸	75			
5.4	载带尺寸	76			
5.5	卷盘尺寸	76			

插图

0-1 功能框图	ii
1-1 性能处理器（大核）系统总线架构 HCPU	2
1-2 性能处理器（大核）系统总线架构 ACPU	2
1-3 HPSYS 时钟架构	3
1-4 低功耗处理器（小核）系统总线架构	12
1-5 LPSYS 时钟架构	13
1-6 电源管理架构	18
3-1 通用异步收发器	28
3-2 SSP 格式单次收发时序	30
3-3 SSP 格式连续收发时序	30
3-4 SPI 格式单次收发时序	31
3-5 SPI 格式连续收发时序	31
3-6 SPH=0 时的 SPI 时序	31
3-7 SPH=1 时的 SPI 时序	31
3-8 Microwire 格式的单次收发时序	32
3-9 Microwire 格式的多次收发时序	32
3-10 MPI 控制器框图	38
3-11 寄存器模式单个和多个命令时序的序列	38
5-1 SF32LB58x（BGA256）管脚布局（俯视图）	52
5-2 SF32LB58x（BGA256）封装尺寸	75
5-3 载带尺寸	76
5-4 卷盘尺寸	76
5-5 分级回流焊	77

表格

1-1 HPSYS 地址映射	5	4-13 BLE 接收机性能—1Mbps 模式	47
1-2 HCPU 中断列表	7	4-14 BLE 接收机性能—2Mbps 模式	47
1-3 ACPU 中断列表	9	4-15 BLE 接收机性能—S2 模式	48
1-4 LPSYS 地址映射	15	4-16 BLE 接收机性能—S8 模式	48
1-5 LCPU 中断列表	17	4-17 发射机性能—Basic Data Rate	49
3-1 12-bit GPADC 电气特性	24	4-18 发射机性能—Enhanced Data Rate	49
3-2 常用接口速率	40	4-19 接收机性能—Basic Data Rate	50
4-1 运行条件	41	4-20 接收机性能—Enhanced Data Rate- $\pi/4$ DQPSK	50
4-2 绝对最大值	41	4-21 接收机性能—Enhanced Data Rate-8DPSK	50
4-3 PMU 供电规格	41	4-22 音频 ADC 性能	51
4-4 其它电源供电规格	42	4-23 音频 DAC 性能	51
4-5 I/O 特性 @3.3V	42	4-24 IO 驱动能力	51
4-6 可靠性测试	43	5-1 管脚类型	53
4-7 关机功耗	44	5-2 大核域 GPIO (PA) 管脚列表	54
4-8 处理器功耗	44	5-3 小核域 GPIO (PB) 管脚列表	65
4-9 BLE 功耗	44	5-4 专用管脚 (电源、射频、模拟、数字) 列表	72
4-10 BLE、经典蓝牙各种状态下的平均功耗	45	5-5 分级回流焊对照表	77
4-11 BLE 发射机性能—1Mbps 模式	46	5-6 无铅工艺峰值回流温度对照表	77
4-12 BLE 发射机性能—2Mbps 模式	46	5-7 无铅工艺分级回流温度对照表	77
		5-8 订购信息	78

1 芯片总览

1.1 系统架构

SF32LB58x 是一系列用于超低功耗人工智能物联网 (AIoT) 场景下的高集成度、高性能的系统级 (SoC) MCU 芯片。芯片采用了基于 Arm Cortex-M33 STAR-MC1 处理器的大小核架构, 其中:

- 性能处理器/大核 (HCPU/ACPU): 最高主频 240MHz, 其中 HCPU 配备 32KB 指令缓存 (I-Cache) 和 32KB 数据缓存 (D-Cache), ACPU 配备 16KB 指令缓存 (I-Cache) 和 16KB 数据缓存 (D-Cache), 2688KB SRAM (其中 HCPU 2176KB, ACPU 512KB); 作为系统主控, 能够高效访问片内和片外存储, 主要用于系统控制、人机交互、高性能计算等。
- 超低功耗处理器/小核 (LCPU): 最高主频 96MHz, 配备 16KB 指令缓存 (I-Cache) 和 16KB 数据缓存 (D-Cache), 1056KB SRAM (全部为 Retention SRAM); 主要作为系统的超低功耗传感器中心 (Sensor Hub) 和低功耗蓝牙连接的控制器, 满足超低功耗场景下的各种数据采集、处理、传输与控制需求。

1.2 Cortex-M33 STAR-MC1 “星辰” 处理器

Cortex-M33 STAR-MC1 处理器是安谋中国 (Arm China) 推出的“星辰”系列产品的第一款处理器, 该处理器继承了 Cortex-M33 的主要特点, 支持现有的 Armv8-M 架构的全部功能, 具有有序 (in order) 三级流水线, 可显著降低系统功耗, 具有部分双发射 16 位指令能力, 并进一步改进了协处理器接口, 增加了对缓存 (Cache) 的支持。

Cortex-M33 STAR-MC1 性能达到 1.5DMIPS/MHz 和 4.02Coremark/MHz, 与上一代同档位 Arm 处理器相比, 在相同主频下, Cortex-M33 STAR-MC1 的性能提升 20%。

Cortex-M33 STAR-MC1 提供了协处理器 (Coprocessor) 接口, 以便根据不同场景需求进一步提高定制计算的能力。通过 MCR (Move from Coprocessor to Register) 和 MRC (Move from Register to Coprocessor) 指令, 可以在 Cortex-M33 STAR-MC1 和协处理器之间转移寄存器数据和计算结果数据, 非常适合所需数据量不大、计算复杂但相对碎片化、延迟较小的运算。在协处理器计算的同时, Cortex-M33 STAR-MC1 处理器仍然可以并行执行其它指令, 从而明显提高执行效率。

此外, 该处理器还支持数字信号处理 (DSP) 指令集和浮点数运算单元 (FPU)。

Cortex-M33 STAR-MC1 引入了紧耦合内存 (TCM) 和缓存 (Cache) 技术, 增强了各种不同特点的内置和外置存储系统的使用灵活性, 确保在各种不同场景下处理器响应的实时性和计算效率。

1.3 性能处理器（大核）系统（HPSYS）

1.3.1 总线架构

HPSYS 内部提供了基于 AHB 协议的总线矩阵，支持多个主设备并行访问多个从设备地址空间。

HCPU 能够访问 HPSYS 的所有地址空间，并能通过 HP2LP 跨核访问 LPSYS 的所有地址空间。

ACPU 能够访问除 HPSYS_ITCM 和 Retention RAM 以外 HPSYS 的所有地址空间，并能通过 HP2LP 跨域访问除 LPSYS_DTCM 以外 LPSYS 的所有地址空间。

DMAC1 与 DMAC2 能够访问除 HPSYS_ITCM 和 Retention RAM 以外 HPSYS 的所有地址空间，并能通过 HP2LP 跨域访问除 LPSYS_DTCM 以外 LPSYS 的所有地址空间。

LPSYS 的部分主设备能够通过 LP2HP 跨域访问除 HPSYS_ITCM 和 Retention RAM 以外 HPSYS 的所有地址空间。

HPSYS_ITCM 和 Retention RAM 地址空间仅能由 HCPU 访问。DTCM 与 HPSYS_RAM0 共享 128KB 地址空间，可由 HCPU 及其它主设备访问。

多个主设备同时访问同一个从设备地址空间时，基于轮询仲裁原则决定访问次序。

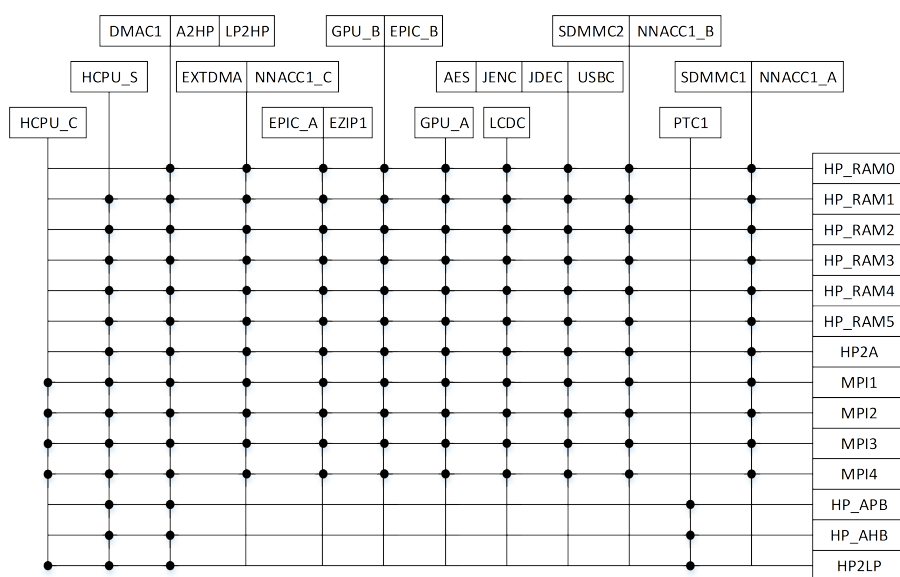


图 1-1: 性能处理器（大核）系统总线架构 HCPU

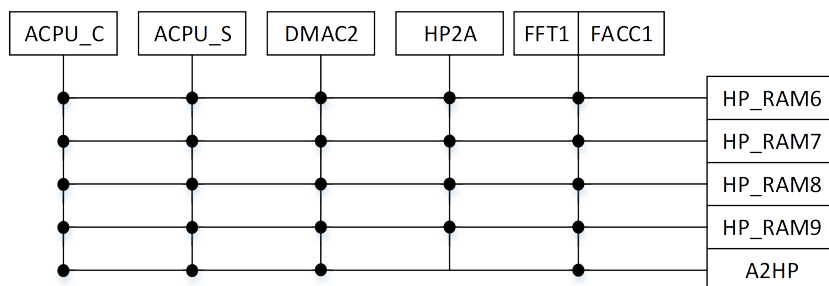


图 1-2: 性能处理器（大核）系统总线架构 ACPU

1.3.2 时钟架构

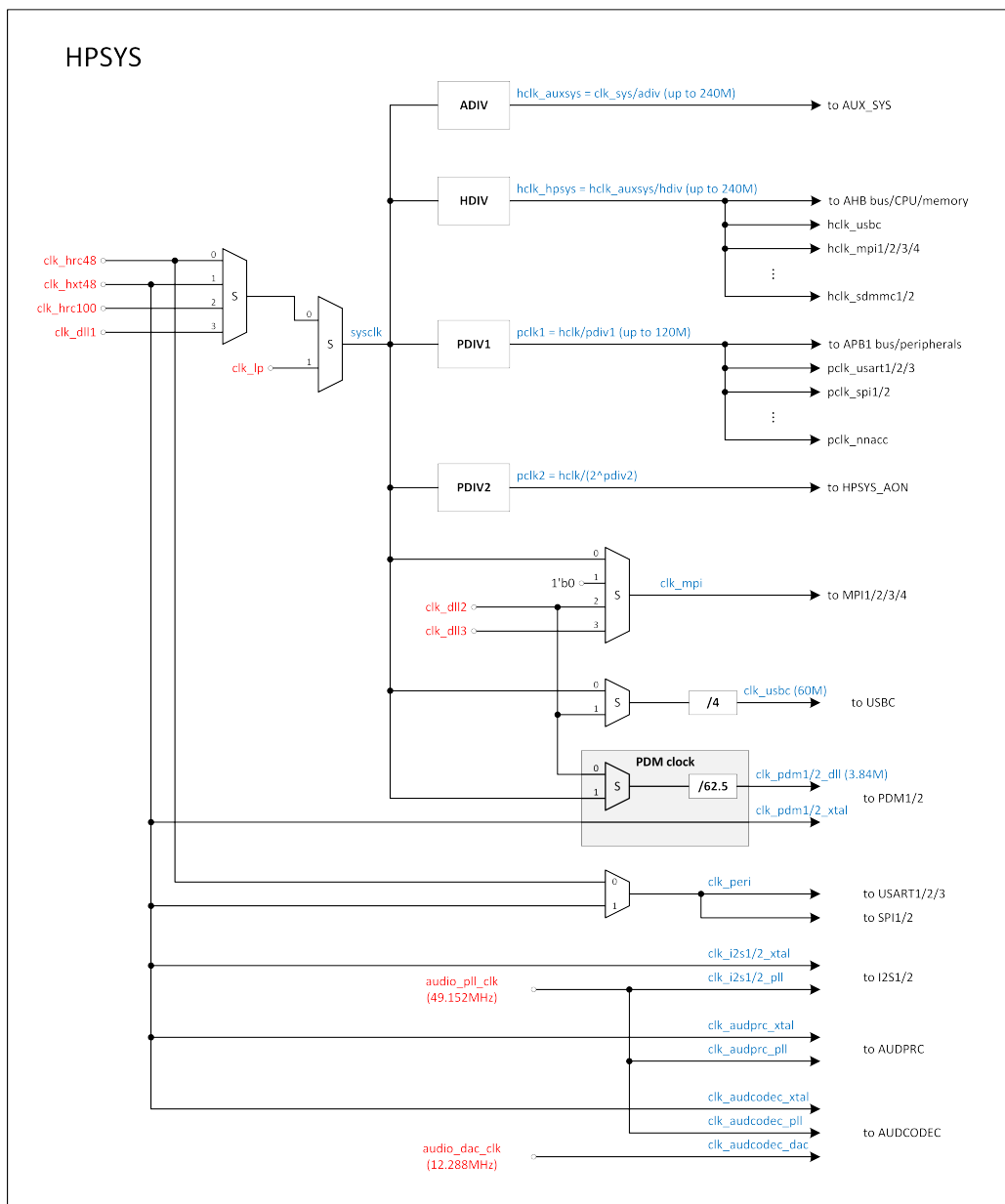


图 1-3: HPSYS 时钟架构

1.3.3 存储器类型

1.3.3.1 Cache

HCPU 配置有 32KB 2-way I-Cache（一级指令缓存）和 32KB 4-way D-Cache（一级数据缓存），ACPU 配置有 16KB 2-way I-Cache（一级指令缓存）和 16KB 4-way D-Cache（一级数据缓存），可大幅提升 XIP 时 CPU 执行效率。软件需合理配置 MPU（Memory Protection Unit）设置 cache 地址段和非 cache 地址段，兼顾效率和易用性。

1.3.3.2 TCM

HCPU 配置有 64KB zero-wait-cycle I-TCM，地址空间为 0x0001_0000 - 0x0001_FFFF。该 TCM memory 为 HCPU 独享，其它 AHB master 无法访问，可用于放置对实时性（或者时延确定性）要求较高的代码和数据。

HCPU 同时配置有 128KB zero-wait-cycle D-TCM，地址空间为 0x2000_0000 - 0x2001_FFFF。该 TCM memory 挂在总线上，也可以被其他 AHB master 访问。

1.3.3.3 SRAM

HPSYS 总线上共有 2624KB SRAM，其中包括：

- 2048KB HCPU zero-wait-cycle SRAM，地址空间为 0x2000_0000 - 0x201F_FFFF（前 128KB 与 DTCM 共享），所有 AHB master 均可访问。最高频率为 240MHz，可最大限度发挥 CPU 性能。
- 512KB ACPU zero-wait-cycle SRAM，地址空间为 0x2020_0000 - 0x2027_FFFF。
- 64KB Retention SRAM，地址空间为 0x0002_0000 - 0x0002_FFFF，HCPU 可访问，最高频率为 120MHz。当系统进入低功耗模式时，此 SRAM 工作保证数据不丢失。

1.3.3.4 片外 RAM

HPSYS 支持外挂 HPI/OPI DDR pSRAM，地址空间为 0x6000_0000 - 0x63FF_FFFF，实际可访问地址由外挂颗粒容量决定。接口最高频率为 DDR 144MHz，数据位宽为 16-bit 或 8-bit。

1.3.3.5 片外 Flash

HPSYS 支持外挂多颗 NOR/NAND FLASH，其中：

- 0x6400_0000 - 0x67FF_FFFF 地址段可挂 FLASH3，推荐使用频率为 72MHz
- 0x6800_0000 - 0x9FFF_FFFF 地址段可挂 FLASH4，推荐使用频率为 72MHz

1.3.4 地址映射

表 1-1: HPSYS 地址映射

Category	Memory /IP	Address space	HCPU				LCPU		ACPU			
			Starting Address		Ending Address		Starting Address	Ending Address	Starting Address		Ending Address	
HPSYS_ITCM		256KB	0x0000_0000		0x0003_FFFF		NA	NA	NA		NA	
	ROM	64KB	0x0000_0000		0x0000_FFFF		-	-	-		-	
	RAM	64KB	0x0001_0000		0x0001_FFFF		-	-	-		-	
	RAM (Retention)	64KB	0x0002_0000		0x0002_FFFF		-	-	-		-	
	Reserved	-	-		-		-	-	-		-	
External Memory		1024MB	0x1000_0000	0x6000_0000	0x1BFF_FFFF	0x9FFF_FFFF	0x6000_0000	0x9FFF_FFFF	0x6000_0000		0x9FFF_FFFF	
	MPI1 Memory	32MB	0x1000_0000	0x6000_0000	0x11FF_FFFF	0x61FF_FFFF	0x6000_0000	0x61FF_FFFF	0x6000_0000		0x61FF_FFFF	
	MPI2 Memory	32MB	0x1200_0000	0x6200_0000	0x13FF_FFFF	0x63FF_FFFF	0x6200_0000	0x63FF_FFFF	0x6200_0000		0x63FF_FFFF	
	MPI3 Memory	64MB	0x1400_0000	0x6400_0000	0x17FF_FFFF	0x67FF_FFFF	0x6400_0000	0x67FF_FFFF	0x6400_0000		0x67FF_FFFF	
	MPI4 Memory	64MB/896MB	0x1800_0000	0x6800_0000	0x1BFF_FFFF	0x9FFF_FFFF	0x6800_0000	0x9FFF_FFFF	0x6800_0000		0x9FFF_FFFF	
HPSYS_RAM		2MB	0x2000_0000		0x2027_FFFF		0x2A00_0000	0x2A27_FFFF	0x0000_0000	0x2000_0000	0x0007_FFFF	0x2027_FFFF
	RAM0	128KB	0x2000_0000		0x2001_FFFF		0x2A00_0000	0x2A01_FFFF	-	0x2000_0000	-	0x2001_FFFF
	RAM1	128KB	0x2002_0000		0x2003_FFFF		0x2A02_0000	0x2A03_FFFF	-	0x2002_0000	-	0x2003_FFFF
	RAM2	256KB	0x2004_0000		0x2007_FFFF		0x2A04_0000	0x2A07_FFFF	-	0x2004_0000	-	0x2007_FFFF
	RAM3	512KB	0x2008_0000		0x200F_FFFF		0x2A08_0000	0x2A0F_FFFF	-	0x2008_0000	-	0x200F_FFFF
	RAM4	512KB	0x2010_0000		0x2017_FFFF		0x2A10_0000	0x2A17_FFFF	-	0x2010_0000	-	0x2017_FFFF
	RAM5	512KB	0x2018_0000		0x201F_FFFF		0x2A18_0000	0x2A1F_FFFF	-	0x2018_0000	-	0x201F_FFFF
	RAM6 (ACPU)	128KB	0x2020_0000		0x2021_FFFF		0x2A20_0000	0x2A21_FFFF	0x0000_0000	0x2020_0000	0x0001_FFFF	0x2021_FFFF
	RAM7 (ACPU)	128KB	0x2022_0000		0x2023_FFFF		0x2A22_0000	0x2A23_FFFF	0x0002_0000	0x2022_0000	0x0003_FFFF	0x2023_FFFF
	RAM8 (ACPU)	128KB	0x2024_0000		0x2025_FFFF		0x2A24_0000	0x2A25_FFFF	0x0004_0000	0x2024_0000	0x0005_FFFF	0x2025_FFFF
	RAM9 (ACPU)	128KB	0x2026_0000		0x2027_FFFF		0x2A26_0000	0x2A27_FFFF	0x0006_0000	0x2026_0000	0x0007_FFFF	0x2027_FFFF
HPSYS_APB1		256KB	0x4000_0000		0x4003_FFFF		0x4000_0000	0x4003_FFFF	0x4003_0000		0x4003_FFFF	
	RCC1	4KB	0x4000_0000		0x4000_0FFF		0x4000_0000	0x4000_0FFF	0x4000_0000		0x4000_0FFF	
	DMAC1	4KB	0x4000_1000		0x4000_1FFF		0x4000_1000	0x4000_1FFF	0x4000_1000		0x4000_1FFF	
	MAILBOX1	4KB	0x4000_2000		0x4000_2FFF		0x4000_2000	0x4000_2FFF	0x4000_2000		0x4000_2FFF	
	PINMUX1	4KB	0x4000_3000		0x4000_3FFF		0x4000_3000	0x4000_3FFF	0x4000_3000		0x4000_3FFF	
	USART1	4KB	0x4000_4000		0x4000_4FFF		0x4000_4000	0x4000_4FFF	0x4000_4000		0x4000_4FFF	
	USART2	4KB	0x4000_5000		0x4000_5FFF		0x4000_5000	0x4000_5FFF	0x4000_5000		0x4000_5FFF	
	EZIP1	4KB	0x4000_6000		0x4000_6FFF		0x4000_6000	0x4000_6FFF	0x4000_6000		0x4000_6FFF	
	EPIC	4KB	0x4000_7000		0x4000_7FFF		0x4000_7000	0x4000_7FFF	0x4000_7000		0x4000_7FFF	
	LCDC1	4KB	0x4000_8000		0x4000_8FFF		0x4000_8000	0x4000_8FFF	0x4000_8000		0x4000_8FFF	
	I2S1	4KB	0x4000_9000		0x4000_9FFF		0x4000_9000	0x4000_9FFF	0x4000_9000		0x4000_9FFF	
	I2S2	4KB	0x4000_A000		0x4000_AFFF		0x4000_A000	0x4000_AFFF	0x4000_A000		0x4000_AFFF	
	SYSCFG1	4KB	0x4000_B000		0x4000_BFFF		0x4000_B000	0x4000_BFFF	0x4000_B000		0x4000_BFFF	
	EFUSEC	4KB	0x4000_C000		0x4000_CFFF		0x4000_C000	0x4000_CFFF	0x4000_C000		0x4000_CFFF	
	AES	4KB	0x4000_D000		0x4000_DFFF		0x4000_D000	0x4000_DFFF	0x4000_D000		0x4000_DFFF	
	Reserved	4KB	0x4000_E000		0x4000_EFFF		0x4000_E000	0x4000_EFFF	0x4000_E000		0x4000_EFFF	
	TRNG	4KB	0x4000_F000		0x4000_FFFF		0x4000_F000	0x4000_FFFF	0x4000_F000		0x4000_FFFF	
	GPTIM1	4KB	0x4001_0000		0x4001_0FFF		0x4001_0000	0x4001_0FFF	0x4001_0000		0x4001_0FFF	
	GPTIM2	4KB	0x4001_1000		0x4001_1FFF		0x4001_1000	0x4001_1FFF	0x4001_1000		0x4001_1FFF	
	BTIM1	4KB	0x4001_2000		0x4001_2FFF		0x4001_2000	0x4001_2FFF	0x4001_2000		0x4001_2FFF	
	BTIM2	4KB	0x4001_3000		0x4001_3FFF		0x4001_3000	0x4001_3FFF	0x4001_3000		0x4001_3FFF	
	WDT1	4KB	0x4001_4000		0x4001_4FFF		0x4001_4000	0x4001_4FFF	0x4001_4000		0x4001_4FFF	
	SP1	4KB	0x4001_5000		0x4001_5FFF		0x4001_5000	0x4001_5FFF	0x4001_5000		0x4001_5FFF	
	SP2	4KB	0x4001_6000		0x4001_6FFF		0x4001_6000	0x4001_6FFF	0x4001_6000		0x4001_6FFF	
	EXTDMA	4KB	0x4001_7000		0x4001_7FFF		0x4001_7000	0x4001_7FFF	0x4001_7000		0x4001_7FFF	
	DMAC2	4KB	0x4001_8000		0x4001_8FFF		0x4001_8000	0x4001_8FFF	0x4001_8000		0x4001_8FFF	
	NNACC1	4KB	0x4001_9000		0x4001_9FFF		0x4001_9000	0x4001_9FFF	0x4001_9000		0x4001_9FFF	
	PDM1	4KB	0x4001_A000		0x4001_AFFF		0x4001_A000	0x4001_AFFF	0x4001_A000		0x4001_AFFF	
	PDM2	4KB	0x4001_B000		0x4001_BFFF		0x4001_B000	0x4001_BFFF	0x4001_B000		0x4001_BFFF	
	I2C1	4KB	0x4001_C000		0x4001_CFFF		0x4001_C000	0x4001_CFFF	0x4001_C000		0x4001_CFFF	

续表下页...

表 1-1: HPSYS 地址映射（续）

Category	Memory /IP	Address space	HCPU		LCPU		ACPU	
			Starting Address	Ending Address	Starting Address	Ending Address	Starting Address	Ending Address
	I2C2	4KB	0x4001_D000	0x4001_DFFF	0x4001_D000	0x4001_DFFF	0x4001_D000	0x4001_DFFF
	DSIHOST	4KB	0x4001_E000	0x4001_EFFF	0x4001_E000	0x4001_EFFF	0x4001_E000	0x4001_EFFF
	DSIPHY	4KB	0x4001_F000	0x4001_FFFF	0x4001_F000	0x4001_FFFF	0x4001_F000	0x4001_FFFF
	PTC1	4KB	0x4002_0000	0x4002_0FFF	0x4002_0000	0x4002_0FFF	0x4002_0000	0x4002_0FFF
	BUSMON1	4KB	0x4002_1000	0x4002_1FFF	0x4002_1000	0x4002_1FFF	0x4002_1000	0x4002_1FFF
	I2C3	4KB	0x4002_2000	0x4002_2FFF	0x4002_2000	0x4002_2FFF	0x4002_2000	0x4002_2FFF
	ATIM1	4KB	0x4002_3000	0x4002_3FFF	0x4002_3000	0x4002_3FFF	0x4002_3000	0x4002_3FFF
	ATIM2	4KB	0x4002_4000	0x4002_4FFF	0x4002_4000	0x4002_4FFF	0x4002_4000	0x4002_4FFF
	AUDPRC	4KB	0x4002_5000	0x4002_5FFF	0x4002_5000	0x4002_5FFF	0x4002_5000	0x4002_5FFF
	AUDCODEC	4KB	0x4002_6000	0x4002_6FFF	0x4002_6000	0x4002_6FFF	0x4002_6000	0x4002_6FFF
	FFT1	4KB	0x4002_7000	0x4002_7FFF	0x4002_7000	0x4002_7FFF	0x4002_7000	0x4002_7FFF
	FACC1	4KB	0x4002_8000	0x4002_8FFF	0x4002_8000	0x4002_8FFF	0x4002_8000	0x4002_8FFF
	USART3	4KB	0x4002_9000	0x4002_9FFF	0x4002_9000	0x4002_9FFF	0x4002_9000	0x4002_9FFF
	EZIP2	4KB	0x4002_A000	0x4002_AFFF	0x4002_A000	0x4002_AFFF	0x4002_A000	0x4002_AFFF
	CAN1	4KB	0x4002_B000	0x4002_BFFF	0x4002_B000	0x4002_BFFF	0x4002_B000	0x4002_BFFF
	CAN2	4KB	0x4002_C000	0x4002_CFFF	0x4002_C000	0x4002_CFFF	0x4002_C000	0x4002_CFFF
	SCI	4KB	0x4002_D000	0x4002_DFFF	0x4002_D000	0x4002_DFFF	0x4002_D000	0x4002_DFFF
	BUSMON2	4KB	0x4002_E000	0x4002_EFFF	0x4002_E000	0x4002_EFFF	0x4002_E000	0x4002_EFFF
	I2C4	4KB	0x4002_F000	0x4002_FFFF	0x4002_E000	0x4002_FFFF	0x4002_E000	0x4002_FFFF
	Reserved	64KB	0x4003_0000	0x4003_FFFF	0x4003_0000	0x4003_FFFF	0x4003_0000	0x4003_FFFF
HPSYS_APB2		256KB	0x4004_0000	0x4007_FFFF	0x4004_0000	0x4007_FFFF	0x4004_0000	0x4007_FFFF
	HPSYS_AON	4KB	0x4004_0000	0x4004_0FFF	0x4004_0000	0x4004_0FFF	0x4004_0000	0x4004_0FFF
	LPTIM1	4KB	0x4004_1000	0x4004_1FFF	0x4004_1000	0x4004_1FFF	0x4004_1000	0x4004_1FFF
	Reserved	4KB	0x4004_2000	0x4004_2FFF	0x4004_2000	0x4004_2FFF	0x4004_2000	0x4004_2FFF
	Reserved	52KB	0x4004_3000	0x4004_FFFF	0x4004_3000	0x4004_FFFF	0x4004_3000	0x4004_FFFF
	Reserved	64KB	0x4005_0000	0x4005_FFFF	0x4005_0000	0x4005_FFFF	0x4005_0000	0x4005_FFFF
	Reserved	64KB	0x4006_0000	0x4006_FFFF	0x4006_0000	0x4006_FFFF	0x4006_0000	0x4006_FFFF
	Reserved	64KB	0x4007_0000	0x4007_FFFF	0x4007_0000	0x4007_FFFF	0x4007_0000	0x4007_FFFF
HPSYS_AHB		256KB	0x4008_0000	0x400B_FFFF	0x4008_0000	0x400B_FFFF	0x4008_0000	0x400B_FFFF
	GPIO1	4KB	0x4008_0000	0x4008_0FFF	0x4008_0000	0x4008_0FFF	0x4008_0000	0x4008_0FFF
	MPI1	4KB	0x4008_1000	0x4008_1FFF	0x4008_1000	0x4008_1FFF	0x4008_1000	0x4008_1FFF
	MPI2	4KB	0x4008_2000	0x4008_2FFF	0x4008_2000	0x4008_2FFF	0x4008_2000	0x4008_2FFF
	MPI3	4KB	0x4008_3000	0x4008_3FFF	0x4008_3000	0x4008_3FFF	0x4008_3000	0x4008_3FFF
	MPI4	4KB	0x4008_4000	0x4008_4FFF	0x4008_4000	0x4008_4FFF	0x4008_4000	0x4008_4FFF
	SDMMC1	4KB	0x4008_5000	0x4008_5FFF	0x4008_5000	0x4008_5FFF	0x4008_5000	0x4008_5FFF
	SDMMC2	4KB	0x4008_6000	0x4008_6FFF	0x4008_6000	0x4008_6FFF	0x4008_6000	0x4008_6FFF
	USBC	4KB	0x4008_7000	0x4008_7FFF	0x4008_7000	0x4008_7FFF	0x4008_7000	0x4008_7FFF
	V2D_GPU	4KB	0x4008_8000	0x4008_8FFF	0x4008_8000	0x4008_8FFF	0x4008_8000	0x4008_8FFF
	JPEG_ENC	4KB	0x4008_9000	0x4008_9FFF	0x4008_9000	0x4008_9FFF	0x4008_9000	0x4008_9FFF
	JPEG_DEC	4KB	0x4008_A000	0x4008_AFFF	0x4008_A000	0x4008_AFFF	0x4008_A000	0x4008_AFFF
	CRC1	4KB	0x4008_B000	0x4008_BFFF	0x4008_B000	0x4008_BFFF	0x4008_B000	0x4008_BFFF
	Reserved	16KB	0x4008_C000	0x4008_FFFF	0x4008_C000	0x4008_FFFF	0x4008_C000	0x4008_FFFF
	GFX_RAM	64KB	0x4009_0000	0x4009_FFFF	0x4009_0000	0x4009_FFFF	0x4009_0000	0x4009_FFFF
	Reserved	128KB	0x400A_0000	0x400B_FFFF	0x400A_0000	0x400B_FFFF	0x400A_0000	0x400B_FFFF

1.3.5 中断列表

表 1-2: HCPU 中断列表

IRQ #	IRQ Source
NMI	WDT1
IRQ[0]	AON
IRQ[1]	LCPU_IRQ[1]
IRQ[2]	LCPU_IRQ[2]
IRQ[3]	LCPU_IRQ[3]
IRQ[4]	LCPU_IRQ[4]
IRQ[5]	LCPU_IRQ[5]
IRQ[6]	LCPU_IRQ[6]
IRQ[7]	LCPU_IRQ[7]
IRQ[8]	LCPU_IRQ[8]
IRQ[9]	LCPU_IRQ[9]
IRQ[10]	LCPU_IRQ[10]
IRQ[11]	LCPU_IRQ[11]
IRQ[12]	LCPU_IRQ[12]
IRQ[13]	LCPU_IRQ[13]
IRQ[14]	LCPU_IRQ[14]
IRQ[15]	LCPU_IRQ[15]
IRQ[16]	LCPU_IRQ[16]
IRQ[17]	LCPU_IRQ[17]
IRQ[18]	LCPU_IRQ[18]
IRQ[19]	LCPU_IRQ[19]
IRQ[20]	LCPU_IRQ[20]
IRQ[21]	LCPU_IRQ[21]
IRQ[22]	LCPU_IRQ[22]
IRQ[23]	LCPU_IRQ[23]
IRQ[24]	LCPU_IRQ[24]
IRQ[25]	LCPU_IRQ[25]
IRQ[26]	LCPU_IRQ[26]
IRQ[27]	LCPU_IRQ[27]
IRQ[28]	LCPU_IRQ[28]
IRQ[29]	LCPU_IRQ[29]
IRQ[30]	LCPU_IRQ[30]
IRQ[31]	LCPU_IRQ[31]
IRQ[32]	LCPU_IRQ[32]
IRQ[33]	LCPU_IRQ[33]
IRQ[34]	LCPU_IRQ[34]
IRQ[35]	LCPU_IRQ[35]
IRQ[36]	LCPU_IRQ[36]
IRQ[37]	LCPU_IRQ[37]
IRQ[38]	LCPU_IRQ[38]
IRQ[39]	LCPU_IRQ[39]
IRQ[40]	LCPU_IRQ[40]
IRQ[41]	LCPU_IRQ[41]
IRQ[42]	LCPU_IRQ[42]
IRQ[43]	LCPU_IRQ[43]
IRQ[44]	LCPU_IRQ[44]

续表下页...

表 1-2: HCPU 中断列表 (续)

IRQ #	IRQ Source
IRQ[45]	LCPU_IRQ[45]
IRQ[46]	LPTIM1
IRQ[47]	rsvd
IRQ[48]	rsvd
IRQ[49]	RTC
IRQ[50]	DMAC1_CH1
IRQ[51]	DMAC1_CH2
IRQ[52]	DMAC1_CH3
IRQ[53]	DMAC1_CH4
IRQ[54]	DMAC1_CH5
IRQ[55]	DMAC1_CH6
IRQ[56]	DMAC1_CH7
IRQ[57]	DMAC1_CH8
IRQ[58]	LCPU2HCPU
IRQ[59]	USART1
IRQ[60]	SPI1
IRQ[61]	I2C1
IRQ[62]	EPIC
IRQ[63]	LCDC1
IRQ[64]	I2S1
IRQ[65]	I2S2
IRQ[66]	EFUSEC
IRQ[67]	AES
IRQ[68]	PTC1
IRQ[69]	TRNG
IRQ[70]	GPTIM1
IRQ[71]	GPTIM2
IRQ[72]	BTIM1
IRQ[73]	BTIM2
IRQ[74]	USART2
IRQ[75]	SPI2
IRQ[76]	I2C2
IRQ[77]	EXTDMA
IRQ[78]	ACPU2HCPU
IRQ[79]	SDMMC1
IRQ[80]	SDMMC2
IRQ[81]	NNACC1
IRQ[82]	PDM1
IRQ[83]	DSI
IRQ[84]	GPIO1
IRQ[85]	MPI1
IRQ[86]	MPI2
IRQ[87]	MPI3
IRQ[88]	MPI4
IRQ[89]	EZIP1
IRQ[90]	EZIP2
IRQ[91]	PDM2
IRQ[92]	USBC

续表下页...

表 1-2: HCPU 中断列表 (续)

IRQ #	IRQ Source
IRQ[93]	I2C3
IRQ[94]	ATIM1
IRQ[95]	ATIM2
IRQ[96]	DMAC2_CH1
IRQ[97]	DMAC2_CH2
IRQ[98]	DMAC2_CH3
IRQ[99]	DMAC2_CH4
IRQ[100]	DMAC2_CH5
IRQ[101]	DMAC2_CH6
IRQ[102]	DMAC2_CH7
IRQ[103]	DMAC2_CH8
IRQ[104]	V2D_GPU
IRQ[105]	JPEG_ENC
IRQ[106]	JPEG_DEC
IRQ[107]	USART3
IRQ[108]	FFT1
IRQ[109]	FACC1
IRQ[110]	CAN1
IRQ[111]	CAN2
IRQ[112]	AUDPRC
IRQ[113]	AUD_HP
IRQ[114]	SCI
IRQ[115]	I2C4

表 1-3: ACPU 中断列表

IRQ #	IRQ Source
NMI	WDT1
IRQ[0]	AON
IRQ[1]	LCPU_IRQ[1]
IRQ[2]	LCPU_IRQ[2]
IRQ[3]	LCPU_IRQ[3]
IRQ[4]	LCPU_IRQ[4]
IRQ[5]	LCPU_IRQ[5]
IRQ[6]	LCPU_IRQ[6]
IRQ[7]	LCPU_IRQ[7]
IRQ[8]	LCPU_IRQ[8]
IRQ[9]	LCPU_IRQ[9]
IRQ[10]	LCPU_IRQ[10]
IRQ[11]	LCPU_IRQ[11]
IRQ[12]	LCPU_IRQ[12]
IRQ[13]	LCPU_IRQ[13]
IRQ[14]	LCPU_IRQ[14]
IRQ[15]	LCPU_IRQ[15]
IRQ[16]	LCPU_IRQ[16]
IRQ[17]	LCPU_IRQ[17]
IRQ[18]	LCPU_IRQ[18]
IRQ[19]	LCPU_IRQ[19]

续表下页...

表 1-3: ACPU 中断列表 (续)

IRQ #	IRQ Source
IRQ[20]	LCPU_IRQ[20]
IRQ[21]	LCPU_IRQ[21]
IRQ[22]	LCPU_IRQ[22]
IRQ[23]	LCPU_IRQ[23]
IRQ[24]	LCPU_IRQ[24]
IRQ[25]	LCPU_IRQ[25]
IRQ[26]	LCPU_IRQ[26]
IRQ[27]	LCPU_IRQ[27]
IRQ[28]	LCPU_IRQ[28]
IRQ[29]	LCPU_IRQ[29]
IRQ[30]	LCPU_IRQ[30]
IRQ[31]	LCPU_IRQ[31]
IRQ[32]	LCPU_IRQ[32]
IRQ[33]	LCPU_IRQ[33]
IRQ[34]	LCPU_IRQ[34]
IRQ[35]	LCPU_IRQ[35]
IRQ[36]	LCPU_IRQ[36]
IRQ[37]	LCPU_IRQ[37]
IRQ[38]	LCPU_IRQ[38]
IRQ[39]	LCPU_IRQ[39]
IRQ[40]	LCPU_IRQ[40]
IRQ[41]	LCPU_IRQ[41]
IRQ[42]	LCPU_IRQ[42]
IRQ[43]	LCPU_IRQ[43]
IRQ[44]	LCPU_IRQ[44]
IRQ[45]	LCPU_IRQ[45]
IRQ[46]	LPTIM1
IRQ[47]	rsvd
IRQ[48]	rsvd
IRQ[49]	RTC
IRQ[50]	DMAC1_CH1
IRQ[51]	DMAC1_CH2
IRQ[52]	DMAC1_CH3
IRQ[53]	DMAC1_CH4
IRQ[54]	DMAC1_CH5
IRQ[55]	DMAC1_CH6
IRQ[56]	DMAC1_CH7
IRQ[57]	DMAC1_CH8
IRQ[58]	LCPU2ACPU
IRQ[59]	USART1
IRQ[60]	SPI1
IRQ[61]	I2C1
IRQ[62]	EPIC
IRQ[63]	LCDC1
IRQ[64]	I2S1
IRQ[65]	I2S2
IRQ[66]	EFUSEC
IRQ[67]	AES

续表下页...

表 1-3: ACPU 中断列表 (续)

IRQ #	IRQ Source
IRQ[68]	PTC1
IRQ[69]	TRNG
IRQ[70]	GPTIM1
IRQ[71]	GPTIM2
IRQ[72]	BTIM1
IRQ[73]	BTIM2
IRQ[74]	USART2
IRQ[75]	SPI2
IRQ[76]	I2C2
IRQ[77]	EXTDMA
IRQ[78]	HCPU2ACPU
IRQ[79]	SDMMC1
IRQ[80]	SDMMC2
IRQ[81]	NNACC1
IRQ[82]	PDM1
IRQ[83]	DSI
IRQ[84]	GPIO1
IRQ[85]	MPI1
IRQ[86]	MPI2
IRQ[87]	MPI3
IRQ[88]	MPI4
IRQ[89]	EZIP1
IRQ[90]	EZIP2
IRQ[91]	PDM2
IRQ[92]	USBC
IRQ[93]	I2C3
IRQ[94]	ATIM1
IRQ[95]	ATIM2
IRQ[96]	DMAC2_CH1
IRQ[97]	DMAC2_CH2
IRQ[98]	DMAC2_CH3
IRQ[99]	DMAC2_CH4
IRQ[100]	DMAC2_CH5
IRQ[101]	DMAC2_CH6
IRQ[102]	DMAC2_CH7
IRQ[103]	DMAC2_CH8
IRQ[104]	V2D_GPU
IRQ[105]	JPEG_ENC
IRQ[106]	JPEG_DEC
IRQ[107]	USART3
IRQ[108]	FFT1
IRQ[109]	FACC1
IRQ[110]	CAN1
IRQ[111]	CAN2
IRQ[112]	AUDPRC
IRQ[113]	AUD_HP
IRQ[114]	SCI
IRQ[115]	I2C4

1.4 低功耗处理器（小核）系统（LPSYS）

1.4.1 总线架构

LPSYS 内部提供了基于 AHB 协议的总线矩阵，支持多个主设备并行访问多个从设备地址空间。

LCPU 与 DMAC3 能够访问 LPSYS 的所有地址空间，并能通过 LP2HP 跨域访问除 HPSYS_ITCM 和 Retention RAM 以外 HPSYS 的所有地址空间。

HPSYS 的部分主设备能够通过 HP2LP 跨域访问 LPSYS 的所有地址空间。

LPSYS_ITCM 与 LPSYS_DTCM 能够被 LCPU 和 DMAC3 访问，也能够被 HPSYS 的部分主设备跨域访问。

多个主设备同时访问同一个从设备地址空间时，基于轮询仲裁原则决定访问次序。

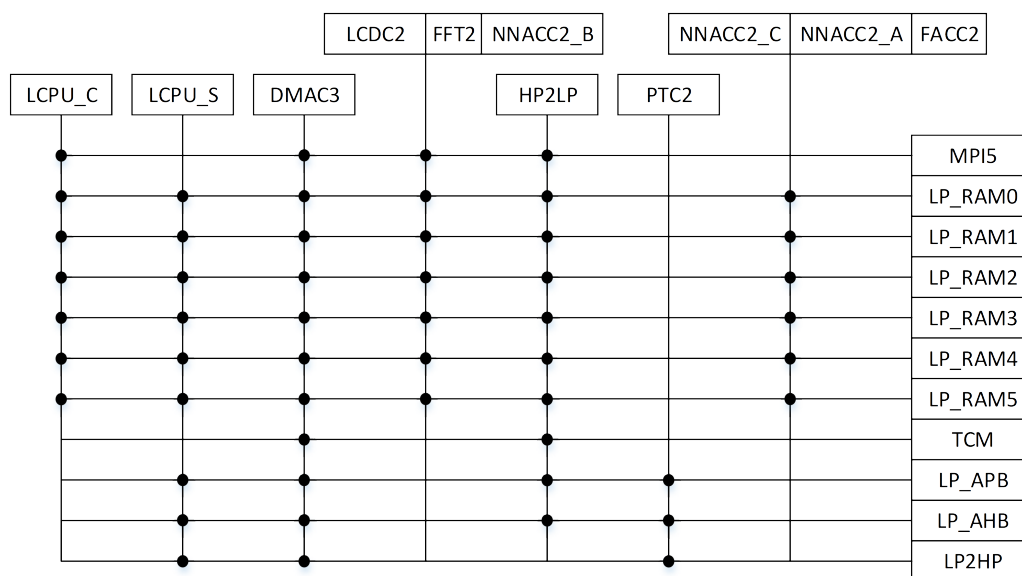


图 1-4: 低功耗处理器（小核）系统总线架构

1.4.2 时钟架构

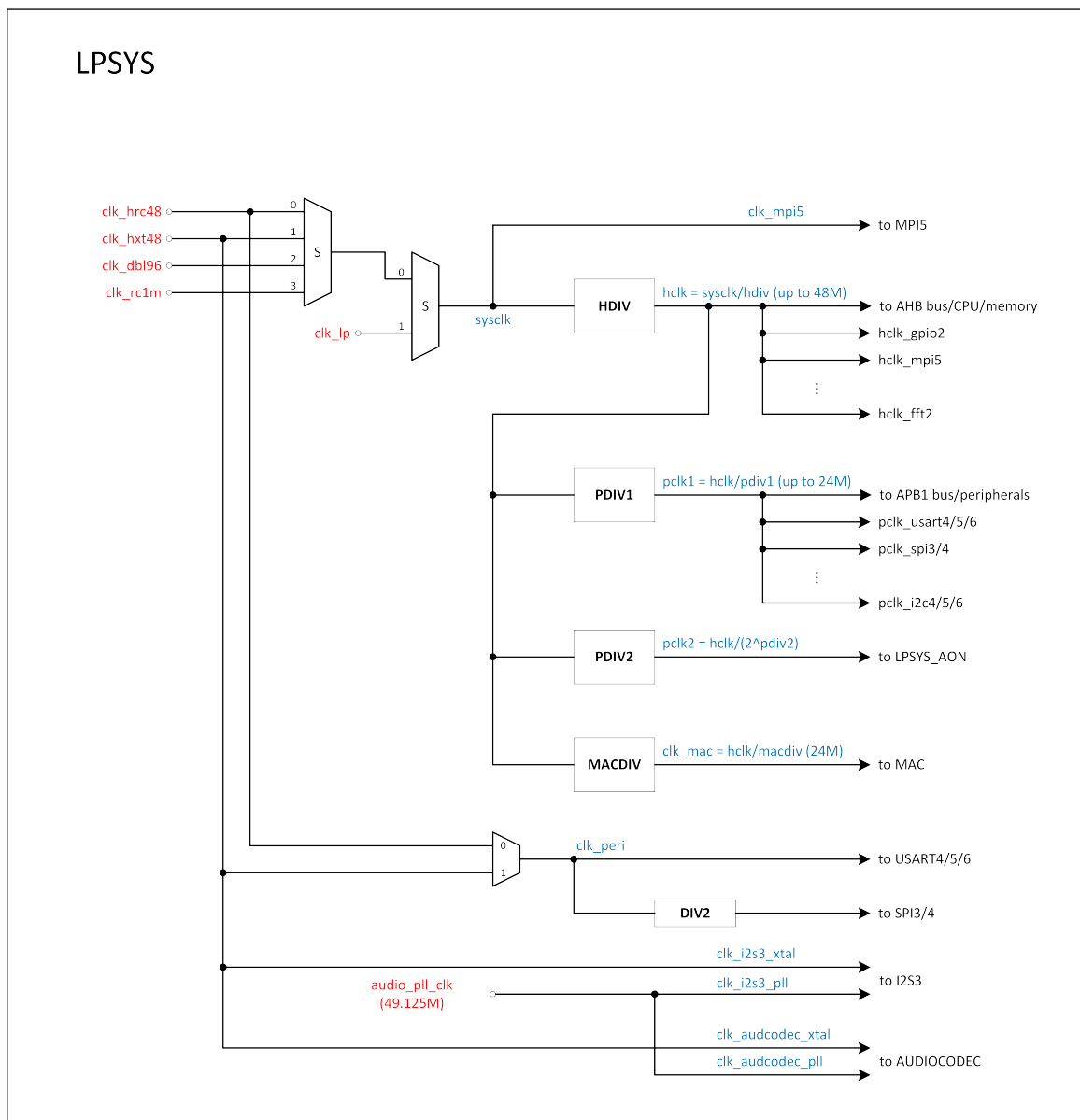


图 1-5: LPSYS 时钟架构

1.4.3 存储器类型

1.4.3.1 Cache

LCPU 配置有 16KB 2-way I-Cache（一级指令缓存）和 16KB 4-way D-Cache（一级数据缓存）。

1.4.3.2 TCM

LCPU 配置有 16KB zero-wait-cycle I-TCM，地址空间为 0x003F_C000 - 0x003F_FFFF。该 TCM memory 为 LCPU 专用，HCPU 可通过地址段 0x20BF_C000 - 0x20BF_FFFF 对其进行初始化。建议放置对实时性（或者时延确定性）要求较高的代码和数据。

LCPU 同时配置有 16KB zero-wait-cycle D-TCM，地址空间为 0x203F_C000 - 0x203F_FFFF。该 TCM memory 为 LCPU 专用，HCPU 可通过相同地址空间对其进行初始化。

1.4.3.3 SRAM

LPSYS 总线上共有 1024KB one-wait-cycle SRAM，最高频率为 96M，地址空间为 0x2040_0000 - 0x204F_FFFF。

1.4.3.4 片外 Flash

LPSYS 默认外挂 NOR FLASH 用于系统启动，地址空间为 0x1C00_0000 - 0x1FFF_FFFF。

表 1-4: LPSYS 地址映射

Category	Memory /IP	Address space	HCPU				LCPU				ACPU			
			Starting Address		Ending Address		Starting Address		Ending Address		Starting Address		Ending Address	
LPSYS_ITCM		4MB	0x2080_0000		0x20BF_FFFF		0x0000_0000		0x003F_FFFF		0x2080_0000		0x20BF_FFFF	
	ROM	1MB	0x2080_0000		0x208F_FFFF		0x0000_0000		0x000F_FFFF		0x2080_0000		0x208F_FFFF	
	Reserved	-	-		-		-		-		-		-	
	RAM	16KB	0x20BF_C000		0x20BF_FFFF		0x003F_C000		0x003F_FFFF		0x20BF_C000		0x20BF_FFFF	
LPSYS_DTCM		4MB	0x2000_0000		0x203F_FFFF		0x2000_0000		0x203F_FFFF		0x2000_0000		0x203F_FFFF	
	Reserved	-	-		-		-		-		-		-	
	RAM	16KB	0x203F_C000		0x203F_FFFF		0x203F_C000		0x203F_FFFF		0x203F_C000		0x203F_FFFF	
External Memory		64MB	0x1C00_0000		0x1FFF_FFFF		0x1C00_0000		0x1FFF_FFFF		0x1C00_0000		0x1FFF_FFFF	
	MPI5 Memory	64MB	0x1C00_0000		0x1FFF_FFFF		0x1C00_0000		0x1FFF_FFFF		0x1C00_0000		0x1FFF_FFFF	
LPSYS_RAM		1MB	0x20C0_0000	0x2040_0000	0x20CF_FFFF	0x204F_FFFF	0x0040_0000	0x2040_0000	0x004F_FFFF	0x204F_FFFF	0x20C0_0000	0x2040_0000	0x20CF_FFFF	0x204F_FFFF
	RAM0	128KB	0x20C0_0000	0x2040_0000	0x20C1_FFFF	0x2041_FFFF	0x0040_0000	0x2040_0000	0x0041_FFFF	0x2041_FFFF	0x20C0_0000	0x2040_0000	0x20C1_FFFF	0x2041_FFFF
	RAM1	128KB	0x20C2_0000	0x2042_0000	0x20C3_FFFF	0x2043_FFFF	0x0042_0000	0x2042_0000	0x0043_FFFF	0x2043_FFFF	0x20C2_0000	0x2042_0000	0x20C3_FFFF	0x2043_FFFF
	RAM2	256KB	0x20C4_0000	0x2044_0000	0x20C7_FFFF	0x2047_FFFF	0x0044_0000	0x2044_0000	0x0047_FFFF	0x2047_FFFF	0x20C4_0000	0x2044_0000	0x20C7_FFFF	0x2047_FFFF
	RAM3	256KB	0x20C8_0000	0x2048_0000	0x20CB_FFFF	0x204B_FFFF	0x0048_0000	0x2048_0000	0x004B_FFFF	0x204B_FFFF	0x20C8_0000	0x2048_0000	0x20CB_FFFF	0x204B_FFFF
	RAM4	128KB	0x20CC_0000	0x204C_0000	0x20CD_FFFF	0x204D_FFFF	0x004C_0000	0x204C_0000	0x004D_FFFF	0x204D_FFFF	0x20CC_0000	0x204C_0000	0x20CD_FFFF	0x204D_FFFF
	RAM5 (EM)	128KB	0x20CE_0000	0x204E_0000	0x20CF_FFFF	0x204F_FFFF	0x004E_0000	0x204E_0000	0x004F_FFFF	0x204F_FFFF	0x20CE_0000	0x204E_0000	0x20CF_FFFF	0x204F_FFFF
LPSYS_APB1		192KB	0x5000_0000		0x5003_FFFF		0x5000_0000		0x5003_FFFF		0x5000_0000		0x5003_FFFF	
	RCC2	4KB	0x5000_0000		0x5000_0FFF		0x5000_0000		0x5000_0FFF		0x5000_0000		0x5000_0FFF	
	DMAC3	4KB	0x5000_1000		0x5000_1FFF		0x5000_1000		0x5000_1FFF		0x5000_1000		0x5000_1FFF	
	MAILBOX2	4KB	0x5000_2000		0x5000_2FFF		0x5000_2000		0x5000_2FFF		0x5000_2000		0x5000_2FFF	
	PINMUX2	4KB	0x5000_3000		0x5000_3FFF		0x5000_3000		0x5000_3FFF		0x5000_3000		0x5000_3FFF	
	PATCH	4KB	0x5000_4000		0x5000_4FFF		0x5000_4000		0x5000_4FFF		0x5000_4000		0x5000_4FFF	
	USART4	4KB	0x5000_5000		0x5000_5FFF		0x5000_5000		0x5000_5FFF		0x5000_5000		0x5000_5FFF	
	USART5	4KB	0x5000_6000		0x5000_6FFF		0x5000_6000		0x5000_6FFF		0x5000_6000		0x5000_6FFF	
	USART6	4KB	0x5000_7000		0x5000_7FFF		0x5000_7000		0x5000_7FFF		0x5000_7000		0x5000_7FFF	
	I2S3	4KB	0x5000_8000		0x5000_8FFF		0x5000_8000		0x5000_8FFF		0x5000_8000		0x5000_8FFF	
	SP13	4KB	0x5000_9000		0x5000_9FFF		0x5000_9000		0x5000_9FFF		0x5000_9000		0x5000_9FFF	
	SP14	4KB	0x5000_A000		0x5000_AFFF		0x5000_A000		0x5000_AFFF		0x5000_A000		0x5000_AFFF	
	WDT2	4KB	0x5000_B000		0x5000_BFFF		0x5000_B000		0x5000_BFFF		0x5000_B000		0x5000_BFFF	
	I2C5	4KB	0x5000_C000		0x5000_CFFF		0x5000_C000		0x5000_CFFF		0x5000_C000		0x5000_CFFF	
	I2C6	4KB	0x5000_D000		0x5000_DFFF		0x5000_D000		0x5000_DFFF		0x5000_D000		0x5000_DFFF	
	I2C7	4KB	0x5000_E000		0x5000_EFFF		0x5000_E000		0x5000_EFFF		0x5000_E000		0x5000_EFFF	
	SYSCFG2	4KB	0x5000_F000		0x5000_FFFF		0x5000_F000		0x5000_FFFF		0x5000_F000		0x5000_FFFF	
	GPTIM3	4KB	0x5001_0000		0x5001_0FFF		0x5001_0000		0x5001_0FFF		0x5001_0000		0x5001_0FFF	
	GPTIM4	4KB	0x5001_1000		0x5001_1FFF		0x5001_1000		0x5001_1FFF		0x5001_1000		0x5001_1FFF	
	GPTIM5	4KB	0x5001_2000		0x5001_2FFF		0x5001_2000		0x5001_2FFF		0x5001_2000		0x5001_2FFF	
	BTIM3	4KB	0x5001_3000		0x5001_3FFF		0x5001_3000		0x5001_3FFF		0x5001_3000		0x5001_3FFF	
	BTIM4	4KB	0x5001_4000		0x5001_4FFF		0x5001_4000		0x5001_4FFF		0x5001_4000		0x5001_4FFF	
	NNACC2	4KB	0x5001_5000		0x5001_5FFF		0x5001_5000		0x5001_5FFF		0x5001_5000		0x5001_5FFF	
	GPADC	4KB	0x5001_6000		0x5001_6FFF		0x5001_6000		0x5001_6FFF		0x5001_6000		0x5001_6FFF	
	SDADC	4KB	0x5001_7000		0x5001_7FFF		0x5001_7000		0x5001_7FFF		0x5001_7000		0x5001_7FFF	
	AUDADC	4KB	0x5001_8000		0x5001_8FFF		0x5001_8000		0x5001_8FFF		0x5001_8000		0x5001_8FFF	
	LPCOMP	4KB	0x5001_9000		0x5001_9FFF		0x5001_9000		0x5001_9FFF		0x5001_9000		0x5001_9FFF	
	TSEN	4KB	0x5001_A000		0x5001_AFFF		0x5001_A000		0x5001_AFFF		0x5001_A000		0x5001_AFFF	
	PTC2	4KB	0x5001_B000		0x5001_BFFF		0x5001_B000		0x5001_BFFF		0x5001_B000		0x5001_BFFF	
	LCDC2	4KB	0x5001_C000		0x5001_CFFF		0x5001_C000		0x5001_CFFF		0x5001_C000		0x5001_CFFF	
	BUSMON3	4KB	0x5001_D000		0x5001_DFFF		0x5001_D000		0x5001_DFFF		0x5001_D000		0x5001_DFFF	
	FFT2	4KB	0x5001_E000		0x5001_EFFF		0x5001_E000		0x5001_EFFF		0x5001_E000		0x5001_EFFF	
	FACC2	4KB	0x5001_F000		0x5001_FFFF		0x5001_F000		0x5001_FFFF		0x5001_F000		0x5001_FFFF	
	Reserved	64KB	0x5002_0000		0x5002_FFFF		0x5002_0000		0x5002_FFFF		0x5002_0000		0x5002_FFFF	
	Reserved	64KB	0x5003_0000		0x5003_FFFF		0x5003_0000		0x5003_FFFF		0x5003_0000		0x5003_FFFF	

1.4.4 地址映射

表 1-4: LPSYS 地址映射 (续)

Category	Memory /IP	Address space	HCPU		LCPU		ACPU	
			Starting Address	Ending Address	Starting Address	Ending Address	Starting Address	Ending Address
LPSYS_APB2		64KB	0x5004_0000	0x5007_FFFF	0x5004_0000	0x5007_FFFF	0x5004_0000	0x5007_FFFF
	LPSYS_AON	4KB	0x5004_0000	0x5004_0FFF	0x5004_0000	0x5004_0FFF	0x5004_0000	0x5004_0FFF
	LPTIM2	4KB	0x5004_1000	0x5004_1FFF	0x5004_1000	0x5004_1FFF	0x5004_1000	0x5004_1FFF
	LPTIM3	4KB	0x5004_2000	0x5004_2FFF	0x5004_2000	0x5004_2FFF	0x5004_2000	0x5004_2FFF
	Reserved	4KB	0x5004_3000	0x5004_3FFF	0x5004_3000	0x5004_3FFF	0x5004_3000	0x5004_3FFF
	Reserved	24KB	0x5004_4000	0x5004_9FFF	0x5004_4000	0x5004_9FFF	0x5004_4000	0x5004_9FFF
	PMUC	4KB	0x5004_A000	0x5004_AFFF	0x5004_A000	0x5004_AFFF	0x5004_A000	0x5004_AFFF
	RTC	4KB	0x5004_B000	0x5004_BFFF	0x5004_B000	0x5004_BFFF	0x5004_B000	0x5004_BFFF
	IWDI	4KB	0x5004_C000	0x5004_CFFF	0x5004_C000	0x5004_CFFF	0x5004_C000	0x5004_CFFF
	Reserved	12KB	0x5004_D000	0x5004_FFFF	0x5004_D000	0x5004_FFFF	0x5004_D000	0x5004_FFFF
	Reserved	64KB	0x5005_0000	0x5005_FFFF	0x5005_0000	0x5005_FFFF	0x5005_0000	0x5005_FFFF
	Reserved	64KB	0x5006_0000	0x5006_FFFF	0x5006_0000	0x5006_FFFF	0x5006_0000	0x5006_FFFF
	EUROPA	4KB	0x5007_0000	0x5007_0FFF	0x5007_0000	0x5007_0FFF	0x5007_0000	0x5007_0FFF
	Reserved	60KB	0x5007_1000	0x5007_FFFF	0x5007_1000	0x5007_FFFF	0x5007_1000	0x5007_FFFF
LPSYS_AHB		256KB	0x5008_0000	0x500B_FFFF	0x5008_0000	0x500B_FFFF	0x5008_0000	0x500B_FFFF
	GPIO2	4KB	0x5008_0000	0x5008_0FFF	0x5008_0000	0x5008_0FFF	0x5008_0000	0x5008_0FFF
	MPI5	4KB	0x5008_1000	0x5008_1FFF	0x5008_1000	0x5008_1FFF	0x5008_1000	0x5008_1FFF
	RFC	8KB	0x5008_2000	0x5008_3FFF	0x5008_2000	0x5008_3FFF	0x5008_2000	0x5008_3FFF
	PHY	4KB	0x5008_4000	0x5008_4FFF	0x5008_4000	0x5008_4FFF	0x5008_4000	0x5008_4FFF
	CRC2	4KB	0x5008_5000	0x5008_5FFF	0x5008_5000	0x5008_5FFF	0x5008_5000	0x5008_5FFF
	Reserved	40KB	0x5008_6000	0x5008_FFFF	0x5008_6000	0x5008_FFFF	0x5008_6000	0x5008_FFFF
	MAC	64KB	0x5009_0000	0x5009_FFFF	0x5009_0000	0x5009_FFFF	0x5009_0000	0x5009_FFFF
	Reserved	128KB	0x500A_0000	0x500B_FFFF	0x500A_0000	0x500B_FFFF	0x500A_0000	0x500B_FFFF
PHY_DUMP		64KB	0x500C_0000	0x500C_FFFF	0x500C_0000	0x500C_FFFF	0x500C_0000	0x500C_FFFF

1.4.5 中断列表

表 1-5: LCPU 中断列表

IRQ #	IRQ Source
NMI	WDT2
IRQ[0]	AON
IRQ[1]	BLE
IRQ[2]	DMAC3_CH1
IRQ[3]	DMAC3_CH2
IRQ[4]	DMAC3_CH3
IRQ[5]	DMAC3_CH4
IRQ[6]	DMAC3_CH5
IRQ[7]	DMAC3_CH6
IRQ[8]	DMAC3_CH7
IRQ[9]	DMAC3_CH8
IRQ[10]	PATCH
IRQ[11]	DM
IRQ[12]	USART4
IRQ[13]	USART5
IRQ[14]	USART6
IRQ[15]	BT
IRQ[16]	SPI3
IRQ[17]	SPI4
IRQ[18]	I2S3
IRQ[19]	I2C5
IRQ[20]	I2C6
IRQ[21]	I2C7
IRQ[22]	GPTIM3
IRQ[23]	GPTIM4
IRQ[24]	GPTIM5
IRQ[25]	BTIM3
IRQ[26]	BTIM4
IRQ[27]	AUD_LP
IRQ[28]	GPADC
IRQ[29]	SDADC
IRQ[30]	HPSYS0
IRQ[31]	HPSYS1
IRQ[32]	TSEN
IRQ[33]	PTC2
IRQ[34]	LCDC2
IRQ[35]	GPIO2
IRQ[36]	MPI5
IRQ[37]	NNACC2
IRQ[38]	FFT2
IRQ[39]	FACC2
IRQ[40]	ACPU2LCPU
IRQ[41]	LPCOMP
IRQ[42]	LPTIM2
IRQ[43]	LPTIM3
IRQ[44]	HPSYS2

续表下页...

表 1-5: LCPU 中断列表 (续)

IRQ #	IRQ Source
IRQ[45]	HPSYS3
IRQ[46]	HCPU2LCPU
IRQ[47]	RTC

1.5 电源管理

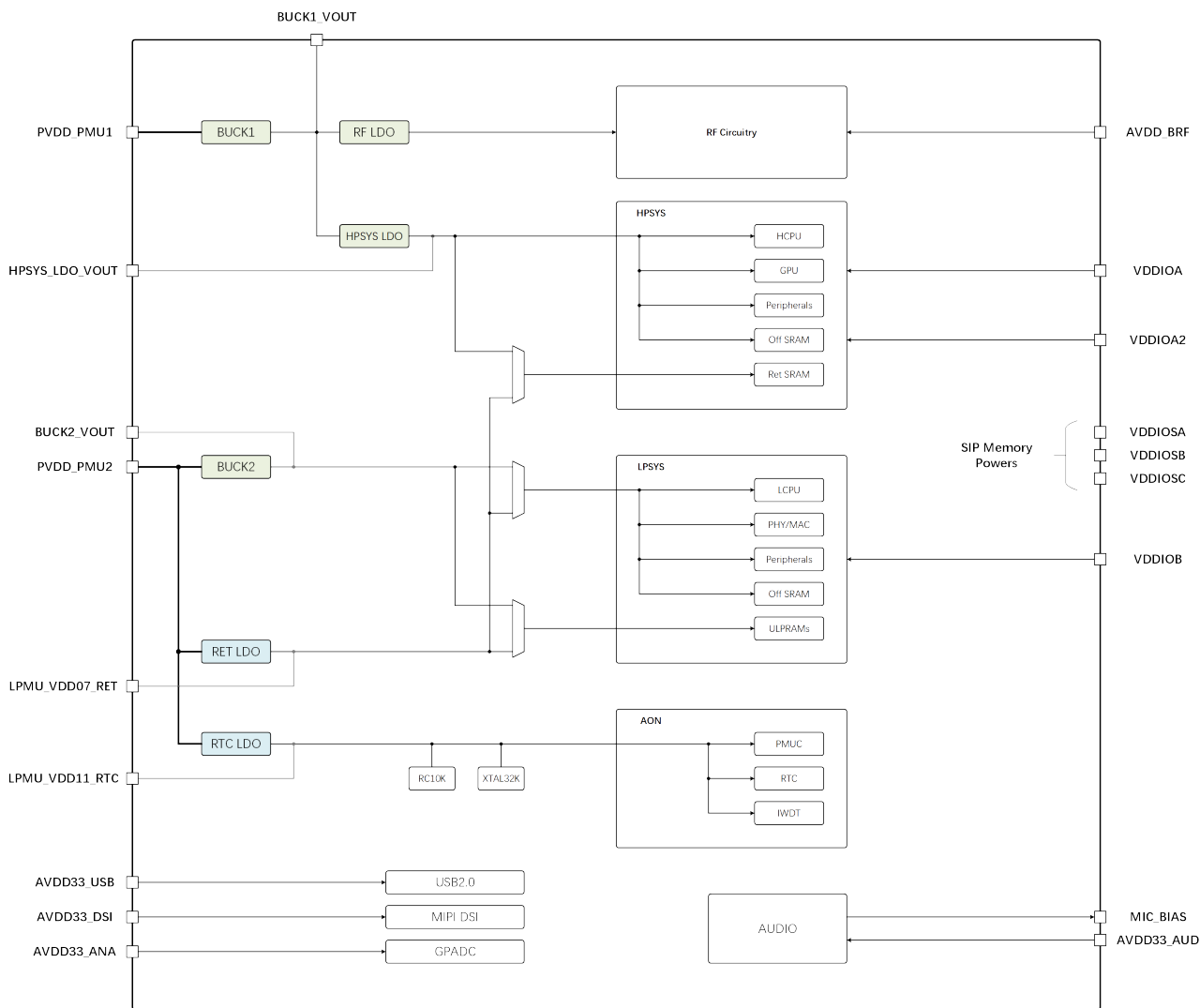


图 1-6: 电源管理架构

2 高性能专用计算

2.1 ePicasso™ 高性能 2.5D 图形引擎

在 2.5D 图像处理中, 有许多常见的图像运算会耗费大量的 CPU 计算资源。ePicasso™ 则是专为 2.5D 图像运算设计的加速引擎, 能够对 2.5D 图像运算中常见图层叠加、缩放、旋转等功能提供指数级的速度提升。除此以外, ePicasso™ 能够兼容各种常见的 RGB 图像格式, 简化了系统中不同格式的图像格式转换。

2.1.1 图层叠加

ePicasso™ 最多支持四个前景图层, 一个专用的掩膜图层, 和一个单色背景图层叠加, 输入和输出格式包括常用 RGB565、RGB888、ARGB8565、ARGB8888、L8、A8、A4。每个前景图层有独立的叠加模式和叠加区域, 掩膜图层主要是提取图像中特定的形状。除此以外, 每个图层还提供了单独的 filter 配置选项, 可以使图层滤除某一特定的颜色, 该功能可用于简单的图像捕获。

2.1.2 图形缩放

ePicasso™ 有一个图层称为功能图层, 除了支持叠加的功能外, 这个功能图层还能够实现图形的缩放。缩放最大比例可以到达 1024 倍, 精度则可以达到 1/65536。在 X 和 Y 方向上, 缩放的比例可以分别配置, 以此适应各种不同的需求。

2.1.3 图形旋转

ePicasso™ 的功能图层除了可以支持缩放的功能以外, 还能够支持图像的高精度旋转。用户可以自定义旋转角的 sin/cos 值, 来满足任意角度的旋转需求。旋转和缩放的功能可以同时启用, 一次性完成图像的两种操作, 提高了图像处理的性能。

2.2 Vivante GCNanoUltraV 高性能矢量绘图 GPU

GCNanoUltraV 是针对 MCU 平台的矢量绘图 GPU, 相比传统平台上的 GPU, GCNanoUltraV 具有功耗低、面积小以及对内存需求低的特点。与其配套的图形库也经过优化, 能更好地匹配 MCU 平台。

2.2.1 坐标系统变换

GCNanoUltraV 支持基于 3×3 矩阵的坐标系统变换, 依靠坐标的变换, 可以使对应的图形产生对应的形变。

2.2.2 图层叠加

GCNanoUltraV 支持至多 14 种不同的像素格式以及 8 种基于 Porter-Duff 规则的图层叠加方式。

2.2.3 填充

GCNanoUltraV 支持的填充方式有 non-zero 填充和 odd/even 填充。

2.2.4 绘图

GCNanoUltraV 可以绘制直线以及曲线路径，色彩上可以做到单色填充和渐变色填充。

2.2.5 图层压缩

GCNanoUltraV 支持 etc2 的压缩格式，读取图层时可以直接读取 etc2 格式的图像，etc2 作为有损压缩，压缩比可以达到 1:4，使用经过压缩的素材可以节省资源存储的空间。

2.3 JPEG 编解码加速器

在 MCU 平台中，图像的存储一直耗费了大量的内存空间。常见的压缩例如 JPEG 可以极大地节省图像存储空间，但同时也会消耗大量运算资源。硬件 JPEG 编解码加速器则可以依靠强大的 JPEG 编解码能力，高效实现 JPEG 图像的运算，不仅节省了存储空间，也极大地缩短了运算时间。

2.3.1 JPEG 编码器

编码器支持 JPEG Baseline 模式，输入格式支持 YUV420、YUV422、RGB444、RGB555、RGB565、RGB888 等。输出格式支持 JFIF format 1.02 以及 Non-Progressive JPEG。分辨率最大支持到 4K × 4K。

2.3.2 JPEG 解码器

解码器支持 JPEG Baseline 模式，输入格式支持 JFIF format 1.02、YUV420、YUV422、YUV444 sampling formats。输出格式支持 YUV 转 RGB，兼容 BT.601 和 BT.709 标准，也可以自定义转换标准。输出后处理支持图像缩放与裁剪，分辨率最大支持到 4K×4K。

2.4 LCD 控制器

LCD 控制器主要用于将 Framebuffer 内数据输出至外部显示，现有的 LCD 控制器可以支持常用的屏幕接口包括 DBI、DPI 和 DSI。此外，LCD 控制器还支持压缩格式的图像，使用压缩格式的图像可以显著降低 memory 的使用带宽，提升系统的性能。

2.4.1 TurboPixel™ 帧缓存压缩

为了提高图像的帧率和显示的平滑度，多个（两个或三个）帧缓存（Frame Buffer）是经常被使用的架构。通常来说为了将图像输出和图像处理并行化，需要专用的帧缓存用于向屏幕输出图像数据。为了能够减小这些帧缓存的存储空间和读取时候的带宽，MCU 系统中提供了基于自主算法的 TurboPixel™ 图像帧压缩模块。而在读取图像数据时，LCD 控制器中的解压缩模块可以直接读取压缩数据，并将解压缩后的数据输出到屏幕。这样就可以节省下帧缓存的存储空间和读取消耗的带宽资源。

2.4.2 显示接口

LCD 控制器主要完成显示用数据到主流显示接口之间的适配，本芯片支持的显示接口有：

2.4.2.1 MIPI-DBI

LCD 控制器可以支持 DBI 接口中的串行 SPI 模式和并行的 8080 模式。对于 SPI 模式, LCD 控制器可以支持 3 线和 4 线两种模式, 同时也支持 dual/quad data line 两种工作方式。色彩格式上支持 8-bit RGB332、16-bit RGB565 和 24-bit RGB888。对于 8080 模式, LCD 控制器可以支持 8-bit、16-bit 和 24-bit 的总线位宽, 同时支持 RGB332、RGB444、RGB565、RGB666、RGB888 等色彩格式。

2.4.2.2 MIPI-DPI

为了支持没有内置缓存的屏幕, LCD 控制器加入了对 DPI 接口的支持。LCD 控制的 DPI 接口数据位宽为 24bit, 可以很好地支持 RGB565 和 RGB888 的色彩格式。此外, LCD 控制器提供了灵活的 VBP、VFP、HBP 和 HFP 控制, 来应对不同类型屏幕的需求。

2.4.2.3 MIPI-DSI

DSI 作为串行高速总线, 主要是针对高分辨率和高集成度的屏幕使用场景, 例如穿戴式设备。LCD 控制器也加入了对于 DSI 接口的支持, 高速模式下, 最高可以支持 2 条双向数据线, 每条数据线最高传输速率达到 480Mbps。低速模式下, LCD 控制器也可以支持 1 条双向数据线。这样的配置可以满足绝大部分可穿戴设备的需求。

2.4.2.4 JDI 反射屏

为了适应可穿戴产品的低功耗需求, JDI 研发超低功耗的反射屏。该屏幕利用太阳光线呈现图像, 相较传统 LCD 屏幕耗电可以降低 95% 以上, 配备在可穿戴产品上可以实现超长续航。LCD 控制器内也加入了 JDI 反射屏接口支持, 包括串行接口和并行接口。两种接口最高可以支持到 64 色显示, 支持局部刷新和整屏刷新, 从而进一步降低屏幕刷新功耗, 满足超长续航的需求。

2.5 eZip™ 无损压缩解码器

eZip™ 解码器是基于自有算法的实时无损解压缩模块, 压缩率与 Zip 格式相当。它可以用于将通用数据解码后保存, 以此加快数据的实时加载能力。如果数据是从芯片外部传输, 压缩后的传输有助于缩短传输时间, 减少传输功耗。

此外, eZip™ 还支持专有格式的图片压缩, 压缩率与 PNG 格式相当, 并支持独立 DMA 操作或与 ePicasso™ 联动读取。当独立操作时, eZip™ 可通过 DMA 机制, 可以灵活地将存储在 Flash 或 RAM 的压缩图片解压缩并搬运至目标缓存中。在联动模式下, ePicasso™ 通过 eZip™ 模块, 实时从存储中读取图片并实时解压缩, 然后按照一般的图形流程进行所需要的 2.5D 计算, 从而省去了暂存解压缩图片的缓存。

通过以上机制, eZip™ 可以有效地降低图像素材对存储容量的需求, 在有限的存储中最大化素材的丰富度, 减小对片外存储的带宽要求, 从而提高大大系统的整体运行效率。

eZip™ 模块是将 eZip™ 压缩图片进行解码输出的模块。该模块通过 AHB 总线读入压缩数据, 解码后的图像数据可配置通过 AHB 总线输出或直接送给 epic 模块进行后续处理。

该模块具有以下特点:

- 通过 AHB 总线输入\输出的数据地址可配
- 输出图片数据可直接送给 epic 模块

- 可输出一个指定区域的图片数据
- 支持解码参数 cache 功能, cache 命中的情况下可缩短解码时间

2.6 神经网络加速器

2.6.1 神经网络矩阵卷积加速器 (NNACC)

矩阵卷积加速器旨在满足机器学习计算中对底层矩阵算力的需求, 可以广泛适用于各种神经网络框架。加速器访存接口丰富, 提供灵活的数据地址配置。支持最大 255×255 的输入矩阵和最大 128 的输入输出通道数。支持 8bit 整数型运算, 可以满足大部分边缘端 AI 计算要求, 比如语音指令识别、心率、计步、心电图等传感器的计算等场景。

2.6.2 神经网络协处理器 (NN Co-Processor)

神经网络协处理器, 通过协处理器接口挂在 hpcpu/lpcpu 上。软件通过专门的协处理器指令调用该处理器。协处理器特性为:

- 数据总线位宽为 64Bit
- 支持 8Bit 位宽的 MAC 运算
- 支持单指令 4 次独立 MAC 运算

2.7 数字信号处理加速器

2.7.1 FFT 加速器

FFT 运算对算力要求很高, 使用 FFT 加速器可以有效减轻 CPU 负载, 提升系统性能。AUXSYS 和 LPSYS 中各集成有一个 FFT 加速器, 可以满足各种场景下 FFT 算力要求。

FFT 加速器主要特性如下:

- 支持最大 4096 点最小 16 点 FFT (AUXSYS FFT)
- 支持最大 1024 点最小 16 点 FFT (LPSYS FFT)
- 支持 24 点、16 点、8 点定点有符号数输入输出, 输入输出位宽独立配置。
- 支持实数 FFT 运算
- 支持 IFFT

2.7.2 Cordic 协处理器

Cordic 协处理器用于计算三角函数和双曲函数及其推演出的一些算术运算。在 hpsys、auxsys、lpsys 中各集成了一个 Cordic 协处理器。Cordic 协处理器特性如下:

- 支持 ARM coprocessor 协处理器指令
- 支持 ARM Custom Datapath Extention 指令 (只有 hpsys)
- 支持三角函数类运算: cos、sin、ang、mod、atan、rot
- 支持双曲函数类运算 cosh、sinh、atanh、angh、modh、mul、div、ln、exp、sqrt
- 支持 32 位定点输入输出

3 外设

3.1 双模蓝牙 5.3

3.1.1 射频和基带

射频和基带包括发射机和接收机。发射机将基带信号调制到 2.4G 频段上的信号发射出去, 接收机将 2.4G 频段空中信号接收解调到基带信号。主要特性为:

- 支持蓝牙 5.3 协议: 1M PHY (1Mbps), 2M PHY (2Mbps), BR PHY (1Mbps), EDR2 PHY (2Mbps), EDR3 PHY (3Mbps)
- 集成 AGC
- 支持 RSSI
- 接收机支持自动频偏纠正
- 可调发射功率, BLE/BR PHY 最大发射功率 19dBm, EDR2/EDR3 最大发射功率 13dBm
- 集成 Balun 和天线匹配网络, 无需片外匹配

3.1.2 BT MAC

BT MAC 是完全支持蓝牙协议 v5.3 并向下兼容协议 v4.2、v4.1、4.0 的双模基带控制器, 主要是负责包的编解码以及事件的调度。

主要的功能如下:

- 低功耗蓝牙模式:
 1. 支持所有速率 (1M/2M/Long Range);
 2. 支持所有的包格式 (广播包/拓展广播包/数据包等);
 3. 支持数据的加解密;
 4. 支持数据流的处理 (冗余校验、白化);
 5. 支持两种跳频模式;
- 经典蓝牙模式:
 1. 支持 ACL、CSB、SCO 以及 eSCO 的所有包类型;
 2. 支持数据加解密 (E0 加密以及 AES-CCM 加密);
 3. 支持数据流的处理 (HEC、CRC、Whitening、FEC2/3、FEC1/3);
 4. 支持音频数据的编解码处理 (CVSD 以及 a/ μ -Law);
 5. 支持自适应跳频;
- 以及:
 - 支持 AMBA AHB 总线的访问;
 - 支持 WLAN/MWS 的共存机制。

3.2 模拟外设

3.2.1 12 比特模/数转换器

GPADC 包含一个 SARADC，基本功能是将外接输入电压转换为数字信号。GPADC 主要特性为：

- 12-bit 分辨率
- 最大采样率 4MS/s
- 单端输入电压范围：0 ~ 3.3V
- 差分输入电压范围：-2.1V ~ +2.1V
- 支持 8 路单端模拟输入或 4 对差分模拟输入
- 支持单次测量模式和循环测量模式
- 每次测量可以划分为 8 个时隙，各时隙可以单独配置模拟输入通道
- 支持软件 (写寄存器) 和硬件 (如计时器) 触发方式
- 支持 DMA 通道
- 采样频率可配

表 3-1: 12-bit GPADC 电气特性

	Min.	Typ.	Max.	Unit	Comments
Resolution		12		bit	
T _{sample} (Differential)	125n		2/3	s	fs=1/(T _{sample} +T _{conversion})
T _{sample} (Single-Ended)	166.66n		2/3	s	
T _{conversion}	125n		10.67u	s	
Sample rate (fs)			4	Msp/s	
ENOB (Differential)		10.6		bit	V _{in} =-1dBFS, no averaging
ENOB (Single-Ended)		10		bit	V _{in} =-3dBFS, no averaging
SNDR (Differential)		65.6		dB	V _{in} =-1dBFS, no averaging
SNDR (Single-Ended)		61.96		dB	V _{in} =-3dBFS, no averaging
Current Consumption		466		uA	fs=4Msp/s
		130		uA	fs=500ksps
		90		uA	fs=100ksps

GPADC 外部源端电路电阻 R_{AIN} 与采样时间的关系表如下：

Resolution (bit)	Number of T _{CLK} Cycle @24MHz	T _{sample} (ns)	Maximum source resistance R _{AIN} (kOhm)
12	4	166	1
	15	625	5
	30	1250	10
	150	6250	50
	300	12500	100
	1500	62500	500
	15000	625000	5000

3.2.2 16 比特模/数转换器

SDADC 主要实现对信号的测量, 支持连续采样以及单次采样。参考电压为 0~2V, 增益 0.25 到 4 倍可配, 单端可以实现的测量范围为 $0V \sim (0.65 \times \text{参考电压}/\text{增益})$, 差分可以实现的测量范围为 $-(0.65 \times \text{参考电压}/\text{增益}) \sim (0.65 \times \text{参考电压}/\text{增益})$, 但测量范围都不能超过 0~AVDD, 最小的测量误差为 $\pm 60\mu V$, 单次可以实现 4kHz 的采样率, 连续采样可以实现 8kHz 的采样率。SDADC 主要特性为:

- 支持 16bit 的数据精度
- 最多支持 2 个差分或 5 个单端的频道采样
- 支持软件可配置的多个频道多次采样

3.2.3 温度传感器

温度传感器将温度转换为随温度变化的电压, 然后通过 ADC 将该电压转换为数字。系统通过软件调用温度传感器。主要特性为:

- 温度传感器分辨率为 0.2°C
- 支持温度范围为 -40°C 到 125°C
- 温度传感器精度 -3°C 到 3°C
- 支持轮询或中断方式读数

3.2.4 电压比较器

LPCOMP (Low-Power Comparator) 包含两路独立的电压比较器, 可将外部输入的模拟信号电压与参考电压值进行比较, 产生比较结果。两路比较器可以分别测量不同信号, 也可以测量同一个信号并产生组合输出。参考电压值可以从外部输入, 也可以由芯片内部产生。比较器结果可以通过 IO 输出或通过寄存器读取, 也可以产生中断 /PTC 事件触发或唤醒信号。

LPCOMP 在系统进入某些低功耗模式时也能够进行实时监控, 当检测到特定比较结果时将系统唤醒。

LPCOMP 主要特性:

- 两路比较器, 可独立使用或组合使用进行窗口比较
- 参考电压选择
 - 内部产生 4 档参考电压
 - 外部输入
- 可配置的迟滞比较
- 可配置的功耗/速度挡位
- 比较结果极性翻转
- 比较结果后处理
 - 高/低电平
 - 上升沿/下降沿/任意沿
- 多种输出
 - IO
 - 寄存器
 - 中断

- PTC 触发
- LPTIM 时钟
- 低功耗睡眠唤醒
- 系统处于低功耗模式 (light sleep/deep sleep) 下也可以工作, 并能够唤醒系统

3.2.5 音频 DAC

音频 DAC 是将数字音频信号转化为模拟电压输出的模块, 本芯片共集成了两路 24-bit DAC, 支持音频采样率从 8KHz 到 48KHz, 输出方式支持差分输出。

3.2.6 音频 PLL

音频 PLL 主要功能为音频系统提供高精度的时钟, 其支持小数分频功能, 调节精度为 $48\text{MHz}/2^{18}$, 能够满足 48KHz、32KHz 和 44.1KHz 等不同采样率的需求。

3.2.7 音频 ADC

音频 ADC 是将外部模拟信号转化为内部的数字音频信号, 本芯片共集成了两路 24-bit ADC, 支持的音频采样率从 8KHz 到 48KHz, 每一路 ADC 有单独的增益调节。

3.3 DMA

3.3.1 ExtDMA

ExtDMA (Extended Direct Memory Access) 能够对总线上两个不同地址区间的数据进行高效率搬运工作, 并集成 TurboPixel™ 图像帧压缩模块, 可在搬运的同时完成图像压缩。不开启压缩时, ExtDMA 也可作为通用 DMA 使用。与 DMAC 相比, ExtDMA 在访问外部存储器 (如 FLASH、PSRAM) 时效率更高, 但仅有一个通道, 仅支持 4 字节对齐搬运, 且不响应外设请求。

ExtDMA 主要特性:

- 单 AHB 主控, 可访问 SRAM, PSRAM, FLASH 等, 支持 BURST 传输
- 单个传输通道, 内置深度为 16, 位宽 32 比特的 FIFO
- 源地址和目标地址均为 4 字节访问, 并支持地址自动递增
- 单次配置最大传输单元数为 $2^{20}-1$, 每单元固定 4 字节传输, 即单次最大传输 4M 字节
- 每个通道支持传输完成、过半传输、传输出错事件标志, 并能各自独立产生中断请求
- 集成 TurboPixel™ 图像帧压缩功能, 支持 RGB565/RGB888/ARGB8888 格式输入, 单行最大支持 1024 像素

3.3.2 DMAC

DMAC (Direct Memory Access Controller) 用于实现总线上两个不同地址区间内数据的搬运工作。DMAC 共有 8 个独立通道, 每个通道可配置源地址区间与目标地址区间, 分别映射到各内存或外设的地址范围内, 从而实现内存-内存、内存-外设、外设-内存、外设-外设之间的高效率传输, 有效缓解 CPU 的工作量。

DMAC 支持外设响应模式和内存搬运模式: 在外设响应模式下, DMAC 基于外设的 DMA 请求进行搬运, 从而适配外设的带宽; 在存储器搬运模式下, DMAC 不等待外设的 DMA 请求, 尽快完成数据搬运。当多个通道同时

使能时, DMAC 依照优先级由高至低的次序依次搬运; 并且在较低优先级的通道搬运过程中, 较高优先级的通道能够进行抢占搬运。每个通道传输过半或完成时, 能够产生中断或 PTC 触发。

DMAC1 与 DMAC2 位于 HPSYS, 能够响应 HPSYS 外设的 DMA 请求。DMAC3 位于 LPSYS, 能够响应 LPSYS 外设的 DMA 请求。

DMAC 主要特性:

- 单 AHB 主控, 可访问 SRAM, PSRAM, FLASH, AHB 和 APB 外设等
- 8 个独立的可配置通道
- 每个通道的 DMA 请求可在至多 64 个外设 DMA 请求中选择 1 个, 或由软件请求
- 每个通道支持 4 档优先级配置, 优先级相同时依照通道编号大小判决
- 支持外设到存储器、存储器到外设、存储器到存储器以及外设到外设的数据传输
- 源地址和目标地址均独立支持单字节、双字节、四字节访问, 源和目标的地址必须根据传输数据单元的大小进行对齐, 并支持地址自动递增。传输过程中地址不支持跨过 1MB 边界。
- 单次传输单元数可配置为 0 到 65535
- 支持循环缓冲模式, 单次传输完成后自动重新启动
- 每个通道支持 3 种事件标志: 传输完成、过半传输、传输出错, 并能各自独立产生中断或 PTC 触发
- 每个通道支持可配置块尺寸的块传输模式

3.4 音频处理模块 AUDPRC

音频处理模块针对不同来源的音频数据进行采样率转换、混音以及均衡, 将处理后的音频数据送到对应的播放或者存储设备。其主要包含两条主要的数据通路, 处理播放数据的 DAC 通路和处理音频采集数据的 ADC 通路。

3.4.1 DAC 通路

DAC 通路音频数据来源于内存, AUDPRC 最多支持四路 24bit 音频数据。AUDPRC 内 DAC 通路支持对两路数据进行采样率转换, 采样率转换范围为 1/8~8 倍, 信噪比不低于 96dB。经过采样率转换模块的数据再与另外两路数据进行混音处理后, 进入 10 级的音频均衡器。每一级均衡器参数均可配, 用户可以根据需求进行配置。最后经过均衡器的两路音频数据可以送至模拟 DAC 模块或者 I2S 接口作为输出。

3.4.2 ADC 通路

ADC 通路音频数据来源于模拟 ADC 或者 I2S 接口, 最多支持两路 24bit 音频数据。经过采样率转换模块的数据可以被 DMA 保存到内存中。

3.5 连接外设

3.5.1 通用输入/输出接口 (GPIO)

系统共有 154 个 GPIO 管脚, 其中 HPSYS 94 个, LPSYS 60 个。通过配置对应的寄存器, 可以为这些管脚分配不同的功能。

当配置为输出功能时, 可以通过寄存器配置输出值。

当配置为输入功能时，输入值可以通过相应寄存器查询，同时支持输入信号中断触发，中断触发模式可设置为电平触发和沿触发，沿触发支持上下双沿触发。

3.5.2 通用异步收发器 (UART)

通用异步收发器支持全双工模式，提供高达 6Mbps 的波特率和多种可配置的数据格式，为与外部标准化设备通信提供了灵活而有效的数据交互手段。同时它还支持 DMA，实现多包收发。

UART1、UART2 和 UART3 位于 HPSYS。UART4、UART5 和 UART6 位于 LPSYS。

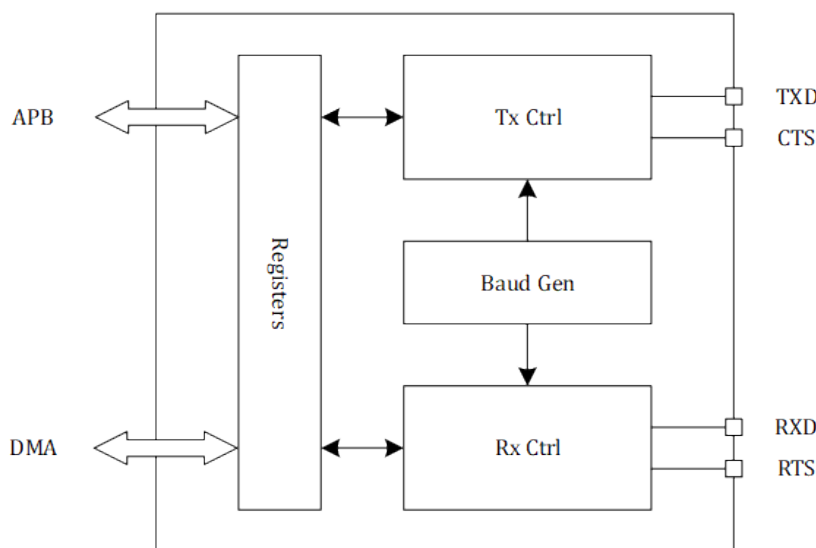


图 3-1: 通用异步收发器

通用异步收发器主要特性：

- 全双工异步通信
- 可配置 16 倍过采样或 8 倍过采样，选择频率优先或者时钟容忍度优先
- 灵活波特率配置，当输入时钟为 48MHz 且过采样率为 16 时，波特率为 3Mbps
- 可配置包长度（7/8/9 bits）
- 可配置停止位（1/2 bits）
- 硬件流控（CTS/RTS）
- DMA 多包发送和接收
- 接收奇偶校验和发送奇偶生成
- 接收和发送中断，以及其他错误中断

波特率计算说明

假设输入时钟固定为 48MHz，波特率计算公式如下：

$$\text{Baud Rate} = \frac{48\text{MHz}}{(BRR_{INT} + \frac{BRR_{FRAC}}{16})(16 \text{ or } 8)} \quad (3.1)$$

3.5.3 I2C

I2C(Inter-Integrated Circuit) 接口同时支持主设备与从设备角色, 可作为主设备与 I2C 外设通信, 也可作为从设备响应外部的 I2C 主设备。I2C 内置 8 字节 FIFO, 可以进行单笔读写, 也可通过 DMA 进行批量数据读写。I2C 支持标准模式 (standard-mode)、快速模式 (fast-mode)、增强快速模式 (fast-mode plus) 以及高速模式 (high-speed-mode), 最高速率可达到 3.4Mbps。

I2C 主要特性:

- 可同时作为 master 与 slave
- 支持总线多 master
- 支持标准模式 (最高 100kbps)
- 支持快速模式 (最高 400kbps)
- 支持快速模式 + (最高 1Mbps)
- 支持高速模式 (最高 3.4Mbps)
- 作为 master 支持访问 7 比特或 10 比特寻址
- 作为 slave 支持 7 比特寻址
- 可配置的总线时序
- 支持时钟延展 (clock stretching)
- 8 字节 FIFO, 支持 DMA
- 可配置的数字防抖动电路
- 独立的功能时钟, 支持系统时钟动态调节

3.5.4 PDM

PDM (Pulse Density Modulation) 脉冲密度调制接口主要是用于将 PDM 麦克风采集到的 PDM 音频信号转化为 PCM (Pulse Code Modulation) 脉冲编码调制信号以供后续的音频处理。

PDM 主要特性:

- 同时支持左右两路立体声信号, 也可以单独采集单声道信号
- 可提供的 PDM 麦克风时钟速率: 3.072MHz、1.536MHz、0.768MHz、1.024MHz、2.4MHz、1.6MHz、0.8MHz
- 支持 PCM 数据的速率: 48kHz、32kHz、24kHz、16kHz、12kHz、8kHz
- 支持 32bit、24bit、16bit、8bit 的 PCM 信号
- 支持分辨率为 0.5dB 并且从 -15dB 到 45dB 增益可调

3.5.5 I2S

I2S 接口是应用于音频的输入输出, 可以用来连接外部音频芯片、数字麦克风等设备。相较模拟音频接口, I2S 数字音频接口有更好的抗干扰能力以及更精简的接口协议。

I2S 主要特性:

- 只支持 master 模式
- 支持全双工模式
- 可配置的 I2S 数据格式, 包括左对齐、右对齐和标准格式
- 支持多种音频数据格式, 包括 8-bit 和 16-bit 的单声道和立体声格式

- 可配置的 I2S PCM 信号位宽, 最高到 24-bit

3.5.6 串行外设接口 (SPI)

SPI 支持 3 种通信格式: SSP/SPI/Microwire。SSP/SPI 为全双工通信协议, 控制器可以配置为 Master 或 Slave 模式。Microwire 为半双工通信协议, 控制器仅可配置为 Master 模式。SPI 控制器内置发送/接收 FIFO。发送 FIFO 和接收 FIFO 共享同一个地址, 读该地址时访问接收 FIFO, 写该地址时访问发送 FIFO。SPI1/SPI2 位于 HPSYS, SPI3/SPI4 位于 LPSYS。

SPI 特性如下:

- 支持 8 到 32Bit 的数据宽度
- SPI 格式下时钟极性和相位可通过寄存器 SPO 和 SPH 设置
- 片选信号极性可配
- FIFO 深度为 32Bits×16Entry
- 接收发送都支持 DMA 模式
- HPSYS 中的 SPI 最大时钟频率为 48MHz, LPSYS 中的 SPI 最大时钟频率为 24MHz

各种通信格式工作时序如下:

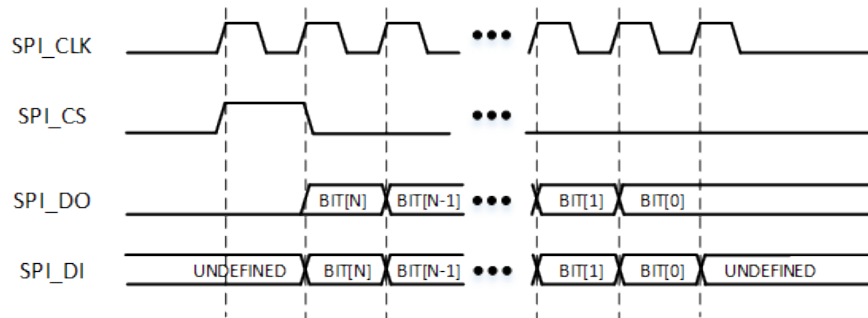


图 3-2: SSP 格式单次收发时序

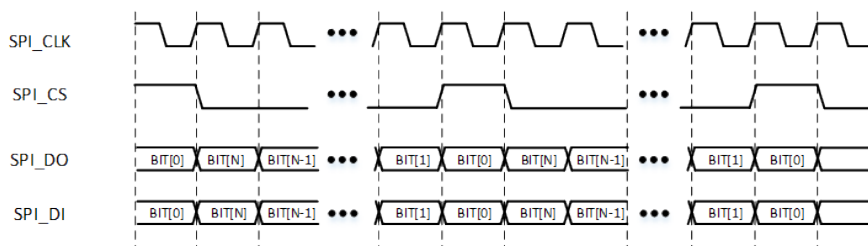


图 3-3: SSP 格式连续收发时序

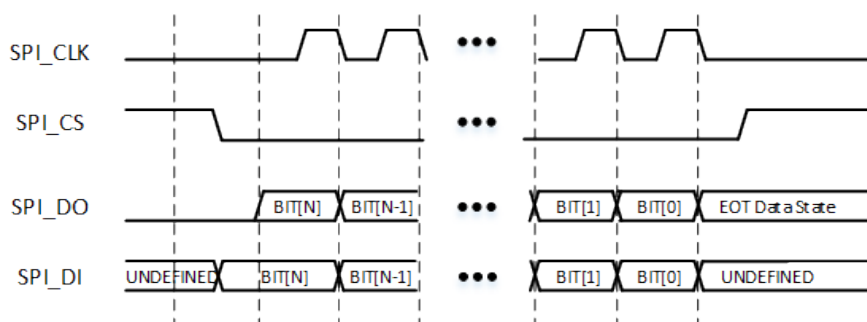


图 3-4: SPI 格式单次收发时序

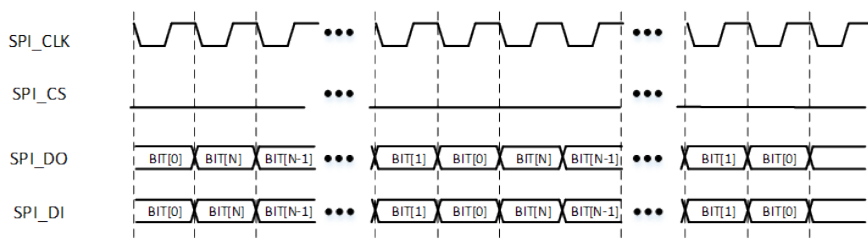


图 3-5: SPI 格式连续收发时序

下面图例用于说明 SPI 格式下 SPH/SPO 设置的效果:

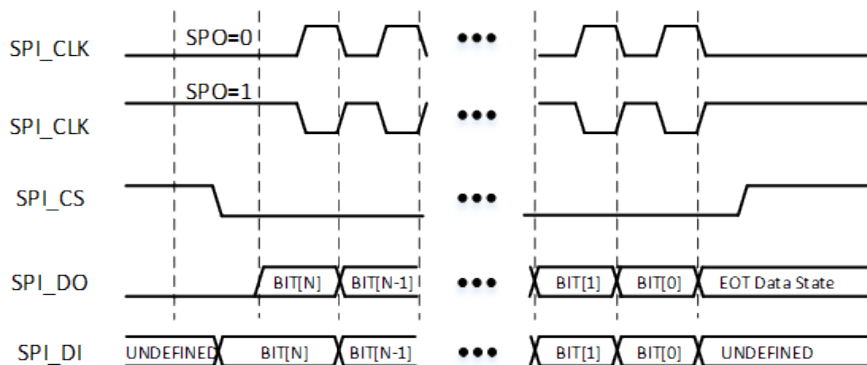


图 3-6: SPO=0 时的 SPI 时序

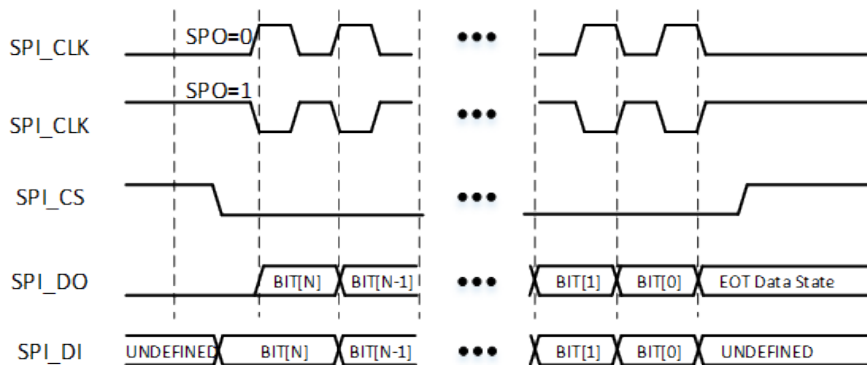


图 3-7: SPO=1 时的 SPI 时序

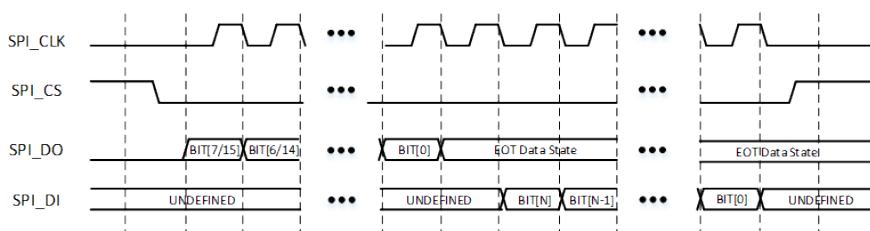


图 3-8: Microwire 格式的单次收发时序

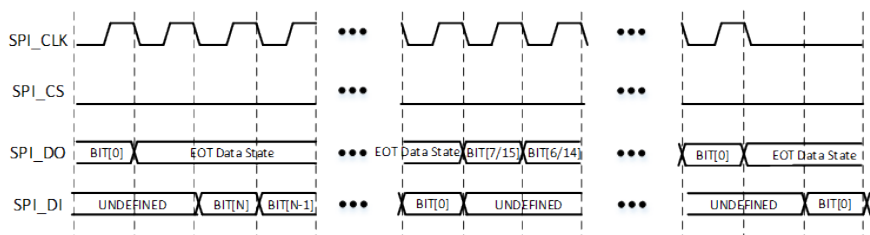


图 3-9: Microwire 格式的多次收发时序

3.5.7 外设任务控制器 (PTC)

PTC (Peripheral Task Controller) 是一个独立的外设控制器，可以不需要唤醒 CPU，自动完成各个外设的相互调度和控制任务。基于选定外设的事件触发，PTC 能够自动改写各外设的工作模式或工作状态，并且能够将这些任务串联构成自动触发的任务序列，从而完成复杂且快速响应的任务链。在任务链的进行过程中，CPU 可以一直保持睡眠，进而有效节省功耗。

PTC 共有 8 个通道，每个通道可以选择独立的触发源，并可配置独立的任务。可执行的任务包括两类：将指定数据直接写入指定地址；将指定地址的内容读出，与指定数据进行异或 / 与 / 或 / 加法操作后再写回。每个通道任务完成时，可产生触发信号从而触发其它通道的任务。每个通道可配置触发次数。部分通道支持触发后经过可配置的延时再执行任务。

PTC1 位于 HPSYS 中，PTC2 位于 LPSYS 中，均可以控制 HPSYS 与 LPSYS 总线上的外设。

PTC 主要特性：

- 8 个独立配置的通道可同时工作
- 每个通道触发可在 128 个触发源中选择，包括 PTC 自身的触发源
- 可访问 AHB 和 APB 外设地址空间，只支持 word 对齐访问
- 支持直接写数据，或读后改写
- 支持 32 位异或/与/或/加法运算
- 可配置触发次数 1 ~ 1023，或无限次触发
- 可配置触发延迟 0 ~ 65535 个 HCLK 周期
- 固定优先级仲裁，通道编号越小优先级越高
- 4 个 word 的寄存器空间用于数据缓存

3.5.8 USB2.0 HS

本芯片集成了一路高速 (HS) USB2.0 Host/Device 接口，符合 USB 2.0 的协议规范，具有如下功能：

- 软件可配置的端点设置, 支持挂起/恢复
- 支持会话请求协议和主机协商协议
- 支持高速、全速模式
- 拥有 ep0,ep1~7 8 个通道

3.5.9 SIM 卡控制器

SIM 卡接口是半双工的串行接口, 本芯片中的 SIM 卡控制器, 支持 SIM 卡的数据包收发。控制器可以支持轮询模式和 DMA 模式, 结合上层软件可以实现 SIM 卡的协议层通信功能。

3.6 定时器

3.6.1 通用定时器

GPTIM (General-Purpose Timer) 基于一个 16 比特计数器, 可实现计时、测量输入信号的脉冲长度 (输入捕获) 或者产生输出波形 (输出比较和 PWM) 等功能。计数器本身可以进行递增、递减或者递增/递减计数, 计数时钟可选系统 PCLK、IO 输入信号或级联输入信号, 并可进行 1~65536 倍的预分频。GPTIM 共有 4 个通道, 可以分别独立配置为输入捕获或输出模式。计数、输入捕获和输出比较的结果可以产生中断、DMA 请求或 PTC 事件。GPTIM 包含主从模式接口, 可以进行多级级联, 实现多级计数或同步触发等功能。

GPTIM 主要特性:

- 16 位递增、递减、递增/递减自动重载计数器, 最大计数 65535
- 16 位可编程 (可以实时修改) 预分频器, 计数器时钟频率的分频系数为 1~65536 之间的任意数值
- 8 位可配置重复计数
- 支持单笔计数模式 (OPM), 当重复计数完成后自动停止计数器
- 4 个独立通道, 可分别配置为输入或输出模式
- 输入模式
 - 上升沿/下降沿捕获
 - PWM 脉宽和周期捕获 (需占用两个通道)
 - 可选 4 个输入端口之一或 1 个外部触发端口, 支持防抖动滤波和预降频
- 输出模式
 - 强制输出高/低电平
 - 计数到比较值时输出高/低/翻转电平
 - PWM 输出, 可配脉宽和周期
 - 多通道 PWM 组合输出, 可产生有相互关系的多路 PWM
 - 单脉冲/重触发单脉冲模式输出
- 主从模式
 - 支持多计数器互连, 可在作为主设备产生控制信号的同时, 作为从设备被外部输入或其它主设备控制
 - 控制模式包括复位、触发、门控等
 - 支持多计数器同步启动、复位等
- 编码模式输入, 控制计数器递增/递减计数
- 如下事件发生时产生中断/DMA 请求/PTC 触发:
 - 更新: 计数器递增溢出/递减溢出, 计数器初始化 (通过软件或者内部/外部触发)

- 触发事件 (计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
- 输入捕获
- 输出比较

3.6.2 高级定时器

ATIM (Advanced Timer) 基于一个 32 比特计数器, 可实现计时、测量输入信号的脉冲长度 (输入捕获) 或者产生输出波形 (输出比较和 PWM) 等功能。ATIM 支持 6 路带死区保护的 PWM 互补输出, 支持多路 PWM 同时换相, 并有 2 路刹车输入可快速将输出切换至安全状态。计数器本身可以进行递增、递减或者递增/递减计数, 计数时钟可选系统 PCLK、IO 输入信号或级联输入信号, 并可进行 1~65536 倍的预分频。ATIM 共有 6 个通道, 可以分别独立配置为输入捕获或输出模式。计数、输入捕获和输出比较的结果可以产生中断、DMA 请求或 PTC 事件。ATIM 包含主从模式接口, 可以进行多级级联, 实现多级计数或同步触发等功能。

ATIM 主要特性:

- 32 位递增、递减、递增/递减自动重装载计数器
- 16 位可编程 (可以实时修改) 预分频器, 计数器时钟频率的分频系数为 1~65536 之间的任意数值
- 16 位可配置重复计数
- 支持单笔计数模式 (OPM), 当重复计数完成后自动停止计数器
- 6 个独立通道
 - 通道 1~3 可分别配置为输入或输出模式, 其中每个通道可输出两路带死区保护的互补 PWM
 - 通道 4 可配置为输入或输出模式, 可输出单路 PWM
 - 通道 5~6 可配置为输出比较模式
- 输入模式
 - 上升沿/下降沿捕获
 - PWM 脉宽和周期捕获 (需占用两个通道)
 - 可选 4 个输入端口之一或 1 个外部触发端口, 支持防抖动滤波和预降频
- 输出模式
 - 强制输出高/低电平
 - 计数到比较值时输出高/低/翻转电平
 - PWM 输出, 可配脉宽和周期
 - 多通道 PWM 组合输出, 可产生有相互关系的多路 PWM
 - 单脉冲/重触发单脉冲模式输出
- 主从模式
 - 支持多计数器互连, 可在作为主设备产生控制信号的同时, 作为从设备被外部输入或其它主设备控制
 - 控制模式包括复位、触发、门控等
 - 支持多计数器同步启动、复位等
- 编码模式输入, 控制计数器递增/递减计数
- 支持用于定位的霍尔传感器电路
- 2 路刹车输入, 支持防抖动滤波, 可将输出快速置于安全状态。刹车信号源包括:
 - CPU lockup
 - 外部输入
 - 软件触发

- 如下事件发生时产生中断/DMA 请求/PTC 触发：
 - 更新：计数器递增溢出/递减溢出，计数器初始化 (通过软件或者内部/外部触发)
 - 触发事件 (计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
 - 输入捕获
 - 输出比较
 - 刹车
 - 换相

3.6.3 基本定时器

BTIM (Basic Timer) 基于一个 32 比特递增计数器，可实现计时功能。计数时钟为系统 PCLK 或级联输入信号，并可进行 1~65536 倍的预分频。计时结果可以产生中断、DMA 请求或 PTC 事件。BTIM 包含主从模式接口，可以进行多级级联，实现多级计数或同步触发等功能。

BTIM 主要特性：

- 32 位递增自动重装载计数器
- 16 位可编程预分频器，计数器时钟频率的分频系数为 1~65536 之间的任意数值
- 支持单笔计数模式 (OPM)，计数完成后自动停止计数器
- 主从模式
 - 支持与 BTIM 及 GPTIM 互连，可在作为主设备产生控制信号的同时，作为从设备被外部输入或其它主设备控制
 - 控制模式包括复位、触发、门控等
 - 支持多定时器同步启动、复位等
- 计数器溢出或初始化时产生中断，DMA 请求及 PTC 触发

3.6.4 低功耗定时器

LPTIM (Low-Power Timer) 基于一个 24 比特递增计数器，可实现计时、产生输出波形 (输出比较和 PWM) 和唤醒系统等功能。计数时钟可以为系统时钟、低功耗时钟、IO 输入信号或比较器输出，并可进行最多 128 倍的预分频以及最多 256 次的循环计数。根据计数结果可以产生 PWM 输出，并可产生中断，或产生唤醒信号将系统从低功耗模式唤醒。当用 IO 输入信号作为计数时钟时，支持不依赖于内部时钟进行计数并产生唤醒信号，从而允许系统关闭内部时钟。

LPTIM 主要特性：

- 24 位向上自动重装载计数器，最大计数 $16777215(2^{24}-1)$
- 计数时钟选择
 - 内部时钟，PCLK2 或低功耗时钟
 - 可选边沿的 IO 输入信号或比较器输出，可利用内部时钟进行防抖动，也可不依赖内部时钟独立计数
- 8 档预分频，计数时钟分频系数为 2 的 0~7 次方
- 1~256 循环次数
- 计数模式
 - 连续计数模式
 - 单笔计数模式，循环次数完成后计数结束

- 可配极性的输出模式
 - PWM 输出, 可配脉宽、周期
 - 单次翻转输出
 - 单脉冲或指定个数脉冲输出
- 触发模式
 - 软件触发
 - IO 输入信号边沿触发, 支持防抖动滤波
- 超时检测, 每次外部触发时计数器复位
- 如下事件发生时产生中断或唤醒信号:
 - 更新
 - 计数器溢出
 - 输出比较
 - 外部触发

3.6.5 看门狗

看门狗计时器作为一种计数器主要是用于在到达设定好的时间之后重置系统, 以防止软件挂死。

看门狗计时器基本功能:

- 支持两种工作模式:
 - Mode0
 - * wdt 不会产生中断, 在到达设定的时间之后会直接重置系统
 - * 最高支持 24bit 的计数器
 - Mode1
 - * 分为两段计数, 在到达第一段设定的时间之后, 会产生中断, 在到达第二段设定的时间之后, 再重置系统
 - * 每个时间段最高支持 24bit 的计数器
- 支持写保护, 以防止软件对 wdt 进行误操作

3.7 加密校验

3.7.1 AES 引擎

AES 引擎是一个针对对称加密算法的运算加速器, 用户可以自行配置加解密算法的密钥以及初始向量对内存中的数据进行加解密运算操作, 同时将结果存储到指定的内存区域。

相较软件的加解密运算, AES 引擎有更高的运算速度, 更灵活的配置, 更好的外设存储设备访问效率。除此以外, 在 bypass 模式下, AES 引擎也可以作为数据传输的 DMA 来使用。

AES 主要特性:

- 支持 AES-128、AES-192、AES-256 以及国密 SM4 算法标准
- 支持 ECB、CTR 以及 CBC 模式
- 可以调用 RootKey 进行加解密的运算, 同时保证 RootKey 不被外部程序读取

3.7.2 HASH 引擎

HASH 引擎是一个针对散列数列算法的运算加速器, 用户可以选择不同的散列算法计算内存中特定数据的散列值。HASH 引擎相比软件算法速度更快, 配置也灵活, 用户也可以通过自定义初始向量, 实现多线程 HASH 运算。HASH 引擎支持算法包括 SHA1、SHA224、SHA256 和 SM3。

3.7.3 CRC

CRC (Cyclic Redundancy Check) 可进行特定位宽、任意生成多项式、任意初始值的 CRC 计算。数据可以通过 CPU 或 DMA 输入, 最小输入单元为单字节, 没有最长字节数限制。单 HCLK 周期即能够完成单字节输入的计算。数据输入全部完成后即时得到校验结果。支持输入数据高低位倒转和输出数据高低位倒转。支持不同有效位宽的输入数据。

CRC 主要特性:

- 7/8/16/32 比特 CRC 计算
- 任意自定义多项式
- 任意初始值
- 输入数据支持单字节/双字节/三字节/四字节有效位宽
- 输入数据支持字节/双字节/四字节高低位比特倒转
- 输出数据支持高低位比特倒转
- 计算速度为每 HCLK 周期 1 字节

3.7.4 真随机数发生器 (TRNG)

TRNG (True Random Number Generator) 是一个借助振荡电路的不稳定性来产生随机数的模块。该模块无需外部的随机熵源, 可以通过激活内部多个振荡电路, 通过一定的熵源处理逻辑, 生成随机数。

TRNG 主要特性:

- 独立的内部熵源
- 单次产生 256-bit 的种子和 256-bit 随机数
- 针对熵源的死锁校验

3.8 存储接口

3.8.1 MPI 接口

MPI (Memory Peripheral Interface) 控制器是一个专用的 memory 通信接口, 支持多种片外存储颗粒, 包括:

- SPI NOR Flash, 支持 1 线/2 线/4 线, 支持 DTR 模式
- SPI NAND Flash, 支持 1 线/2 线/4 线
- pSRAM, 支持 x8 和 x16 数据位宽, 支持 Xccela 标准接口, 兼容 Legacy 接口
- HyperRAM, 支持 x8 和 x16 数据位宽, 支持 HyperBus 标准接口

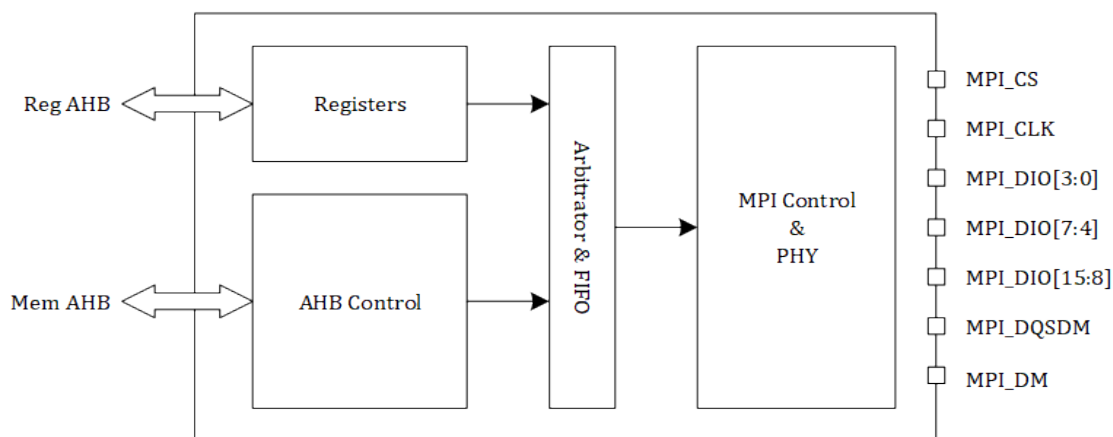


图 3-10: MPI 控制器框图

MPI 控制器支持两种操作模式：（1）寄存器模式和（2）地址映射模式。两种模式的切换由硬件自动完成，可动态穿插执行。且无论哪种模式，都支持高度可定制的接口时序，以兼容各种存储颗粒。

寄存器模式

- 通过寄存器操作，发送一个命令时序。也可以将该命令设置为状态查询命令反复发送，直到读回的数据满足某个预设状态
- 支持发送包含两个命令时序的序列，其中第二个命令可设置为状态查询命令反复发送，直到读回的数据满足某个预设状态
- 支持 DMA 通道，通过寄存器 FIFO 接口完成数据搬运

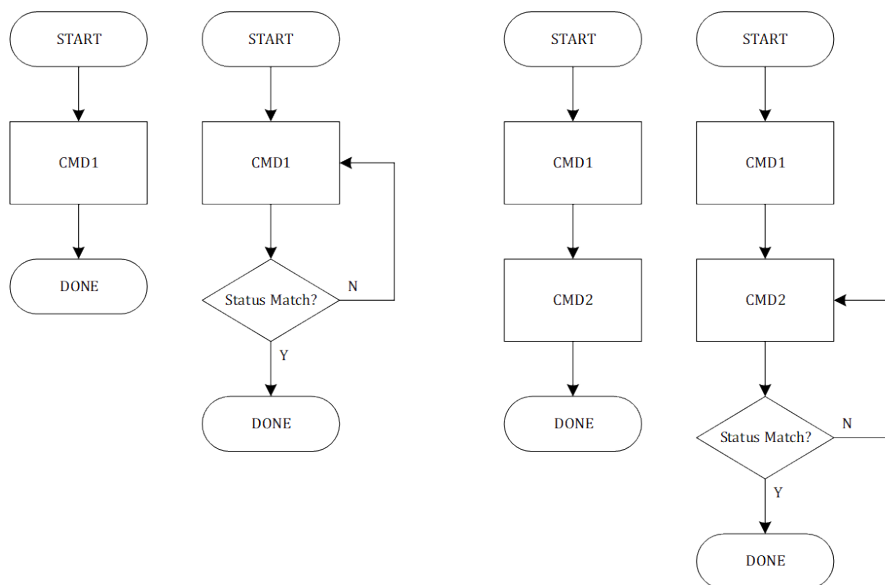


图 3-11: 寄存器模式单个和多个命令时序的序列

地址映射模式

- 外部 memory 映射为 AHB 地址空间，自动将 AHB 总线读写转换为预设的 Memory 接口时序，实现 XIP 功能

- 支持 Byte (8-bit)、Half-word (16-bit) 和 Word (32-bit) AHB 访问
- 高效转换 AHB Wrap 操作, 不依赖于颗粒是否支持 Wrap
- 支持 XIP 实时 (On-The-Fly) 解密, 模式为 AES128-CTR 或者 AES256-CTR
- 支持连续读写功能, 如果当前一笔 AHB 的读写地址与前一笔连续, 则直接开始数据传输, 省略命令和地址部分。该功能可大幅提升大块数据搬运时的有效带宽
- 针对 pSRAM 和 HyperRAM 的内部动态刷新特性, 自动处理颗粒最长 CS 拉低时间、最近 CS 访问间隔、最大 burst 数据长度等限制, 无需软件处理

3.8.2 SD/SDIO/eMMC

SDMMC 支持 SD 协议 3.0 以及 eMMC 标准 4.51, 可作为 HOST 控制器与 SD/SDIO/eMMC 设备交互。SDMMC 内置链式 DMA 控制器以及 1K 字节 FIFO, 可自主进行数据读写, 支持分块数据搬运。SDMMC 支持 SDR 单线、4 线和 8 线模式, 并支持 DDR 4 线和 8 线模式。

SDMMC 主要特性:

- 兼容 SD Host Controller Standard Specification Version 3.0
- 兼容 SD 3.0 Physical Layer Specification Version 3.01
- 兼容 SDIO Specification Version 3.0
- 兼容 JEDEC JESD84-B451 eMMC 4.51 Specification
- 支持 SDSC/SDHC/SDXC/SDHS 卡
- 支持 UHS-1: SDR12/SDR25/SDR50/SDR104/DDR50
- 支持 SDR 单线、4 线、8 线模式
- 支持 DDR 4 线、8 线模式
- 内置 1K 字节 FIFO, 最大支持单 block 512 字节
- 可配置时钟
- 内置链式 DMA

3.9 CAN

CAN(Contoller Area Network) 兼容 CAN 协议 2.0b, 不支持 CAN FD。CAN 可配置基础传输速率, 内部包含接收 FIFO 与发送 FIFO, 支持多帧自动收发、自动重传、抢占发送等功能。CAN 包含灵活可配置的接收 ID 自动过滤器, 仅在接收 FIFO 中保存过滤后的帧。发现总线和收发异常时, CAN 具有完备的错误通知机制。

CAN1 与 CAN2 均位于 HPSYS。

CAN 主要特性:

- 兼容 CAN 2.0b, 不支持 CAN FD
- 可配置数据率, CAN2.0b 可至 1Mbps
- 支持基础帧和扩展帧
- 帧数据长度可达 8byte
- 接收 FIFO 深度 16, 发送 FIFO 深度 16+1
- 16 个灵活配置的 ID 过滤器
- 支持帧抢占发送

- 错误检测与通知机制

3.10 各种外设接口速率汇总

表 3-2: 常用接口速率

控制器	最高速率	单位	备注
MPI1	144	MHz	合封 OPI/HPI-PSRAM
MPI2	144	MHz	合封 OPI/HPI-PSRAM
MPI3	96	MHz	外挂 QSPI-NOR, QSPI-NAND Flash
MPI4	96	MHz	外挂 QSPI-NOR, QSPI-NAND Flash
MPI5	48	MHz	合封 QSPI-NOR, DTR
SDMMC	96	MHz	外挂 eMMC
I2C	3.4	MHz	
SPI1/2	48	MHz	
SPI3/4	8	MHz	
UART	3	Mbaud	
I2S	48	KHz	采样率 48KHz, 32-bit×2 channel
PDM	3.072	MHz	
CAN	1	MHz	
GPADC	4	Msp/s	
SDADC	4	Ksp/s	

4 电气特性

4.1 基本电气特性

表 4-1: 运行条件

Symbol	Description	Min	Typ	Max	Unit
VDD	Power supply voltage from external source	1.7	3.3	3.6	V
T _{amb}	Ambient temperature	-30		+80	°C
V _{IL}	CMOS low level input voltage	0		0.3×V _{IO}	V
V _{IH}	CMOS high level input voltage	0.7×V _{IO}		V _{IO}	V
V _{TH}	CMOS threshold voltage		0.5×V _{IO}		V

表 4-2: 绝对最大值

Symbol	Description	Min	Typ	Max	Unit
VDD	Power supply voltage from external source			3.6	V
T _{Storage}	Storage temperature	-40		125	°C
V _{IN}	Input voltage	0		V _{IO} +0.3	V
V _{LNA}	LNA input level			0	dBm
I _{IN}	Input current			20	mA

表 4-3: PMU 供电规格

PMU 电源管脚	最小电压 (V)	典型电压 (V)	最大电压 (V)	最大电流 (mA)	详细描述
PVDD1	1.71	1.8	3.6	100	PVDD1 电源输入
PVDD2	1.71	1.8	3.6	50	PVDD2 电源输入
BUCK1_LX BUCK1_FB	-	1.25	-	100	BUCK1_LX 输出, 接电感 内部电源输入 1, 接电感另一端, 且外接电容
BUCK2_LX BUCK2_FB	-	0.9	-	50	BUCK2_LX 输出, 接电感 内部电源输入 2, 接电感另一端, 且外接电容
LDO_VOUT1	-	1.1	-	100	LDO 输出, 外接电容
VDD_RET	-	0.9	-	1	RET LDO 输出, 外接电容
VDD_RTC	-	1.1	-	1	RTC LDO 输出, 外接电容

表 4-4: 其它电源供电规格

其它电源管脚	最小电压 (V)	典型电压 (V)	最大电压 (V)	最大电流 (mA)	详细描述
AVDD_BRF	1.71	1.8	3.3	1	射频电源输入
AVDD18_DSI	1.71	1.8	2.5	20	MIPI DSI 电源输入
AVDD33_ANA	3.15	3.3	3.45	50	模拟电源 + 射频 PA 电源输入
AVDD33_AUD	3.15	3.3	3.45	50	模拟音频电源输入
AVDD33_USB	3.15	3.3	3.45	50	USB 电源输入
MIC_BIAS	1.4	-	2.8	-	MIC 电源输出
VDDIOA	1.71	1.8	3.45	-	PA12-PA93 I/O 电源输入
VDDIOA2	1.71	1.8	3.45	-	PA0-PA11 I/O 电源输入
VDDIOB	1.71	1.8	3.45	-	PB I/O 电源输入
VDDIOSA	1.7	1.8	1.95	-	SIPA 电源输入
VDDIOSB	1.7	1.8	1.95	-	SIPB 电源输入
VDDIOSC	1.7	1.8	1.95	-	SIPC 电源输入

表 4-5: I/O 特性 @3.3V

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
C_{IN}	管脚电容	2.5	3	3.5	pF
V_{IH}	高电平输入电压	$0.7 \times VDD$	-	VDD	V
V_{IL}	低电平输入电压	VSS	-	$0.3 \times VDD$	V
I_{IH}	高电平输入电流	-	10	40	nA
I_{IL}	低电平输入电流	-	10	40	nA
V_{OH}	高电平输出电压 (高阻负载)	$0.8 \times VDD$	-	VDD	V
V_{OL}	低电平输出电压 (高阻负载)	VSS	-	$0.2 \times VDD$	V
I_{OH}	高电平驱动电流 ($V_{OH}=0.8 \times VDD$, 最大驱动强度)	12	30	38	mA
I_{OL}	低电平驱动电流 ($V_{OH}=0.2 \times VDD$, 最大驱动强度)	12	30	38	mA
R_{PU}	内部上拉电阻 ($V_{pad}=0.8 \times VDD$)	7	10	20	k Ω
R_{PD}	内部下拉电阻 ($V_{pad}=0.2 \times VDD$)	7	10	20	k Ω
V_{IH_nRST}	芯片复位释放电压	$0.7 \times VDD$	-	VDD	V
V_{IL_nRST}	芯片复位电压	VSS	-	$0.3 \times VDD$	V

4.2 可靠性

表 4-6: 可靠性测试

测试项目	测试条件	适用产品	测试标准
HTOL (高温工作寿命)	Tj=125°C, 1000 小时	SF32LB58x	JESD22-A108
ESD (静电放电敏感度)	HBM (人体放电模式) $\pm 3000\text{ V}$	SF32LB58x	JS-001-2017
	CDM (充电器件模式) $\pm 1000\text{ V}$	SF32LB58x	JS-002-2018
Latch-up (门锁测试)	I-Test: $\pm 200\text{ mA}$	SF32LB58x	JESD78E
	OVT: $+1.5 \times V_{\text{ddMAX}}$	SF32LB58x	
MSL3 (湿度敏感等级)	烘烤: 125°C, 24 小时 浸泡: 30°C, 60% RH, 192 小时 回流焊: 260 $\pm$ 0°C, 20 秒, 三次	SF32LB58x	JESD22-A113
TCT (高低温循环试验)	-65°C~150°C, Dwell=15min, 1000 次循环	SF32LB58x	JESD22-A104
uHAST (无偏压高加速温湿度应力试验)	130°C, 85% RH, 33.3psig, 96 小时	SF32LB58x	JESD22-A118
HTSL (高温贮存寿命)	Ta=150°C, 1000 小时	SF32LB58x	JESD22-A103

4.3 功耗特性

4.3.1 关机功耗

表 4-7: 关机功耗

符号	1.8V 供电 (典型值)	单位
$I_{\text{POWER OFF (RTC 唤醒)}}$	683.3	nA
$I_{\text{POWER OFF (按键唤醒)}}$	429.3	nA

4.3.2 处理器功耗

表 4-8: 处理器功耗

符号	条件	电源电压 1.8V 电流 (mA)	电源电压 1.8V 电流增量 (uA/MHz)	电源电压 3.8V 电流 (mA)	电源电压 3.8V 电流增量 (uA/MHz)
I_{CoreMark}	HPSYS	240MHz	19.652	10.34	31.305
		192MHz	16.797	8.84	
	LPSYS	48MHz	1.695	0.89	14.518
		24MHz	1.033	0.54	
$I_{\text{WhileLoop}}$	HPSYS	240MHz	15.168	7.98	21.250
		192MHz	13.23	6.96	
	LPSYS	48MHz	1.265	0.67	9.846
		24MHz	0.816	0.43	

* 1. 以上电源电压 3.8V 的功耗是依据 1.8V 及 3.3V 两路供电的测试数据按照效率计算的结果 (计算公式: $I_{3.8V} = I_{1.8V} \times 1.8/90\% / 3.8 + I_{3.3V}$)。

4.3.3 BLE 功耗

表 4-9: BLE 功耗

符号	条件	1.8V 供电 (典型值)	3.8V 供电 (典型值)	单位
$I_{\Delta TX}$	$TX_{\text{POWER}}=0\text{dBm}$	4.19	2.21	mA
$I_{\Delta RX}$		4.03	2.12	mA

4.3.4 BLE、经典蓝牙各种状态下的平均功耗

表 4-10: BLE、经典蓝牙各种状态下的平均功耗

模式	条件	电源电压 3.8V @TXpower=0dBm 典型值	电源电压 3.8V @TXpower=10dBm* 典型值	单位
△BT Sniff Mode	50ms (attempt=4)	235.1	275.2	uA
	100ms (attempt=4)	119.2	137.7	uA
	200ms (attempt=4)	59.6	68.6	uA
	500ms (attempt=4)	23.8	27.5	uA
	1s (attempt=4)	11.9	13.8	uA
△BLE ADV	50ms	170.9	321.3	uA
	100ms	91.7	163.0	uA
	200ms	47.6	84.3	uA
	500ms	19.5	34.4	uA
	1s	9.8	17.3	uA
△BLE Connection	50ms	145.1	172.1	uA
	100ms	75.0	87.5	uA
	200ms	37.6	43.9	uA
	500ms	15.1	17.6	uA
	1s	7.5	10.4	uA
△Scan	Inquiry Scan or Page Scan	31.8	32.2	uA
△Both Scan	Inquiry Scan and Page Scan	58.5	59.2	uA
Standby		7.4		uA

* 1. Scan 每 1.28s 接收 11.25ms, Both Scan 每 1.28s 接收 22.5ms。

2. 电源: PVDD_PMU1+PVDD_PMU2+AVDDBRF+DSI+ANA_3V3。

3. 以上电源电压 3.8V 的功耗是依据 1.8V 及 3.3V 两路供电的测试数据按照效率计算的结果 (计算公式: $I_{3.8V} = I_{1.8V} \times 1.8/90\% / 3.8 + I_{3.3V}$)。

4. 计算示例:

bt 500ms sniff @TXpower10dBm: =27.5+7.4=34.9uA

bt 500ms sniff + ble 500ms connection @TXpower10dBm: ==27.5+17.6+7.4=52.5uA

4.4 蓝牙射频

4.4.1 BLE 射频

4.4.1.1 BLE 发射机性能

表 4-11: BLE 发射机性能—1Mbps 模式

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Maximum RF transmit power			19		dBm
RF power control range		-20		19	dBm
Adjacent channel transmit power (@+19dBm)	F = F ₀ +2MHz		-27	-20	dBm
	F = F ₀ -2MHz		-27	-20	dBm
	F = F ₀ +3MHz		-31	-30	dBm
	F = F ₀ -3MHz		-31	-30	dBm
	F = F ₀ +>3MHz		-38	-30	dBm
	F = F ₀ ->3MHz		-38	-30	dBm
Δf_{1avg} Maximum modulation		225	250	275	kHz
Δf_{2max} Minimum modulation		185	210		kHz
$\Delta f_{2avg}/\Delta f_{1avg}$		0.8	0.89		
ICFT		-150	±20	150	kHz
Drift rate		-20	±4	20	kHz/50us
Drift		-50	±4	50	kHz
Harmonic spur (@+19dBm transmit power)	Second harmonic		-50*		dBm
	Third harmonic		-40*		dBm

* With external π type matching network

表 4-12: BLE 发射机性能—2Mbps 模式

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Maximum RF transmit power			19		dBm
RF power control range		-20		19	dBm
Adjacent channel transmit power (@+19dBm)	F = F ₀ +4MHz		-37	-20	dBm
	F = F ₀ -4MHz		-37	-20	dBm
	F = F ₀ +5MHz		-38	-20	dBm
	F = F ₀ -5MHz		-38	-20	dBm
	F = F ₀ +>5MHz		-42	-30	dBm
	F = F ₀ ->5MHz		-42	-30	dBm
Δf_{1avg} Maximum modulation		450	500	550	kHz
Δf_{2max} Minimum modulation		370	420		kHz
$\Delta f_{2avg}/\Delta f_{1avg}$		0.8	0.89		
ICFT		-150	±20	150	kHz
Drift rate		-20	±4	20	kHz/50us
Drift		-50	±4	50	kHz
Harmonic Spur (@+19dBm transmit power)	Second harmonic		-50*		dBm
	Third harmonic		-40*		dBm

* With external π type matching network

4.4.1.2 BLE 接收机性能

表 4-13: BLE 接收机性能—1Mbps 模式

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty off@30.8% PER & 37bytes		/	-100	/	dBm
Sensitivity with dirty on@30.8% PER & 37bytes		/	-99.3	/	dBm
Maximum received signal@30.8% PER		/	0	/	dBm
C/I co-channel			7		dB
Adjacent channel selectivity C/I	$F = F_0 + 1\text{MHz}$		-10		dB
	$F = F_0 - 1\text{MHz}$		-7		dB
	$F = F_0 + 2\text{MHz}$		-43		dB
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$		-40		dB
	$F = F_0 + 3\text{MHz}$		-50		dB
	$F = F_0 - 3\text{MHz}$		-40		dB
	$F = F_{\text{image}} (F_0 - 4\text{MHz})$		-24		dB
Out of band blocking performance	30MHz~2000MHz		-11		dBm
	2000MHz~2400MHz		-25		dBm
	2500~3000MHz		-25		dBm
	3000MHz~12.5GHz		-10		dBm
Intermodulation			-24		dBm

表 4-14: BLE 接收机性能—2Mbps 模式

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty off@30.8% PER & 37bytes		/	-97	/	dBm
Sensitivity with dirty on@30.8% PER & 37bytes		/	-96.5	/	dBm
Maximum received signal@30.8% PER		/	0	/	dBm
C/I co-channel			7		dB
Adjacent channel selectivity C/I	$F = F_0 + 2\text{MHz}$		-10		dB
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$		-8		dB
	$F = F_0 + 4\text{MHz}$		-44		dB
	$F = F_0 - 4\text{MHz}$		-34		dB
	$F = F_0 + 6\text{MHz}$		-50		dB
	$F = F_0 - 6\text{MHz}$		-24		dB
	$F = F_{\text{image}} (F_0 - 6\text{MHz})$		-24		dB
Out of band blocking performance	30MHz 2000MHz		-11		dBm
	2000MHz-2400MHz		-25		dBm
	2500-3000MHz		-25		dBm
	3000MHz-12.5GHz		-10		dBm
Intermodulation			-25		dBm

表 4-15: BLE 接收机性能—S2 模式

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty transmit off@30.8% PER & 37bytes		/	-104.5	/	dBm
Sensitivity with dirty transmit on@30.8% PER & 37bytes		/	-104	/	dBm
Maximum received signal@30.8% PER		/	0	/	dBm
C/I co-channel			2		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = F0+1MHz		-12		dB
	F = F0-1MHz		-9		dB
	F = F0+2MHz		-48		dB
	F = F0-2MHz		-43		dB
	F = F0+3MHz		-58		dB
	F = F0-3MHz		-43		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = Fimage (F0-4MHz)		-31		dB

表 4-16: BLE 接收机性能—S8 模式

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty transmit off@30.8% PER & 37bytes		/	-107.5	/	dBm
Sensitivity with dirty transmit on@30.8% PER & 37bytes		/	-107	/	dBm
Maximum received signal@30.8% PER		/	0	/	dBm
C/I co-channel			1		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = F0+1MHz		-12		dB
	F = F0-1MHz		-9		dB
	F = F0+2MHz		-48		dB
	F = F0-2MHz		-44		dB
	F = F0+3MHz		-58		dB
	F = F0-3MHz		-44		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = Fimage (F0-4MHz)		-32		dB

4.4.2 经典蓝牙

4.4.2.1 发射机性能

表 4-17: 发射机性能—Basic Data Rate

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Maximum RF transmit power			19		dBm
RF power control step		2	4	8	dB
Adjacent channel transmit power	$F = F_0 + 2\text{MHz}$		-37	-20	dBm
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$		-37	-20	dBm
	$F = F_0 + 3\text{MHz}$		-41	-40	dBm
	$F = F_0 - 3\text{MHz}$		-41	-40	dBm
	$F = F_0 + >3\text{MHz}$		-44	-40	dBm
	$F = F_0 - >3\text{MHz}$		-44	-40	dBm
$\Delta f_{1\text{avg}}$ modulation		140	160	175	kHz
$\Delta f_{2\text{max}}$ modulation		120	150	175	kHz
$\Delta f_{2\text{avg}} / \Delta f_{1\text{avg}}$		0.8	0.9		
ICFT		-75	0	75	kHz
Drift (1 slot packet)		-25	0	25	kHz
Drift (5 slot packet)		-40	0	40	kHz
Harmonic spur	3G-20GHz		-35		dBm

表 4-18: 发射机性能—Enhanced Data Rate

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Maximum RF transmit power			13		dBm
DPSK Power - GFSK Power	2-DH5		0		dB
$\pi/4$ DQPSK max w_0		-10	0	10	kHz
$\pi/4$ DQPSK max w_i		-75	0	+75	kHz
$\pi/4$ DQPSK max $ w_i + w_0 $		-75	0	+75	kHz
8DPSK max w_0		-10	0	10	kHz
8DPSK max w_i		-75	0	+75	kHz
8DPSK max $ w_i + w_0 $		-75	0	+75	kHz
$\pi/4$ DQPSK modulation accuracy	RMS DEVM		6	20	%
	99% DEVM		11	30	%
	Peak DEVM		16	35	%
8DPSK modulation accuracy	RMS DEVM		6	13	%
	99% DEVM		11	20	%
	Peak DEVM		16	25	%
In-band spurious emissions	$F = F_0 + 1\text{MHz}$		-39	-26	dB
	$F = F_0 - 1\text{MHz}$		-41	-26	dB
	$F = F_0 + 2\text{MHz}$		-28	-20	dBm
	$F = F_0 - 2\text{MHz}$		-29	-20	dBm
	$F = F_0 + 3\text{MHz}$		-39*		dBm
	$F = F_0 - 3\text{MHz}$		-39*		dBm
	$F = F_0 + >3\text{MHz}$		-40	-40	dBm
	$F = F_0 - >3\text{MHz}$		-40	-40	dBm
EDR differential phase encoding			99	100	%

* Exceptions in up to 3 bands are allowed. For exceptions, $\text{PTX} \leq -20\text{dBm}$.

4.4.2.2 接收机性能

表 4-19: 接收机性能—Basic Data Rate

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty transmit off@0.1% BER		/	-96.3	/	dBm
Sensitivity with dirty transmit on@0.1% BER		/	-94	/	dBm
Maximum received signal@0.1% BER		0	/	/	dBm
C/I co-channel			10		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = F ₀ +1MHz		-13		dB
	F = F ₀ -1MHz		-10		dB
	F = F ₀ +2MHz		-42		dB
	F = F ₀ -2MHz		-43		dB
	F = F ₀ +3MHz		-48		dB
	F = F ₀ -3MHz		-45		dB
	F = F _{image} (F ₀ -5MHz)		-31		dB
Out of band blocking performance	30MHz~2000MHz	-10	-10		dBm
	2000MHz~2400MHz	-27	-10		dBm
	2500~3000MHz	-27	-10		dBm
	3000MHz~12.5GHz	-10	-10		dBm
Intermodulation			-22		dBm

表 4-20: 接收机性能—Enhanced Data Rate- $\pi/4$ DQPSK

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty transmit off@0.01% BER		/	-95.5	/	dBm
Sensitivity with dirty transmit on@0.01% BER		/	-95	/	dBm
Maximum received signal@0.01% BER		/	0	/	dBm
C/I co-channel			11		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = F ₀ +1MHz		-13		dB
	F = F ₀ -1MHz		-9		dB
	F = F ₀ +2MHz		-35		dB
	F = F ₀ -2MHz		-31		dB
	F = F ₀ +3MHz		-41		dB
	F = F ₀ -3MHz		-41		dB
	F = F _{image} (F ₀ -5MHz)		-30		dB

表 4-21: 接收机性能—Enhanced Data Rate-8DPSK

Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Sensitivity with dirty transmit off@0.01% BER		/	-88.5	/	dBm
Sensitivity with dirty transmit on@0.01% BER		/	-87	/	dBm
Maximum received signal@0.01% BER		/	0	/	dBm
C/I co-channel			17		dB
Adjacent channel selectivity C/I	F = F ₀ +1MHz		-4		dB
	F = F ₀ -1MHz		-5		dB
	F = F ₀ +2MHz		-29		dB
	F = F ₀ -2MHz		-29		dB
	F = F ₀ +3MHz		-39		dB
	F = F ₀ -3MHz		-39		dB
	F = F _{image} (F ₀ -5MHz)		-28		dB

4.5 音频性能

表 4-22: 音频 ADC 性能

Analogue to Digital Converter under 3.3V

Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Resolution		/	/	24	Bits
Sample Frequency		8	/	48	kHz
Analog Gain Range	1dB/Step	-20		10	dB
Input Resistance	Analog Gain = 0dB, @48kHz Sample Frequency	/	23	/	K Ω
Dynamic Range	1kHz -60dBFS Input, @48kHz Sample Frequency, Output A-Weighted	/	99	/	dB
Signal to Noise Ratio	1kHz Input, @48kHz Sample Frequency, Output A-Weighted	/	99	/	dB
Total Harmonic Distortion+Noise	Analog Gain = 0dB, 1kHz Input, @48kHz Sample Frequency	/	-90	/	dB

表 4-23: 音频 DAC 性能

Digital to Analogue Converter under 3.3V

Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Resolution		/	/	24	Bits
Output Swing			0.9		Vrms
Sample Frequency		8	/	48	kHz
Total Harmonic Distortion+Noise	1kHz Output, 0dBFS, with 10kOhm Loading, @48kHz Sample Frequency, Output A-Weighted	/	-101	/	dB
Dynamic Range	1kHz Output, -60dBFS, with 10kOhm Loading, @48kHz Sample Frequency, Output A-Weighted	/	109	/	dB
Noise Floor		/	3.3	/	μ V rms
Signal to Noise Ratio	1kHz Output, 0dBFS, with 10kOhm Loading, @48kHz Sample Frequency, Output A-Weighted	/	109	/	dB

4.6 IO 驱动能力

表 4-24: IO 驱动能力

DS1	DS0	Driving Capability
0	0	2mA
0	1	4mA
1	0	8mA
1	1	12mA

5 封装与硬件

5.1 管脚布局

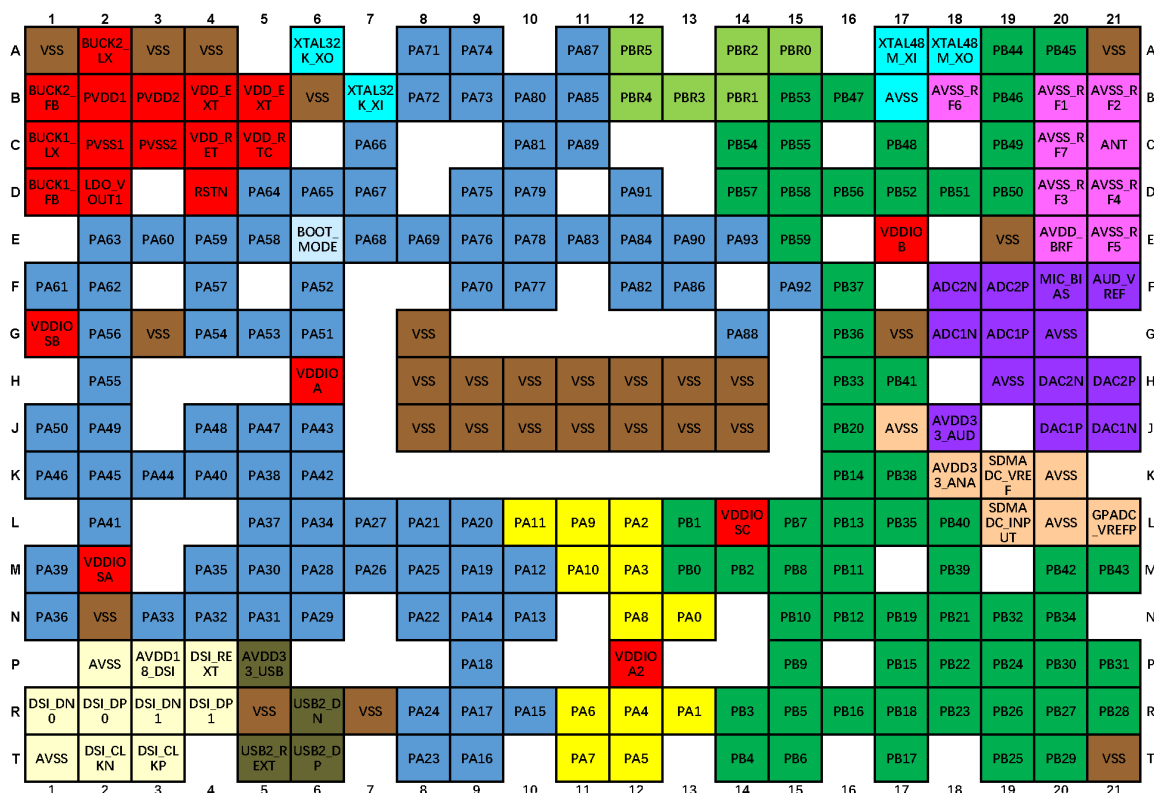


图 5-1: SF32LB58x (BGA256) 管脚布局 (俯视图)

5.2 管脚描述

本芯片的管脚类型如表5-1所示，以下将分别对大核域 GPIO、小核域 GPIO、其它专用管脚加以描述。

表 5-1: 管脚类型

Pin Type	Description
I/O	Digital input/output
I	Digital input
O	Digital output
A, I	Analog input
A, O	Analog output
A, I/O	Analog input/output
PWR	Power
GND	Ground

说明:

- 在低功耗场景下，悬空的输入有可能导致开启了输入功能的数字 I/O 的功耗上升，所以在这类 I/O 上需要按照功能配置相应的确定电压，具体方法包括连接在其它芯片的有确定输出电压的 I/O 上，或连接相应的上拉或下拉电阻。

5.2.1 大核域 GPIO (PA) 列表

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
N13	PA00	I/O	0	GPIO_A0
			1	SD1_DIO7
			3	CAN1_TXD
			4	I2C1_SCL
			5	ATIM1_CH1
			6	UART3_RXD
			Others	Reserved
R13	PA01	I/O	0	GPIO_A1
			1	SD1_DIO2
			2	MPI4_DIO2
			Others	Reserved
L12	PA02	I/O	0	GPIO_A2
			2	SD1_CLKIN
			3	CAN2_RXD
			5	ATIM1_CH1N
			6	UART3_RXD
			Others	Reserved
M12	PA03	I/O	0	GPIO_A3
			1	SD1_DIO5
			3	CAN1_RXD
			4	I2C1_SDA
			5	ATIM1_CH2
			6	UART3_TXD
			Others	Reserved
R12	PA04	I/O	0	GPIO_A4
			1	SD1_DIO1
			2	MPI4_DIO1
			Others	Reserved
T12	PA05	I/O	0	GPIO_A5
			1	SD1_DIO0
			2	MPI4_DIO0
			Others	Reserved
R11	PA06	I/O	0	GPIO_A6
			1	SD1_DIO3
			2	MPI4_DIO3
			Others	Reserved
T11	PA07	I/O	0	GPIO_A7
			1	SD1_DIO4
			2	SCL_CLK
			3	UART2_TXD
			5	ATIM1_CH2N
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
N12	PA08	I/O	0	GPIO_A8
			1	SD1_DIO6
			2	SCL_DIO
			3	UART2_RXD
			5	ATIM1_CH3
			Others	Reserved
L11	PA09	I/O	0	GPIO_A9
			1	SD1_CLK
			2	MPI4_CLK
			Others	Reserved
M11	PA10	I/O	0	GPIO_A10
			1	SD1_CMD
			2	MPI4_CS
			Others	Reserved
L10	PA11	I/O	0	GPIO_A11
			2	SCL_RST
			3	CAN2_TXD
			4	I2C1_SDA
			5	ATIM1_CH3N
			6	UART3_TXD
			Others	Reserved
M10	PA12	I/O	0	GPIO_A12
			4	GPTIM1_CH1
			5	ATIM1_CH4
			7	LCDC1_DPL_CLK
			Others	Reserved
N10	PA13	I/O	0	GPIO_A13
			4	GPTIM1_CH2
			5	ATIM1_BKIN
			7	LCDC1_DPL_DE
			Others	Reserved
N9	PA14	I/O	0	GPIO_A14
			2	I2S1_LRCK
			7	LCDC1_DPL_HSYNC
			Others	Reserved
R10	PA15	I/O	0	GPIO_A15
			4	GPTIM1_CH3
			5	ATIM1_BKIN2
			7	LCDC1_DPL_VSYNC
			Others	Reserved
T9	PA16	I/O	0	GPIO_A16
			1	I2C1_SDA
			2	UART2_TXD
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
R9	PA17	I/O	0	GPIO_A17
			1	I2C1_SCL
			2	UART2_RXD
			Others	Reserved
P9	PA18	I/O	0	GPIO_A18
			1	PDM1_DATA
			2	I2S1_SDI
			3	UART2_RTS
			4	I2C2_SCL
			7	LCDC1_DPL_SD
			Others	Reserved
M9	PA19	I/O	0	GPIO_A19
			2	SCL_RST
			4	GPTIM1_CH4
			5	ATIM1_ETR
			7	LCDC1_DPL_CM
			8	LCDC1_JDI_VCK
			Others	Reserved
L9	PA20	I/O	0	GPIO_A20
			1	UART3_RXD
			2	SPI1_DI
			3	UART2_CTS
			Others	Reserved
L8	PA21	I/O	0	GPIO_A21
			1	UART3_TXD
			2	SPI1_DO
			3	UART2_RTS
			Others	Reserved
N8	PA22	I/O	0	GPIO_A22
			1	PDM2_DATA
			4	GPTIM1_ETR
			5	ATIM2_CH1
			7	LCDC1_DPL_R0
			8	LCDC1_JDI_VST
			Others	Reserved
T8	PA23	I/O	0	GPIO_A23
			1	PDM1_CLK
			2	I2S1_BCK
			3	UART2_CTS
			4	I2C2_SDA
			7	LCDC1_DPL_R1
			Others	Reserved
R8	PA24	I/O	0	GPIO_A24
			5	LCDC1_8080_RSTB
			6	LCDC1_SPL_RSTB
			7	LCDC1_DPL_R2
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
M8	PA25	I/O	0	GPIO_A25
			1	PDM2_CLK
			2	SD1_CLKIN
			4	GPTIM2_CH1
			5	ATIM2_CH1N
			7	LCDC1_DPL_R3
			8	LCDC1_JDL_XRST
			Others	Reserved
M7	PA26	I/O	0	GPIO_A26
			2	SCL_CLK
			4	GPTIM2_CH2
			5	ATIM2_CH2
			6	LCDC1_8080_DIO2
			7	LCDC1_DPL_R4
			Others	Reserved
L7	PA27	I/O	0	GPIO_A27
			2	SCL_DIO
			4	GPTIM2_CH3
			5	ATIM2_CH2N
			6	LCDC1_8080_DIO3
			7	LCDC1_DPL_R5
			8	LCDC1_JDL_XRST
			Others	Reserved
M6	PA28	I/O	0	GPIO_A28
			1	UART2_TXD
			2	SPI1_CLK
			4	I2C2_SCL
			Others	Reserved
N6	PA29	I/O	0	GPIO_A29
			1	UART2_RXD
			2	SPI1_CS
			4	I2C2_SDA
			Others	Reserved
M5	PA30	I/O	0	GPIO_A30
			1	SPI2_CS
			2	SD1_DIO1
			3	MPI4_CS
			Others	Reserved
N5	PA31	I/O	0	GPIO_A31
			1	UART1_TXD
			4	I2C3_SCL
			Others	Reserved
N4	PA32	I/O	0	GPIO_A32
			1	UART1_RXD
			4	I2C3_SDA
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
N3	PA33	I/O	0	GPIO_A33
			2	SD1_DIO7
			5	UART2_CTS
			Others	Reserved
L6	PA34	I/O	0	GPIO_A34
			2	SD1_CMD
			5	UART2_RTS
			Others	Reserved
M4	PA35	I/O	0	GPIO_A35
			2	SD1_DIO6
			5	UART3_CTS
			Others	Reserved
N1	PA36	I/O	0	GPIO_A36
			2	SD1_DIO2
			3	MPI4_DIO2
			Others	Reserved
L5	PA37	I/O	0	GPIO_A37
			1	SPI2_DO
			2	SD1_DIO5
			3	MPI4_DIO1
			4	SPI2_DIO
			Others	Reserved
K5	PA38	I/O	0	GPIO_A38
			2	SD1_DIO4
			3	MPI4_DIO3
			Others	Reserved
M1	PA39	I/O	0	GPIO_A39
			1	SPI2_CLK
			2	SD1_CLK
			3	MPI4_CLK
			Others	Reserved
K4	PA40	I/O	0	GPIO_A40
			1	SPI2_DI
			2	SD1_DIO3
			3	MPI4_DIO0
			Others	Reserved
L2	PA41	I/O	0	GPIO_A41
			2	SD1_DIO0
			5	UART3_RTS
			Others	Reserved
K6	PA42	I/O	0	GPIO_A42
			4	GPTIM2_CH4
			5	ATIM2_CH3
			6	LCDC1_8080_DIO4
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
J6	PA43	I/O	0	GPIO_A43
			5	LCDC1_8080_TE
			6	LCDC1_SPL_TE
			7	LCDC1_DPL_R6
			8	LCDC1_JDI_HCK
			Others	Reserved
K3	PA44	I/O	0	GPIO_A44
			1	MPI3_CS
			5	LCDC1_8080_CS
			6	LCDC1_SPL_CS
			7	LCDC1_DPL_R7
			8	LCDC1_JDI_HST
			Others	Reserved
K2	PA45	I/O	0	GPIO_A45
			1	MPI3_DIO3
			5	LCDC1_8080_DIO1
			6	LCDC1_SPL_DIO3
			7	LCDC1_DPL_G0
			8	LCDC1_JDI_ENB
			Others	Reserved
K1	PA46	I/O	0	GPIO_A46
			1	MPI3_CLK
			5	LCDC1_8080_WR
			6	LCDC1_SPL_CLK
			7	LCDC1_DPL_G1
			8	LCDC1_JDI_R1
			Others	Reserved
J5	PA47	I/O	0	GPIO_A47
			1	MPI3_DIO2
			5	LCDC1_8080_DIO0
			6	LCDC1_SPL_DIO2
			7	LCDC1_DPL_G2
			8	LCDC1_JDI_R2
			Others	Reserved
J4	PA48	I/O	0	GPIO_A48
			1	MPI3_DIO1
			5	LCDC1_8080_DC
			6	LCDC1_SPL_DIO1
			7	LCDC1_DPL_G3
			8	LCDC1_JDI_G1
			Others	Reserved
J2	PA49	I/O	0	GPIO_A49
			4	GPTIM1_CH1
			5	ATIM2_CH3N
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
J1	PA50	I/O	0	GPIO_A50
			1	MPI3_DIO0
			5	LCDC1_8080_RD
			6	LCDC1_SPI_DIO0
			7	LCDC1_DPL_G4
			8	LCDC1_JDI_G2
			Others	Reserved
G6	PA51	I/O	0	SWCLK
			1	GPIO_A51
			4	GPTIM1_CH2
			5	ATIM2_CH4
			6	LCDC1_8080_DIO5
			Others	Reserved
F6	PA52	I/O	0	SWDIO
			1	GPIO_A52
			4	GPTIM1_CH3
			5	ATIM2_BKIN
			6	LCDC1_8080_DIO6
			Others	Reserved
G5	PA53	I/O	0	GPIO_A53
			7	LCDC1_DPL_G5
			Others	Reserved
G4	PA54	I/O	0	GPIO_A54
			1	SPI1_DO
			2	SPI1_DIO
			3	UART2_RTS
			7	LCDC1_DPL_G6
			Others	Reserved
H2	PA55	I/O	0	GPIO_A55
			4	GPTIM1_CH4
			5	ATIM2_BKIN2
			7	LCDC1_DPL_G7
			Others	Reserved
G2	PA56	I/O	0	GPIO_A56
			1	SPI1_CLK
			3	UART2_CTS
			7	LCDC1_DPL_B0
			Others	Reserved
F4	PA57	I/O	0	GPIO_A57
			1	SPI1_DI
			2	UART2_RXD
			7	LCDC1_DPL_B1
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
E5	PA58	I/O	0	GPIO_A58
			3	LPTIM1_ETR
			4	GPTIM2_CH1
			5	ATIM2_ETR
			6	LCDC1_8080_DIO7
			7	LCDC1_DPL_B2
			Others	Reserved
E4	PA59	I/O	0	GPIO_A59
			1	I2C4_SDA
			2	UART1_TXD
			3	UART3_RTS
			Others	Reserved
E3	PA60	I/O	0	GPIO_A60
			1	I2C4_SCL
			2	UART1_RXD
			3	UART3_CTS
			Others	Reserved
F1	PA61	I/O	0	GPIO_A61
			1	SPI1_CS
			2	UART2_TXD
			7	LCDC1_DPL_B3
			Others	Reserved
F2	PA62	I/O	0	GPIO_A62
			1	I2C2_SCL
			2	UART1_RTS
			3	#GPCOMP_P
			7	LCDC1_DPL_B4
			Others	Reserved
E2	PA63	I/O	0	GPIO_A63
			1	I2C2_SDA
			2	UART1_CTS
			3	#GPCOMP_N
			7	LCDC1_DPL_B5
			Others	Reserved
D5	PA64	I/O	0	GPIO_A64
			3	#WKUP_PIN6
			Others	Reserved
D6	PA65	I/O	0	GPIO_A65
			3	#WKUP_PIN7
			4	GPTIM2_CH2
			5	ATIM1_CH1
			7	LCDC1_DPL_B6
			8	LCDC1_JDL_B1
			Others	Reserved
C7	PA66	I/O	0	GPIO_A66
			3	#WKUP_PIN8
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
D7	PA67	I/O	0	GPIO_A67
			3	#WKUP_PIN9
			4	GPTIM2_CH3
			5	ATIM1_CH1N
			7	LCDC1_DPL_B7
			8	LCDC1_JDL_B2
			Others	Reserved
E7	PA68	I/O	0	GPIO_A68
			3	#WKUP_PIN10
			Others	Reserved
E8	PA69	I/O	0	GPIO_A69
			3	#WKUP_PIN11
			Others	Reserved
F9	PA70	I/O	0	GPIO_A70
			1	SD2_CMD
			2	SPI2_CS
			Others	Reserved
A8	PA71	I/O	0	GPIO_A71
			1	BT_ACTIVE
			Others	Reserved
B8	PA72	I/O	0	GPIO_A72
			1	BT_PRIORITY
			Others	Reserved
B9	PA73	I/O	0	GPIO_A73
			1	BT_COLLISION
			2	UART1_RTS
			3	LPTIM1_OUT
			4	GPTIM2_CH4
			5	ATIM1_CH2
			Others	Reserved
A9	PA74	I/O	0	GPIO_A74
			1	WLAN_ACTIVE
			2	UART1_CTS
			3	LPTIM1_IN
			4	GPTIM2_ETR
			5	ATIM1_CH2N
			6	LCDC1_SPL_RSTB
			7	LCDC1_8080_RSTB
			Others	Reserved
D9	PA75	I/O	0	GPIO_A75
			1	SD2_DIO1
			2	SPI2_DI
			Others	Reserved
E9	PA76	I/O	0	GPIO_A76
			1	SD2_DIO0
			2	SPI2_DO
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
F10	PA77	I/O	0	GPIO_A77
			1	SD2_CLK
			2	SPI2_CLK
			Others	Reserved
E10	PA78	I/O	0	GPIO_A78
			1	SPI2_DI
			2	SD2_CLKIN
			4	GPTIM2_ETR
			5	ATIM1_CH3
			Others	Reserved
D10	PA79	I/O	0	GPIO_A79
			1	SD2_DIO2
			Others	Reserved
B10	PA80	I/O	0	GPIO_A80
			6	LCDC1_SPL_TE
			7	LCDC1_8080_TE
			Others	Reserved
C10	PA81	I/O	0	GPIO_A81
			1	SD2_DIO3
			Others	Reserved
F12	PA82	I/O	0	GPIO_A82
			2	I2S2_SDO
			4	GPTIM1_CH1
			5	ATIM1_CH3N
			6	LCDC1_SPL_DIO1
			7	LCDC1_8080_DC
			8	LCDC1_JDI_SCS
			Others	Reserved
E11	PA83	I/O	0	GPIO_A83
			1	SPI2_CLK
			Others	Reserved
E12	PA84	I/O	0	GPIO_A84
			2	I2S2_LRCK
			4	GPTIM1_CH2
			5	ATIM2_CH1
			6	LCDC1_SPL_DIO2
			7	LCDC1_8080_DIO0
			8	LCDC1_JDI_SCLK
			Others	Reserved
B11	PA85	I/O	0	GPIO_A85
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-2: 大核域 GPIO (PA) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
F13	PA86	I/O	0	GPIO_A86
			2	I2S2_SDI
			4	GPTIM1_CH3
			5	ATIM2_CH1N
			6	LCDC1_SPL_DIO3
			7	LCDC1_8080_DIO1
			8	LCDC1_JDL_SO
			Others	Reserved
A11	PA87	I/O	0	GPIO_A87
			1	SPI2_CS
			Others	Reserved
G14	PA88	I/O	0	GPIO_A88
			6	LCDC1_SPL_CS
			7	LCDC1_8080_CS
			Others	Reserved
C11	PA89	I/O	0	GPIO_A89
			1	SPI2_DO
			3	SPI2_DIO
			Others	Reserved
E13	PA90	I/O	0	GPIO_A90
			2	I2S2_MCLK
			4	GPTIM1_CH4
			5	ATIM2_CH2
			6	LCDC1_SPL_CLK
			7	LCDC1_8080_WR
			8	LCDC1_JDL_DISP
			Others	Reserved
D12	PA91	I/O	0	GPIO_A91
			2	I2S2_BCK
			4	GPTIM1_ETR
			5	ATIM2_CH2N
			6	LCDC1_SPL_DIO0
			7	LCDC1_8080_RD
			8	LCDC1_JDL_EXTCOMIN
			Others	Reserved
F15	PA92	I/O	0	GPIO_A92
			1	I2C3_SCL
			2	UART3_RXD
			3	UART3_CTS
			Others	Reserved
E14	PA93	I/O	0	GPIO_A93
			1	I2C3_SDA
			2	UART3_TXD
			3	UART3_RTS
			Others	Reserved

5.2.2 小核域 GPIO (PB) 列表

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
M13	PB00	I/O	0	GPIO_B0
			1	I2C7_SDA
			2	UART6_RXD
			5	GPTIM3_CH1
			6	LPTIM3_IN
			Others	Reserved
L13	PB01	I/O	0	GPIO_B1
			1	I2C7_SCL
			2	UART6_TXD
			5	GPTIM3_CH2
			6	LPTIM3_OUT
			Others	Reserved
M14	PB02	I/O	0	GPIO_B2
			2	LCDC2_JDI_B1
			3	LCDC2_SPL_TE
			4	LCDC2_JDI_SCLK
			5	GPTIM3_CH3
			Others	Reserved
R14	PB03	I/O	0	GPIO_B3
			2	LCDC2_JDI_B2
			3	LCDC2_SPL_DIO1
			4	LCDC2_JDI_SCS
			5	GPTIM3_CH4
			6	UART4_RTS
			Others	Reserved
T14	PB04	I/O	0	GPIO_B4
			2	LCDC2_JDI_G2
			3	LCDC2_SPL_DIO2
			4	LCDC2_JDI_DISP
			5	GPTIM4_CH1
			6	UART4_CTS
			Others	Reserved
R15	PB05	I/O	0	GPIO_B5
			2	LCDC2_JDI_HCK
			3	LCDC2_SPL_RSTB
			4	LCDC2_JDI_EXTCOMIN
			5	GPTIM4_CH2
			6	UART6_RTS
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
T15	PB06	I/O	0	GPIO_B6
			2	LCDC2_JDI_R2
			3	LCDC2_SPL_DIO3
			4	LCDC2_JDI_SO
			5	GPTIM4_CH3
			6	UART6_CTS
			Others	Reserved
L15	PB07	I/O	0	SWCLK
			1	GPIO_B7
			2	UART4_RXD
			5	GPTIM4_CH4
			Others	Reserved
M15	PB08	I/O	0	GPIO_B8
			2	LCDC2_JDI_G1
			3	LCDC2_SPL_CS
			5	GPTIM5_CH1
			6	BT_ACTIVE
			Others	Reserved
P15	PB09	I/O	0	GPIO_B9
			2	LCDC2_JDI_R1
			3	LCDC2_SPL_DIO0
			4	UART6_TXD
			5	GPTIM5_CH2
			6	WLAN_ACTIVE
			Others	Reserved
N15	PB10	I/O	0	GPIO_B10
			2	LCDC2_JDI_HST
			3	LCDC2_SPL_CLK
			4	UART6_RXD
			5	GPTIM5_CH3
			Others	Reserved
M16	PB11	I/O	0	SWDIO
			1	GPIO_B11
			2	UART4_TXD
			5	GPTIM5_CH4
			Others	Reserved
N16	PB12	I/O	0	GPIO_B12
			1	SPI4_CLK
			2	LCDC2_JDI_ENB
			3	I2C7_SCL
			Others	Reserved
L16	PB13	I/O	0	GPIO_B13
			1	UART6_RXD
			2	UART4_CTS
			5	GPTIM3_CH1
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
K16	PB14	I/O	0	GPIO_B14
			1	UART6_TXD
			2	UART4_RTS
			5	GPTIM3_CH2
			Others	Reserved
P17	PB15	I/O	0	GPIO_B15
			1	SPI4_DI
			2	LCDC2_JDI_VCK
			3	UART6_CTS
			Others	Reserved
R16	PB16	I/O	0	GPIO_B16
			1	SPI4_DO
			2	LCDC2_JDI_XRST
			3	I2C7_SDA
			4	SPI4_DIO
			Others	Reserved
T17	PB17	I/O	0	GPIO_B17
			1	UART5_RXD
			2	SPI3_CLK
			Others	Reserved
R17	PB18	I/O	0	GPIO_B18
			1	UART5_TXD
			2	SPI3_DI
			Others	Reserved
N17	PB19	I/O	0	GPIO_B19
			1	SPI4_CS
			2	LCDC2_JDI_VST
			3	UART6_RTS
			Others	Reserved
J16	PB20	I/O	0	GPIO_B20
			5	GPTIM3_CH3
			Others	Reserved
N18	PB21	I/O	0	GPIO_B21
			3	SPI3_CLK
			5	GPTIM3_CH4
			Others	Reserved
P18	PB22	I/O	0	GPIO_B22
			3	SPI3_DO
			4	SPI3_DIO
			5	GPTIM4_CH1
			Others	Reserved
R18	PB23	I/O	0	GPIO_B23
			1	UART5_CTS
			2	SPI3_DO
			4	SPI3_DIO
			5	GPTIM4_CH2
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
P19	PB24	I/O	0	GPIO_B24
			3	I2S3_SDO
			5	GPTIM4_CH3
			Others	Reserved
T19	PB25	I/O	0	GPIO_B25
			3	SPI3_DI
			5	GPTIM4_CH4
			Others	Reserved
R19	PB26	I/O	0	GPIO_B26
			1	UART5_RTS
			2	SPI3_CS
			5	GPTIM5_CH1
			8	#DCTEST0
			Others	Reserved
R20	PB27	I/O	0	GPIO_B27
			2	SPI4_CLK
			3	I2S3_SDI
			5	GPTIM5_CH2
			8	#DCTEST1
			Others	Reserved
R21	PB28	I/O	0	GPIO_B28
			1	I2C6_SCL
			2	UART6_RXD
			8	#LPCOMP1_P
			Others	Reserved
T20	PB29	I/O	0	GPIO_B29
			1	I2C6_SDA
			2	UART6_TXD
			8	#LPCOMP1_N
			Others	Reserved
P20	PB30	I/O	0	GPIO_B30
			2	SPI4_DO
			3	I2S3_BCK
			4	SPI4_DIO
			5	GPTIM5_CH3
			8	#LPCOMP2_P
			Others	Reserved
P21	PB31	I/O	0	GPIO_B31
			2	SPI4_DI
			3	I2S3_LRCK
			4	AUD_CLK_EXT
			5	GPTIM5_CH4
			8	#LPCOMP2_N
			Others	Reserved
N19	PB32	I/O	0	GPIO_B32
			8	#GPADC_CH0
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
H16	PB33	I/O	0	GPIO_B33
			5	LPTIM3_ETR
			8	#GPADC_CH1
			Others	Reserved
N20	PB34	I/O	0	GPIO_B34
			2	SPI4_CS
			3	I2S3_MCLK
			8	#GPADC_CH2
			Others	Reserved
L17	PB35	I/O	0	GPIO_B35
			8	#GPADC_CH3
			Others	Reserved
G16	PB36	I/O	0	GPIO_B36
			1	UART4_RXD
			5	GPTIM3_CH1
			8	#GPADC_CH4
			Others	Reserved
F16	PB37	I/O	0	GPIO_B37
			1	UART4_TXD
			5	GPTIM3_CH2
			8	#GPADC_CH5
			Others	Reserved
K17	PB38	I/O	0	GPIO_B38
			2	UART6_CTS
			5	GPTIM3_CH3
			8	#GPADC_CH6
			Others	Reserved
M18	PB39	I/O	0	GPIO_B39
			2	UART6_RTS
			5	GPTIM3_CH4
			8	#GPADC_CH7
			Others	Reserved
L18	PB40	I/O	0	GPIO_B40
			3	SPI3_CS
			5	GPTIM3_ETR
			8	#SDADC_CH0
			Others	Reserved
H17	PB41	I/O	0	GPIO_B41
			2	WLAN_ACTIVE
			4	I2S3_SDO
			5	GPTIM4_CH1
			8	#SDADC_CH1
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
M20	PB42	I/O	0	GPIO_B42
			4	I2S3_SDI
			5	GPTIM4_CH2
			8	#SDADC_CH2
			Others	Reserved
M21	PB43	I/O	0	GPIO_B43
			2	UART4_CTS
			3	UART5_CTS
			4	I2S3_BCK
			5	GPTIM4_CH3
			8	#SDADC_CH3
			Others	Reserved
A19	PB44	I/O	0	GPIO_B44
			2	UART4_RTS
			3	UART5_RTS
			4	I2S3_LRCK
			5	GPTIM4_CH4
			8	#ACTEST0
			Others	Reserved
A20	PB45	I/O	0	GPIO_B45
			2	BT_ACTIVE
			5	GPTIM4_ETR
			8	#ACTEST1
			Others	Reserved
B19	PB46	I/O	0	GPIO_B46
			3	AUD_CLK_EXT
			4	I2S3_MCLK
			5	GPTIM5_CH1
			Others	Reserved
B16	PB47	I/O	0	GPIO_B47
			1	I2C5_SDA
			2	UART6_RXD
			5	GPTIM5_CH2
			Others	Reserved
C17	PB48	I/O	0	GPIO_B48
			1	I2C5_SCL
			2	UART6_TXD
			5	GPTIM5_CH3
			Others	Reserved
C19	PB49	I/O	0	GPIO_B49
			2	UART6_CTS
			3	UART6_RXD
			5	GPTIM5_CH4
			Others	Reserved

续表下页...

表 5-3: 小核域 GPIO (PB) 管脚列表 (续)

Pin Number	Pin Name	Type	Sel #	Function
SF32LB58x (BGA256)				
D19	PB50	I/O	0	GPIO_B50
			2	UART6_RTS
			3	UART6_TXD
			5	GPTIM5_ETR
			Others	Reserved
D18	PB51	I/O	0	GPIO_B51
			1	PMIC_SDA
			2	UART4_CTS
			3	UART5_CTS
			5	LPCOMP1_OUT
			Others	Reserved
D17	PB52	I/O	0	GPIO_B52
			1	PMIC_SCLK
			2	UART4_RTS
			3	UART5_RTS
			5	LPCOMP2_OUT
			Others	Reserved
B15	PB53	I/O	0	GPIO_B53
			Others	Reserved
C14	PB54	I/O	0	GPIO_B54
			8	#WKUP_PIN0
C15	PB55	I/O	Others	Reserved
			0	GPIO_B55
			8	#WKUP_PIN1
D16	PB56	I/O	Others	Reserved
			0	GPIO_B56
			2	UART4_CTS
			3	SPI3_CLK
			8	#WKUP_PIN2
D14	PB57	I/O	Others	Reserved
			0	GPIO_B57
			2	UART4_RTS
			3	SPI3_DO
			4	SPI3_DIO
			8	#WKUP_PIN3
D15	PB58	I/O	Others	Reserved
			0	GPIO_B58
			2	UART6_RXD
			3	SPI3_DI
			8	#WKUP_PIN4
E15	PB59	I/O	Others	Reserved
			0	GPIO_B59
			2	UART6_TXD
			3	SPI3_CS
			8	#WKUP_PIN5

5.2.3 专用管脚（电源、射频、模拟、数字）列表

表 5-4: 专用管脚（电源、射频、模拟、数字）列表

Pin Number	Pin Name	Type	Description
SF32LB58x (BGA256)			
A15	PBR<0>	I/O	AON GPIO
B14	PBR<1>	I/O	AON GPIO
A14	PBR<2>	I/O	AON GPIO
B13	PBR<3>	I/O	AON GPIO
B12	PBR<4>	I/O	AON GPIO
A12	PBR<5>	I/O	AON GPIO
B2	PVDD_PMU1	PWR	Power input
B3	PVDD_PMU2	PWR	Power input
C2	PVSS_PMU1	GND	Power ground
C3	PVSS_PMU2	GND	Power ground
C1	PMU_BUCK1_VSW	A,I/O	Buck1 LX
D1	PMU_BUCK1_VOUT	PWR	Buck1 FB
B1	PMU_BUCK2_VOUT	PWR	Buck2 FB
A2	PMU_BUCK2_VSW	A,I/O	Buck2 LX
A3	VSS	GND	Power ground
A4	VSS	GND	Power ground
B4	VDD_EXT	PWR	Ext VDD input
B5	VDD_EXT	PWR	Ext VDD input
D2	HPSYS_LDO_VOUT	PWR	LDO ext Capacitor Point
C4	LPMU_VDD07_RET	PWR	LDO ext Capacitor Point
C5	LPMU_VDD11_RTC	PWR	LDO ext Capacitor Point
B7	XTAL32K_XI	A,I	XTAL IN
A6	XTAL32K_XO	A,O	XTAL OUT
A17	XTAL48M_XI	A,I	XTAL IN
A18	XTAL48M_XO	A,O	XTAL OUT
C21	BRF_ANT	A,I/O	RF ANT
E20	AVDD_BRF	PWR	RF power
B20	AVSS_RRF	GND	RF ground
B21	AVSS_RRF	GND	RF ground
D20	AVSS_TRF	GND	RF ground
D21	AVSS_TRF	GND	RF ground
C20	AVSS_VCO	GND	RF ground
E21	AVSS_TRF2	GND	RF ground
K18	AVDD33_ANA	PWR	Analog power input
J18	AVDD33_AUD	PWR	Audio power input
P5	AVDD33_USB	PWR	USB power input
P3	AVDD18_DSI	PWR	DSI power input
H6	VDDIOA	PWR	PA<12:93> power input
P12	VDDIOA2	PWR	PA<0:11> power input
E17	VDDIOB	PWR	PB/PBR power input
M2	VDDIOSA	PWR	SIPA power input
G1	VDDIOSB	PWR	SIPB power input
L14	VDDIOSC	PWR	SIPC power input
F20	MIC_BIAS	PWR	MIC power output

续表下页...

表 5-4: 专用管脚（电源、射频、模拟、数字）列表（续）

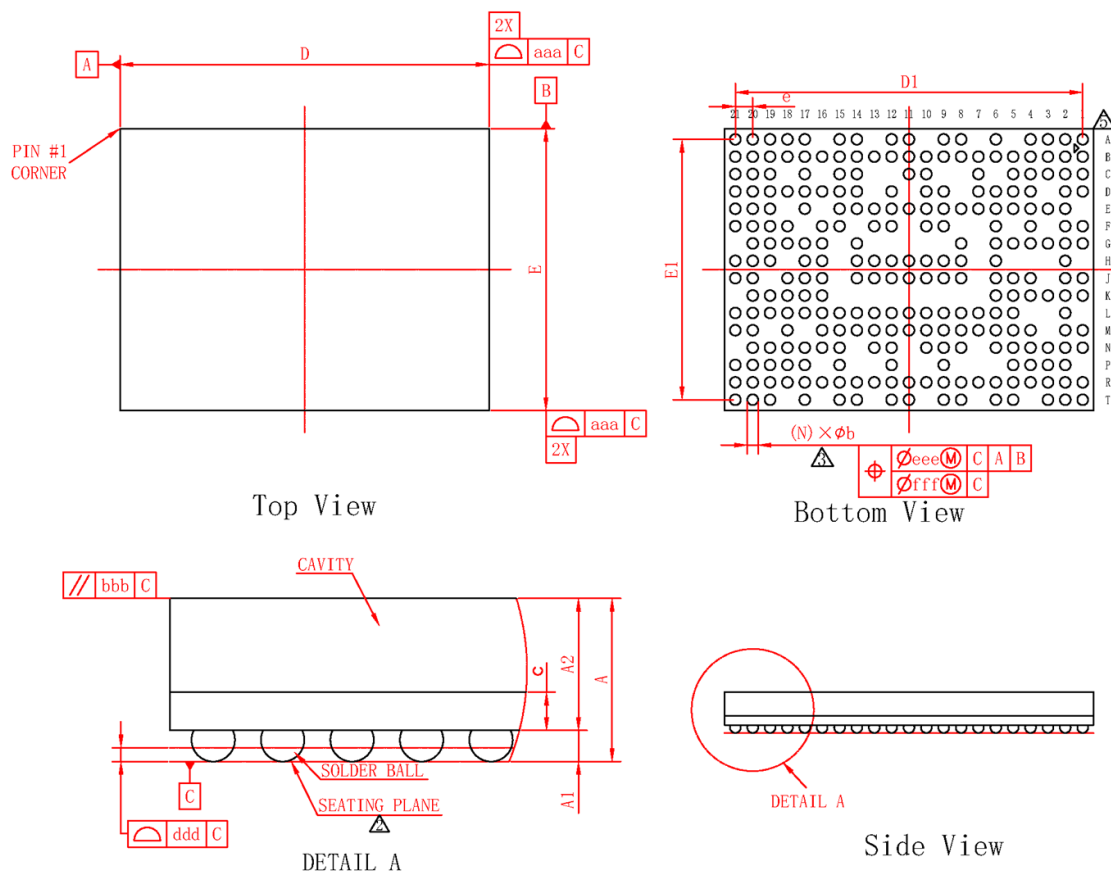
Pin Number SF32LB58x (BGA256)	Pin Name	Type	Description
R6	USB2_DN	A,I/O	USB Negative IO
T6	USB2_DP	A,I/O	USB Positive IO
T5	USB2_REXT	A,O	
D4	RSTN	I	ResetN input
E6	BOOT_MODE	I	Boot mode input
G18	ADC1N	A,I	ADC1 Negative input
G19	ADC1P	A,I	ADC1 Positive input
F18	ADC2N	A,I	ADC2 Negative input
F19	ADC2P	A,I	ADC2 Positive input
J21	DAC1N	A,O	DAC1 Negative output
J20	DAC1P	A,O	DAC1 Positive output
H20	DAC2N	A,O	DAC2 Negative output
H21	DAC2P	A,O	DAC2 Positive output
L20	GPADC_VREFN	GND	Ground
L21	GPADC_VREFP	A,I	GPADC Positive VREF input
L19	SDMADC_INPUT	A,I	SDMADC input
K19	SDMADC_VREF	A,I	SDMADC VREF input
K20	SDMADC_VSS_VREF	GND	Ground
B18	AVSS_BB	GND	RF Ground
B17	AVSS_CAU	GND	Ground
P2	AVSS_DSI	GND	Ground
J17	AVSS33_ANA	GND	Ground
G20	AVSS33_AUD	GND	Ground
F21	AUD_VREF	A,I	Audio VREF input
H19	AUD_VREF_GND	GND	Ground
T2	DSI_CLKN	A,I/O	DSI Negative clock output
T3	DSI_CLKP	A,I/O	DSI Positive clock output
R1	DSI_D0N	A,I/O	DSI Lane 0 Negative inout
R2	DSI_D0P	A,I/O	DSI Lane 0 Positive inout
R3	DSI_D1N	A,I/O	DSI Lane 1 Negative output
R4	DSI_D1P	A,I/O	DSI Lane 1 Positive output
P4	DSI_REXT	A,O	
T1	AVSS_DSI	GND	Ground
A1	VSS	GND	Ground
A21	VSS	GND	Ground
B6	VSS	GND	Ground
E19	VSS	GND	Ground
G3	VSS	GND	Ground
G8	VSS	GND	Ground
G17	VSS	GND	Ground
H8	VSS	GND	Ground
H9	VSS	GND	Ground
H10	VSS	GND	Ground
H11	VSS	GND	Ground
H12	VSS	GND	Ground
H13	VSS	GND	Ground

续表下页...

表 5-4: 专用管脚（电源、射频、模拟、数字）列表（续）

Pin Number	Pin Name	Type	Description
SF32LB58x (BGA256)			
H14	VSS	GND	Ground
J8	VSS	GND	Ground
J9	VSS	GND	Ground
J10	VSS	GND	Ground
J11	VSS	GND	Ground
J12	VSS	GND	Ground
J13	VSS	GND	Ground
J14	VSS	GND	Ground
N2	VSS	GND	Ground
R5	VSS	GND	Ground
R7	VSS	GND	Ground
T21	VSS	GND	Ground

5.3 封装尺寸



symbol	Dimension in mm			Dimension in inch		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.840	0.940	1.040	0.033	0.037	0.041
A1	0.130	0.180	0.230	0.005	0.007	0.009
A2	0.710	0.760	0.810	0.028	0.030	0.032
c	0.180	0.220	0.260	0.007	0.009	0.010
D	8.400	8.500	8.600	0.331	0.335	0.339
E	6.400	6.500	6.600	0.252	0.256	0.260
D1	---	8.000	---	---	0.315	---
E1	---	6.000	---	---	0.236	---
e	---	0.400	---	---	0.016	---
b	0.200	0.250	0.300	0.008	0.010	0.012
aaa	0.100			0.004		
bbb	0.100			0.004		
ddd	0.080			0.003		
eee	0.150			0.006		
fff	0.050			0.002		
Ball Diam	0.250			0.010		
N	256			256		
MD/ME	21/16			21/16		

TECHNOLOGY SPECIFICATION[技术要求]

1. BALL PAD OPENING: 0.230mm; [球形防焊开口: 0.230mm;]

△ PRIMARY DATUM C AND SEATING PLANE ARE THE SOLDER BALLS;

[主要基准C和底面是锡球;]

△ DIMENSION b IS MEASURED AT THE MAXIMUM SOLDER BALL DIAMETER, PARALLEL

← TO PRIMARY DATUM C; [尺寸b是测量最大锡球直径, 平行于主要基准C;]

4. SPECIAL CHARACTERISTICS C CLASS: bbb, ddd; [特殊特性C类: bbb, ddd;]

△ THE PATTERN OF PIN 1 FIDUCIAL IS FOR REFERENCE ONLY;

[PIN 1 标识仅供参考;]

6. BAN TO USE THE LEVEL 1 ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES;

[禁止使用一级环境管理物质;]

图 5-2: SF32LB58x (BGA256) 封装尺寸

5.4 载带尺寸

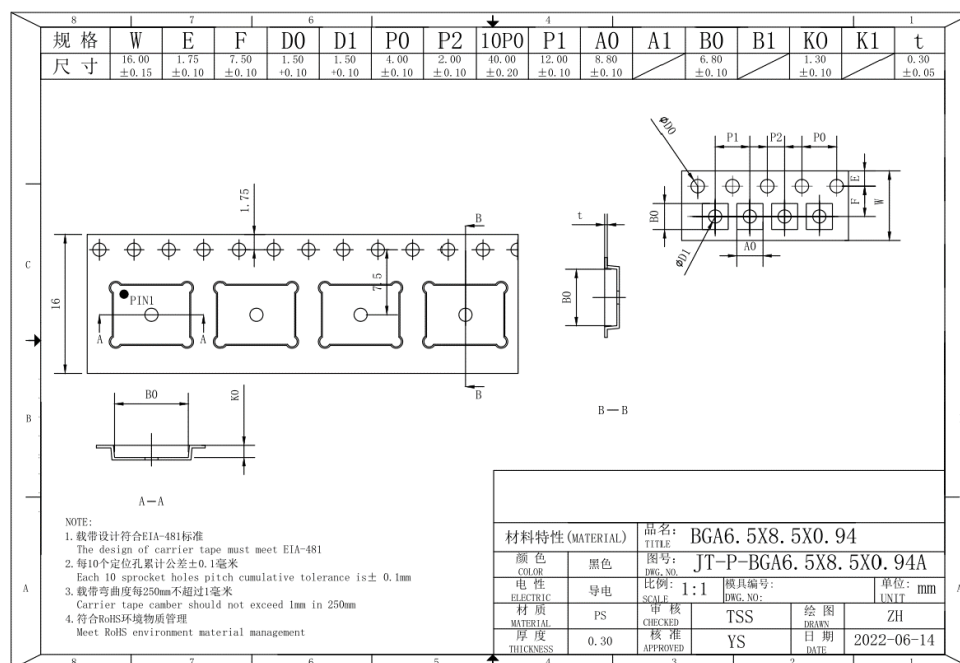


图 5-3: 载带尺寸

5.5 卷盘尺寸

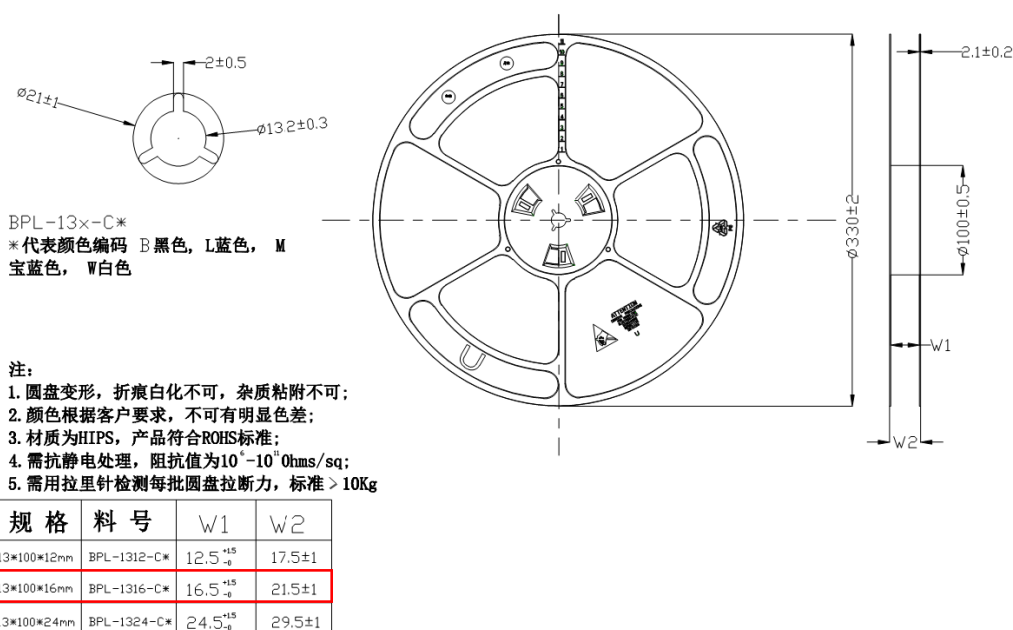


图 5-4: 卷盘尺寸

5.6 分级回流焊

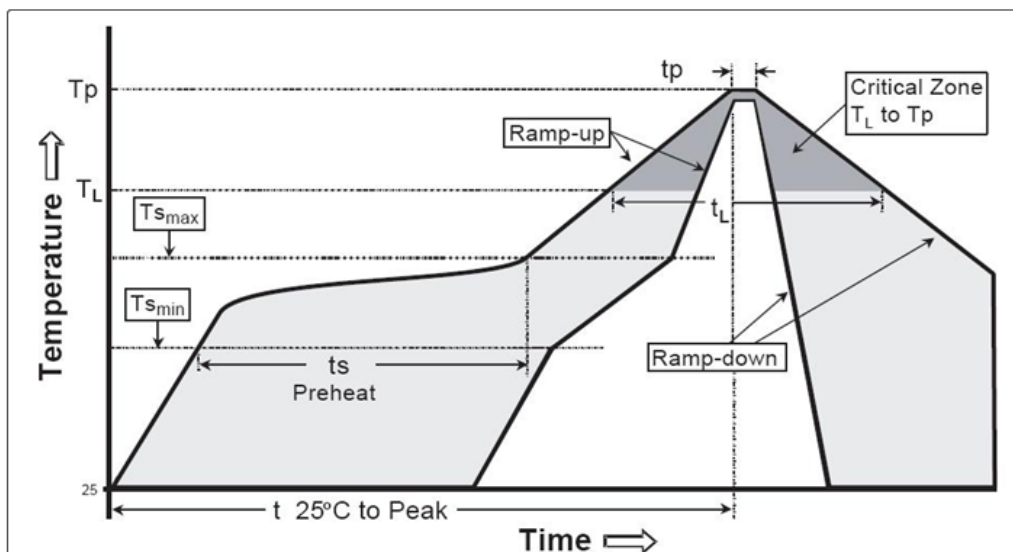


图 5-5: 分级回流焊

表 5-5: 分级回流焊对照表

项目	锡-铅工艺	无铅工艺
平均升温速率 ($T_{s_{max}}$ to T_p)	最大 3°C/秒	最大 3°C/秒
预热初温 ($T_{s_{min}}$)	100°C	150°C
预热目标温度 ($T_{s_{max}}$)	100°C	200°C
预热时长 ($T_{s_{min}}$ to $T_{s_{max}}$)	60-120 秒	60-180 秒
恒温温度 (T_L)	183°C	217°C
恒温时长 (t_L)	60-150 秒	60-150 秒
尖峰温度 (T_p)	225+0/-5°C	240+0/-5°C
尖峰温度时长 (t_p)	10-30 秒	20-40 秒
降温速率	最大 6°C/秒	最大 6°C/秒
25°C 到尖峰温度时长 (t)	最多 6 分钟	最多 8 分钟

表 5-6: 无铅工艺峰值回流温度对照表

封装厚度	体积 (mm^3) <350	体积 (mm^3) ≥ 350
<2.5mm	240 + 0/-5°C	225 + 0/-5°C
$\geq 2.5\text{mm}$	225 + 0/-5°C	225 + 0/-5°C

表 5-7: 无铅工艺分级回流温度对照表

封装厚度	体积 (mm^3) <350	体积 (mm^3) 350-2000	体积 (mm^3) >2000
<1.6mm	260 + 0 °C	260 + 0 °C	260 + 0 °C
1.6mm -2.5mm	260 + 0 °C	250 + 0 °C	245 + 0 °C
$\geq 2.5\text{mm}$	250 + 0 °C	245 + 0 °C	245 + 0 °C

5.7 订购信息

表 5-8: 订购信息

料号	封装	合封规格	每盘数量 (PCS)
SF32LB583VCC36	BGA256: 8.5×6.5×0.94mm-0.4	8MB ×8 PSRAM + 8MB ×8 PSRAM + 1MB NOR Flash	3000
SF32LB585V5E56	BGA256: 8.5×6.5×0.94mm-0.4	4MB NOR Flash + 32MB ×16 PSRAM + 4MB NOR Flash	3000
SF32LB586VDD36	BGA256: 8.5×6.5×0.94mm-0.4	16MB ×16 PSRAM + 16MB ×16 PSRAM + 1MB NOR Flash	3000
SF32LB587VEE56	BGA256: 8.5×6.5×0.94mm-0.4	32MB ×16 PSRAM + 32MB ×16 PSRAM + 4MB NOR Flash	3000

相关资源

- 《AN5801-SF32LB58x-硬件设计指南》
- 《AN5802-SF32LB58x-EVB 使用指南》
- 《AN-SF01-付款码乘车码对接》
- 《AN-SF02-SDK 环境安装指南》
- 《AN-SF03-低功耗开发指南》

免责声明和版权公告

思澈科技（南京）有限公司保留随时对产品和/或本文档进行更正、修改、改进和其他变更的权利，包括其中的信息、参数、链接、URL 地址等。如有变更，恕不另行通知。

思澈科技（南京）有限公司在此未授予任何知识产权的明示或暗示的许可。

SiFli 和 SIFli 标识是思澈科技（南京）有限公司的商标。本文档中出现的所有其他商标、服务标记、商品名称、产品名称和标识均属其各自所有者的财产。

零售样品与小批量可直接在淘宝（sifli.taobao.com）购买

企业大批采购客户可发邮件到 sales@sifli.com

更多产品和文档可在 wiki.sifli.com 获取

遇到问题可在 bbs.sifli.com 进行讨论

开源项目免费申请样品，可加入 QQ 群 674699679 进行交流

欢迎关注我们公众号获取最新产品信息



地址：江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 B 座 419-13 200131 邮箱：sales@sifli.com

©2026 思澈科技（南京）有限公司。保留所有权利。